



合晶科技股份有限公司
WAFER WORKS CORP.

股票代碼：6182

興櫃股票代碼：R060

原證券代碼：232834

合晶科技股份有限公司 Wafer Works Corp.

中華民國九十三年度年報

ANNUAL REPORT 2004

中華民國九十四年五月二十五日刊印

本年報電子檔案免費查詢網址：<http://mops.tse.com.tw>

本公司發言人：

姓名：許祐淵

職稱：副董事長

電話：(03)481-5001

電子郵件信箱：public@waferworks.com

本公司代理發言人：

姓名：蘇坤輝

職稱：財務行政協理

電話：(03)481-5001

電子郵件信箱：public@waferworks.com

總公司及工廠所在地之地址及電話：

地址：桃園縣 326 楊梅鎮梅獅路二段 445 巷 1 號

電話：(03)481-5001

辦理股票過戶機構：

名稱：大華證券股份有限公司

地址：台北市重慶南路一段 2 號 5 樓

電話：(02)2389-2999

網址：<http://www.toptrade.com.tw>

最近年度簽證會計師：

會計師事務所：致遠會計師事務所

會計師姓名：洪茂益、張志銘

地址：台北市基隆路一段 333 號 9 樓

電話：(02)2720-4000

網址：<http://www.dey.com.tw>

海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢海外有價證券資訊之方式：無

網址：www.waferworks.com

目 錄

壹、致股東報告書	1
貳、公司概況	2
一、公司簡介	2
二、公司組織	3
三、資本及股份	15
四、公司債辦理情形	19
五、特別股辦理情形	19
六、海外存託憑證辦理情形	19
七、員工認股權憑證辦理情形	19
八、併購或受讓其他公司股份發行新股辦理情形	19
參、營運概況	20
一、業務內容	20
二、市場及產銷概況	28
三、從業員工資料	33
四、環保支出資訊	33
五、勞資關係	33
六、重要契約	34
肆、資金運用計劃及執行情形	35
一、計畫內容	35
二、執行情形	35
伍、財務概況	36
一、最近五年度簡明資產負債表及損益表	36
二、最近五年度財務分析	37
三、最近年度財務報告之監察人審查報告	39
四、最近年度財務報表	40
五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表	88
六、公司及其關係企業如有發生財務週轉困難情事對公司財務狀況之影響	140
陸、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理	141
一、財務狀況	141
二、經營結果分析	141
三、現金流量分析	143
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	143

五、最近年度轉投資政策其獲利或虧損之主要原因、改善情形及未來一年投資計畫	143
六、風險管理及評估 -----	143
七、其他重要事項 -----	145
柒、公司治理運作情形 -----	146
捌、特別記載事項 -----	148
一、關係企業相關資料 -----	148
二、內部控制制度執行狀況 -----	152
三、最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者 -----	153
四、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 -----	153
五、最近年度及截至年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形 -----	153
六、最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議 -----	153
七、最近年度及截至年報刊印日止，公司及其內部人員依法被處分、公司對其內部人員違反內部控制制度之處罰、主要缺失與改善情形 -----	154
八、其他必要補充說明事項 -----	154
九、對股東權益或證券價格有重大影響之事項 -----	154

壹、致股東報告書

2004 年是合晶科技豐收的一年，在營收與獲利雙雙創下新高紀錄下，再度突顯了本公司穩健成長的經營實績，更堅信今年能再締造另一個高峰。

本公司 2004 年營業額穩健成長 16%，達新台幣 15.35 億元，另集團合併營收成長 28%，達新台幣 21.68 億元，稅前純益更是大幅成長 58%，達新台幣 2.46 億元。主因係為去年完成增加投資上海合晶公司和順利進行台灣擴充產能等計畫，因此無論在成本優勢、市場佔有率方面，均能達到提升整體競爭力的預期效益。

展望 2005 年，合晶經營重點將執行下列方向與目標：

產品行銷

在產品發展方面，由於合晶客戶們的高度需求，生產磊晶產品(Epi)將成為本公司未來產品發展的重點之一。另外，有鑑於未來全球太陽能產業高度發展的潛能，立即擴充上海晶技原有小規模的產能，並將擴大太陽能級矽晶圓的業務比重。在行銷方面，持續強化、深化與歐美國際性大廠之關係，儘速取得新客戶訂單。

創新

我們期許能以不斷精進的製程技術來滿足客戶對高階產品的品質需求，計畫開發 8 吋重摻高品質晶片，並與國內知名研究機構合作開發 4 吋藍寶石(Sapphire)晶棒之成長，以供光電及國防工業用。

全球佈局

在中國大陸逐漸成為全世界製造中心的趨勢下，合晶配合根留台灣的政策往生產小量多樣，高附加價值的產品發展，並善用大陸低成本的優勢，將台灣 4" 及 5" 較低階產品移往大陸生產，除了原有的上海合晶及上海晶技擴廠外，在上海青浦設立「上海晶盟硅材料有限公司」擴大營運，以滿足客戶需求，創造公司整體最大利益。

面對今年全球半導體產業的低成長，合晶團隊將更勤奮努力外，並已做好全面準備，將經營的豐富成果分享給所有股東、客戶及員工，最後誠摯感謝各位股東們長期的鼓勵與支持。

董事長：

貳、公司概況

一、公司簡介

(一)設立日期：中華民國八十六年七月二十四日

(二)總公司、分公司及工廠之地址及電話

總公司及工廠地址：桃園縣楊梅鎮梅獅路二段 445 巷 1 號

電話：(03)481-5001

分公司：無

(三)公司沿革

本公司於民國 86 年 7 月 24 日籌資 5,000,000 元，於台北市設立合晶科技股份有限公司，主要業務為半導體及其材料之研發，設計、製造、進出口及代理銷售等。

民國 86 年 7 月 公司正式成立，資本額新台幣五百萬元，由蔡南雄先生擔任董事長。

民國 86 年 10 月 現金增資發行新股 76,354,335 股，增資後實收資本額為 768,543,350 元。

民國 86 年 11 月 併購美國 Helitek Company Ltd.

民國 87 年 9 月 資本公積轉增資發行新股 46,112,601 股及現金增資發行新股 4,000,000 股，增資後實收資本額為 1,269,669,360 元。

民國 88 年 5 月 美國孫公司 Helitek Company Ltd. 得到加州阿拉米達郡環保績優獎 (1999 Business Environmental Achievement Award)。

民國 88 年 5 月 本公司楊梅廠建廠完成，並正式生產。

民國 88 年 9 月 本公司通過 IECQ/ISO9002 UL 品質認證。

民國 89 年 3 月 現金增資發行新股 23,033,064 股，增資後實收資本額為 15 億元。

民國 89 年 3 月 本公司獲經濟部工業局核准「重摻砷低電阻矽基板」主導性新產品研發獎勵。

民國 89 年 4 月 本公司開發完成電阻值為 0.7m Ω-cm 之重摻磷(Red Phosphorous)低電阻矽基板。

民國 89 年 9 月 成功拉出我國第一支八吋摻砷矽晶棒。

民國 90 年 6 月 本公司通過 ISO 14001 及 QS9000 UL 品質認證。

民國 90 年 10 月 董事長蔡南雄先生辭任，補選董事焦平海先生擔任董事長職務。

民國 91 年 5 月 本公司股票掛牌上櫃。

民國 91 年 12 月 本公司通過 ISO9001：2000 品質認證。

民國 92 年 6 月 本公司獲經濟部工業局核准「微機電系統與智慧電力元件之矽晶片」主導性新產品研發獎勵。

民國 93 年 3 月 本公司取得上海合晶硅材料有限公司 75% 股權，正式取得其經營權。

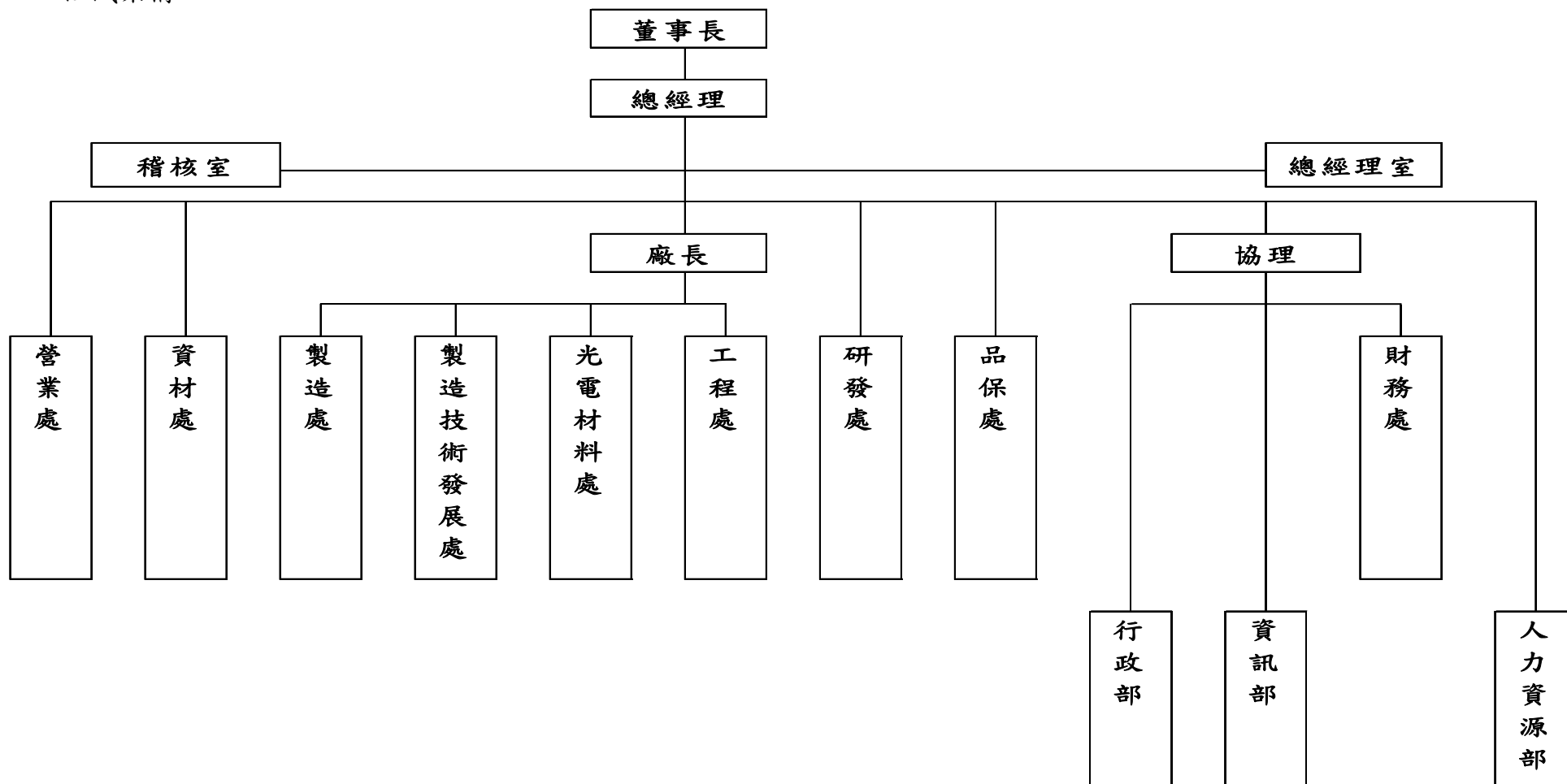
民國 93 年 8 月 資本公積轉增資發行新股 4,500,000 股，增資後實收資本額為 1,545,000,000 元。

民國 94 年 1 月 本公司通過 TS16949 品質認證。

二、公司組織

(一)組織系統

1.組織架構



2.各主要部門所經營之業務

部門別	所經營之業務
董事長	1.設定公司之願景目標。 2.制定公司之經營策略。 3.規劃公司之經營方針。
總經理及總經理室	1.接受董事長指揮，執行董事會決議交辦事項。 2.擬定公司經營計劃並對董事會擔負所有執行責任。 3.管理督促所屬部門主管達成公司獲利的目標。 4.建立制度、培植人才、厚植公司長久發展基礎。 5.未來技術開發及新技術引進。 6.經營管理會議之規劃及監督執行。
稽核室	1.協助監督內部控制制度運作。 2.負責內部稽核作業。 3.協助營運目標達成。
人力資源部	1.公司組織系統及各單位工作職掌之規劃協調及修訂。 2.規劃及制定公司人力資源政策並建立監理機制及執行制度。 3.制定教育訓練體系及制定教育訓練計劃並管理及執行。 4.制定人事管理相關規章與制度並管理及推動。 5.薪資作業、招募作業、任用作業、績效考核作業之執行。
營業處	1.新市場及客戶之開發與客戶合約之審查及簽訂。 2.市場趨勢及情報之蒐集及銷售政策計劃之擬定。 3.協助帳款催收及客戶授信額度管制。 4.提供客戶產品應用技術支援。 5.客戶服務及滿意度提升。
資材處	1.存貨之管理及制定年度採購策略。 2.國內外設備、原物料、零件之訂購採買作業執行。 3.負責倉庫管理及維護料帳正確。 4.建立資材處各單位系統電腦化、資訊化及制度化。 5.年度海關盤點計劃擬定、協調與執行。
製造處	1.負責矽晶圓相關產品之生產製造。 2.製程品質管制維持及提升。 3.生產設備之維修保養及性能改善。 4.品質預警系統之建立與稽查。 5.生產排程規劃及生產進度追蹤。
製造技術發展處	1.現有產品製程技術之改進。 2.產品良品率及品質提昇之規劃及執行。 3.現有產品製程技術 SOP 之建立。 4.產品客訴製程技術處理。 5.專利申請與維護。
光電材料處	1.負責藍寶石晶圓相關產品之生產製造。 2.製程品質管制維持及提升。 3.生產設備之維修保養及性能改善。 4.品質預警系統之建立與稽查。 5.生產排程規劃及生產進度追蹤。
工程處	1.水、氣、電力、動力、空調等廠務設備維護及管理。 2.全廠機台設備之檢測、保養、維護及改良。 3.廠務系統及機台設備引進之評估。 4.負責全廠設備人員及廠務人員教育訓練及素質提升。

	5.年度歲修規劃及執行。
研發處	1.新產品種類及新製程技術之引進及開發。 2.協助提升技術發展處制程技術。 3.協助客戶產品應用技術。
品保處	1.建立公司之品質作業系統並執行各階段作業之品管稽核。 2.進料及出貨品質檢驗標準之制度建立及執行。 3.公司產品品質對外問題之處理。 4.生產環境之監測。 5.DCC 文件管制系統建立及管理。 6.製程統計資料之蒐集、分析及提改善建議。 7.ISO9001、QS9000、TS16949 管理系統規劃、維護與執行。
財務處	1.會計制度及內部控制制度之建立、維護及執行。 2.帳務處理，成本計算、稅務申報、出納作業及資金管理等。 3.預算編列、執行及控制。 4.稅務工作規劃執行及維護。 5.衍生性金融商品操作。 6.金融機構關係之維護。
資訊部	1.管理電腦化（ERP）之規劃及執行。 2.網路系統之規劃及管理。 3.應用系統之規劃及管理。 4.資訊設備之更新、升級。 5.資訊設備日常保養及維護。
行政部	1.公司涉外事務及公共關係處理。 2.廠區安全衛生之規劃、管理及執行。 3.廠區環保之規劃、管理及監督執行。 4.固定資產之管理、盤點及維護。 5.費用監理系統之建立及執行。 6.行政、環安及總務制度之建立及推動。 7.ISO14001 管理系統規劃、維護與執行。 8.OHSAS18001 管理系統規劃、維護與執行。

(二)董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

1.董事及監察人

94年4月30日

職稱	姓名	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
董事長	焦平海	92.6.30	3年	86.11.4	2,053,809	1.37%	4,205,423	2.72%	1,030,000	0.67%	-	-	聖荷西州立大學化工碩士 Siltec 製程工程部經理 敦南科技資深經理 Helitek 創立人及總經理	Helitek Company Ltd. 總經理 晶材科技(股)公司董事 Silicon Technology Investment(Cayman) Corp. Director 上海晶技電子材料有限公司董事長 上海合晶硅材料有限公司董事長	董事	焦生海	兄弟
副董事長	許祐淵	92.6.30	3年	86.7.21	1,034,595	0.69%	1,065,632	0.69%	260,590	0.17%	-	-	文化大學國際企業管理研究所 史丹佛大學商學研究所研究 文化大學企管系講師 行政院開發基金會業務組組長 茂矽電子副總經理 香港華智執行副總經理	晶材科技(股)公司監察人 Silicon Technology Investment(Cayman), Corp. Director Helitek Company Ltd, Director 聚利管顧董事 中華電訊監察人	-	-	-
董事	台聚投資(股)公司代表人: 葉德昌	92.6.30	3年	92.6.30	2,177,960	1.45%	2,243,298	1.45%	-	-	-	-	政治大學經濟研究所	聚利創投總經理	-	-	-
董事	華榮電線電纜(股)公司代表人:王怡仁	92.6.30	3年	86.11.4	5,766,097	3.85%	5,729,079	3.70%	-	-	-	-	澳洲墨爾本大學 日商丸紅公司電子產業部業務 摩根史坦利投資銀行新金融商品部副理 摩根大通銀行私人理財部副理	-	-	-	
董事	王泰元	92.6.30	3年	92.6.30	1,499,000	1.00%	1,543,970	1.00%	1,286,470	0.83%	-	-	台北私立開南高商 吉優(股)公司董事長	元品實業股份有限公司 董事	-	-	-

職稱	姓名	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人		
					股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係
董事	大陽投資(股)公司代人：林剛銘	92.6.30	3年	86.11.4	3,756,000	2.50%	2,216,960	1.43%	-	-	-	-	美國國家大學管理學碩士 美商富藍克林時間規劃(股)公司副總經理	齊科實業(股)公司副總經理 華利創投專案經理	-	-	-
董事	英屬維京群島商吉興國際有限公司代表人：李志豪	92.6.30	3年	92.6.30	4,484,000	2.99%	4,618,520	2.98%	-	-	-	-	國立政治大學企研所碩士 漢民科技(股)公司董事長特別助理	-	-	-	-
董事	台聚投資(股)公司代人：焦生海	92.6.30	3年	92.6.30	2,177,960	1.45%	2,243,298	1.45%	1,648	0.00%	-	-	史丹佛大學材料博士 Mosel-Vitellic 副總經理	聖荷西州立大學電機系(所)正教授	董事長	焦平海	兄弟
董事	英屬維京群島商高科控股有限公司代表人：阮妮蓮	92.6.30	3年	86.11.4	2,555,000	1.70%	2,631,650	1.70%	1,539,850	1.00%	-	-	德明技術學院會統系 興翰科技股份有限公司董事長 奎福股份有限公司董事長	旭揚理財顧問股份有限公司監察人 是方電訊股份有限公司監察人	-	-	-
監察人	新加坡商凱新(股)公司代表人：陳致遠	92.6.30	3年	86.11.4	2,093,000	1.40%	2,155,790	1.39%	-	-	-	-	美國紐約大學企管碩士 怡春通運(股)公司董事長 勇誼(股)公司執行董事	華儲(股)公司副董事長 中華航空公司董事 泰安產物保險(股)公司常務董事	-	-	-
監察人	吉優股份有限公司代表人：李志鴻	92.6.30	3年	92.6.30	118,000	0.08%	121,540	0.08%	-	-	-	-	台北大學企研所碩士 TENLI INVESTMENT CORP 執行董事	吉優股份有限公司顧問	-	-	-

法人股東之主要股東

94年4月30日

法人股東名稱 (註一)	法人股東之主要股東 (註二)
大陽投資股份有限公司	大華建設(股)公司
台聚投資股份有限公司	台灣聚合化學品(股)公司
華榮電線電纜股份有限公司	第一伸銅科技(股)公司，王玉發、王玉雲、王玉珍
新加坡商凱新股份有限公司	Commercial Capital Service, Ltd (BVI)
英屬維京群島商吉興國際有限公司	Tortrust Corporation Company Limited
吉優股份有限公司	王泰元、楊照蘭
英屬維京群島商高科控股有限公司	劉武君、許祐淵、蔡南雄

註一：屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱及該法人之股東股權比例超過百分之十或股權比例占前十名之股東名稱。

註二：法人股東之主要股東如屬法人股東代表者，應註明該第二層法人股東名稱並應填列下表二。

法人股東之主要股東屬法人股東代表者

94年4月30日

法人股東名稱 (註)	法人股東之主要股東
大華建設(股)公司	林文亮、林柏峰、友利實業(股)公司、大昕投資(股)公司、林維邦
台灣聚合化學品(股)公司	香港商誠利置業有限公司、吳壽松、郭換坤、行政院國軍退除役官兵輔導委員會塑膠工廠、林蘇珊珊、席德鰲
第一伸銅科技(股)公司	王玉珍、華鴻投資(股)公司、華榮電線電纜(股)公司
Commercial Capital Service, Ltd (BVI)	Euro-Capital Holdings Clogal Inc.、Pan Asia Services Holdings Ltd.、United Star Investment Holding Inc.

註：第二層屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱及該法人之股東股權比例超過百分之十或股權比例占前十名之股東名稱。

董事及監察人資料

姓名 (註1)	條件	是否具有五 年以上商 務、法律、財 務或公司業 務所須之工 作經驗	符合獨立性情形 (註2)							備註 (註3)
			1	2	3	4	5	6	7	
董事長: 焦平海		✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	董事長兼總經理
董事: 台聚投資(股)公司 代表人: 葉德昌		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
董事: 華榮電線電纜(股)公司 代表人: 王怡仁		✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	
董事: 許祐淵		✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
董事: 大陽投資(股)公司 代表人: 林剛銘		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
董事: 王泰元		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	
董事: 英屬維京群島商吉興國 際有限公司 代表人: 李志豪		✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	
董事: 台聚投資(股)公司 代表人: 焦生海		✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-	
董事: 英屬維京群島商高科控 股有限公司代表人: 阮妮蓮		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
監察人: 新加坡商凱新(股)公司 代表人: 陳致遠		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
監察人: 吉優(股)公司 代表人: 李志鴻		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	

註1: 欄位多寡視實際數調整。

註2: 各董事、監察人符合下述各條件者, 請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1) 非為公司之受僱人或其關係企業之董事、監察人或受僱人, 但其兼任母公司或子公司之獨立董事、獨立監察人者, 不在此限。
- (2) 非直接或間接持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (3) 非前二項人員之配偶或其二親等以內直系親屬。
- (4) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人、受僱人或持股前五名法人股東之董事、監察人、受僱人。
- (5) 非與公司有財務、業務往來之特定公司或機構之董事、監察人、經理人或持股百分之五以上股東。
- (6) 非為最近一年內提供公司或關係企業財務、商務、法律等服務、諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構團體之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
- (7) 非為公司法第二十七條所訂之法人或其代表人。

註3: 擔任公司獨立董事或獨立監察人者, 如有兼任其他公司獨立董事或獨立監察人情事, 應備註說明兼任家數。

2.總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

94年4月30日

職稱	姓名	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
			股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
董事長兼任總經理	焦平海	92.6.30	4,205,423	2.72%	1,030,000	0.67%	-	-	聖荷西州立大學化工碩士 Siltec 製程工程部经理 敦南科技資深經理 Helitek 創立人及總經理	Helitek Company Ltd. 總經理 晶材科技(股)公司董事 Silicon Technology Investment(Cayman) Corp.Director 上海晶技電子材料有限公司董事長 上海合晶硅材料有限公司董事長	-	-	-
廠長	曹順清	93.2.16	93,722	0.06%	-	-	-	-	威斯康辛大學材料科學博士 工研院副研究員	-	-	-	
財務行政協理	蘇坤輝	93.2.16	30,900	0.02%	-	-	-	-	逢甲大學會計系 大魯閣纖維財務經理 清三機構董事長特別助理 福葆電子財務行政協理	-	-	-	
技術長兼任研發處處長	邱恒德	91.9.18	25,600	0.02%	97,850	0.06%	-	-	美國西北大學材料博士 Monsanto Co.及 Motorola Inc.資深研發專員	-	-	-	
品保處處長	潘敏學	93.7.12	25,750	0.02%	600	0.00%	-	-	Rutgers-the State University of New Jersey 化學博士 中德電子應用技術專員	-	-	-	

職稱	姓名	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
			股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
營業處處長	方金龍	91.5.16	229,110	0.15%	-	-	-	-	台灣大學材料碩士 工研院電子所助理工程師	-	-	-	
資材處處長	連經亞	88.7.12	221,604	0.14%	-	-	-	-	俄克拉荷馬大學管理碩士 Motorola 採購經理 王安電腦資材經理	-	-	-	
製造處處長	謝榮福	93.2.16	140,332	0.09%	-	-	-	-	雅禮高職 大同矽晶中心生管組長	-	-	-	
技術發展處處長	宋永成	93.2.16	54,590	0.04%	-	-	-	-	中央大學機械所碩士 工研院光電所機械設計工程師 中德電子材料製程工程師	-	-	-	
稽核室經理	張耀郎	92.4.11	25,000	0.02%	-	-	-	-	榮聰會計師事務所副領組 京華證券承銷部研究員 大華建設稽核室主管	-	-	-	

董事之報酬

94年4月30日

職稱	姓名	車馬費及報酬 (新台幣仟元)	盈餘分配之董事酬勞 (新台幣仟元)	盈餘分配之員工紅利金額 (註2)			前三項總額 (新台幣仟元)	總額佔稅後純益之比例(%)	取得員工認股權憑證數額 (註3)	其他報酬 (新台幣仟元) (註4)
				現金紅利	股票紅利					
					股數	市價				
董事	焦平海	162					162	0.07	93年度薪資2,491仟元及提供汽車一部為代步工具，成本為824仟元	
董事	許祐淵									
董事	台聚投資(股)公司 代表人： 葉德昌									
董事	華榮電線電纜(股)公司 代表人： 王怡仁									
董事	王泰元									
董事	大陽投資(股)公司 代表人： 林剛銘									
董事	英屬維京群島商吉興國際有限公司 代表人： 李志豪									
董事	台聚投資(股)公司 代表人： 焦生海									
董事	英屬維京群島商高科技控股有限公司 代表人： 阮妮蓮									

註1：董事姓名應分別列示，但得以彙總方式揭露其車馬費、盈餘分配之董事酬勞及其他報酬情形，若董事兼任總經理或副總經理者，其報酬應分別按其身分揭露。屬董事報酬部分揭露於本表；屬總經理及副總經理之報酬部分揭露於下表。

註2：若董事兼任員工(或經理人)取得員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者，應填列員工紅利金額，其股票紅利之「市價」，上市上櫃公司係採用公司會計期間最末一個月之平均收盤價計算之，若非屬上市上櫃公司則以會計期間結束日之淨值計算之。若另董事係兼任經理人取得員工紅利者，應再填列附表二之二。

註3：若董事兼任員工領取員工認股權憑證者，應填列本表及附表十五。

註4：如提供汽車、房屋及其他專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算租金及其他給付。

監察人之報酬

職稱	姓名	車馬費及報酬 (新台幣仟元)	盈餘分配之監 人酬勞	前二項總額 (新台幣仟元)	總額佔稅後純益之比例 (%)	其他報酬 (新台幣仟元) (註 2)
監察人	新加坡商凱新 (股)公司 代表人: 陳致遠	36		36	0.01	
監察人	吉優股份有限 公司代表人: 李志鴻					

註 1：監察人姓名應分別列示，但得以彙總方式揭露其車馬費、盈餘分配之監察人酬勞及其他報酬情形。

註 2：如提供汽車、房屋及其他專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金及其他給付。

總經理及副總經理之報酬

職稱	姓名	薪資 (新台 幣仟 元)	獎金、特 支費(新 台幣仟 元)	盈餘分配之員工紅利金額 (註 2)			前三項總額 (新台幣仟元)	總額佔稅 後純益之 比例(%)	取得員工認 股權憑證數 額(註 3)	其他報酬 (新台幣仟元) (註 4)
				現金 紅利	股票紅利					
					股數	市價				
總經理	焦平海	1,024					1,024	0.41		

註 1：總經理及副總經理姓名應分別列示，但得以彙總方式揭露其薪資、獎金、特支費、員工紅利及員工認股權憑證情形。

註 2：總經理及副總經理領取員工紅利(含股票紅利及現金紅利)者，應填列本表及附表二之二，其股票紅利之「市價」，上市上櫃公司係採用公司會計期間最末一個月之平均收盤價計算之，若非屬上市上櫃公司則以會計期間結束日之淨值計算之。

註 3：總經理及副總經理領取員工認股權憑證者，應填列本表及附表十五。

註 4：如提供汽車、房屋及其他專屬個人之支出時，應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金及其他給付。

(三)最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

單位：股

職稱	姓名	93 年度		94 年度截至 4 月 30 日	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長	焦平海	1,091,614	-	1,060,000	-
副董事長	許祐淵	31,037	-	-	-
董 事	大陽投資(股)公司	(505,040)	-	(514,000)	-
董 事	華榮電線電纜(股)公司	172,982	-	(210,000)	-
董 事	台聚投資(股)公司	65,338	-	-	-
董 事	英屬維京群島商吉興國際有限公司	134,520	-	-	-
董 事	英屬維京群島商高科控股有限公司	76,650	-	-	-
董 事	王泰元	44,970	-	-	-
監察人	新加坡凱新(股)公司	62,790	-	-	-
監察人	吉優(股)公司	3,540	-	-	-
經理人	古桓熙	(28,459)	-	-	-
經理人	蘇坤輝	25,900	-	-	-

股權移轉之相對人為關係人者：無

股權質押之相對人為關係人者：無

(四)公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

綜合持股比例

單位：股；%

轉投資事業 (註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Wafer Works Investment Corp.	19,769,600	100.00%	-	-	19,769,600	100.00%
晶材科技股份有限公司	499,994	99.99%	6	0.01%	500,000	100.00%

註：係公司之長期投資。

三、資本及股份

(一)股本來源

單位：新台幣仟元；股

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
86年7月	10	500,000	5,000	500,000	5,000	設立股本	無	-
86年12月	25	80,000,000	800,000	76,854,335	768,543	現金增資76,354,335股	無	註1
87年10月	10	200,000,000	2,000,000	126,966,936	1,269,670	現金增資4,000,000股資本公積轉增資46,112,601股	無	註2
89年4月	20	200,000,000	2,000,000	150,000,000	1,500,000	現金增資23,033,064股	無	註3
92年8月	-	250,000,000	2,500,000	150,000,000	1,500,000	係提高額定股本	無	註4
93年8月	-	250,000,000	2,500,000	154,500,000	1,545,000	資本公積轉增資4,500,000股	無	註5
94年4月	-	250,000,000	2,500,000	154,757,731	1,547,578	可轉換公司債轉增資	無	-

註1：核准文號：經(86)商字第一二三七〇〇號。

註2：核准文號：經(87)商字第〇八七一三三〇七三號。

註3：核准文號：(89)台財證(一)第一一三九一七號。

註4：核准文號：經(92)商字第〇九二〇一二三七八〇〇號。

註5：核准文號：金管證一字第〇九三〇一三二一四七號。

94年4月30日；單位；股

股份種類	核定股本				未發行股份	合計	備註
	已發行股份			合計			
	已上市(櫃)	未上市(櫃)	合計				
記名式普通股	154,757,731	-	154,757,731	95,242,269	250,000,000	-	

(二)股東結構

94年4月30日；單位：股，%

股東結構 數量	政府 機構	金融 機構	其他法人	個人	外國機構及 外	合計
人數	-	1	42	6,156	9	6,208
持有股數	-	100,000	51,989,142	85,614,677	17,053,912	154,757,731
持股比例	-	0.06	33.59	55.33	11.02	100.00

(三)股權分散情形

每股面額十元

94年4月30日

持 股 分 級	股東人數	持有股數	持股比例(%)
1 至 999	845	124,174	0.08
1,000 至 5,000	3,418	7,711,954	4.98
5,000 至 10,000	862	7,134,326	4.61
10,001 至 15,000	297	3,640,052	2.35
15,001 至 20,000	231	4,420,682	2.86
20,001 至 30,000	183	4,748,317	3.07
30,001 至 50,000	142	5,817,992	3.76
50,001 至 100,000	98	7,372,665	4.76
100,001 至 200,000	44	6,500,844	4.20
200,001 至 400,000	31	8,527,774	5.51
400,001 至 600,000	9	4,449,014	2.87
600,001 至 800,000	10	7,079,629	4.57
800,001 至 1,000,000	5	4,546,343	2.94
1,000,001股以上	33	82,683,965	53.44
合 計	6,208	154,757,731	100.00

(四)主要股東名單(股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例)

94年4月30日

股 份	持有股數	持股比例(%)
主要股東名稱		
聚利創業投資(股)公司	7,733,852	5.00
英屬開曼群島商台灣特別機會基金有限公司II	5,749,872	3.72
華榮電線電纜(股)公司	5,749,079	3.71
英屬維京群島商吉興國際有限公司	4,618,520	2.98
焦平海	4,205,423	2.72
齊魯企業(股)公司	3,746,634	2.42
宏德投資(股)公司	3,078,670	1.99
亞洲聚合(股)公司	2,935,788	1.90
英屬維京群島商高科控股有限公司	2,631,650	1.70
台聚投資(股)公司	2,243,298	1.45

(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料

單位：新台幣元；仟股

項目		年度	92 年	93 年	當年度截至 94 年 4 月 30 日
		每股市價	最高	15.30	19.30
	最低	8.05	12.20	12.40	
	平均	12.22	14.88	14.42	
每股淨值	分配前	11.03	11.63	12.26	
	分配後	11.03	註 1		
每股盈餘	加權平均股數	153,983	153,128		
	每股盈餘	調整前	1.54	1.61	
		調整後	1.50	註 1	
每股股利	現金股利		-	註 1	-
	無償配股	盈餘配股	-	註 1	-
		資本公積配股	-	0.3	-
	累積未付股利		-	-	-
投資報酬分析	本益比		-	9.24	-
	本利比		-	-	-
	現金股利殖利率		-	-	-

註 1：93 年度盈餘配股尚未決議。

(六)公司股利政策及執行狀況

1.股利政策：

本公司股利政策係依據營運規劃、投資計劃、資本預算及內外部環境變化由董事會予以訂定。本公司係屬營運成長階段之資本密集行業，需保留充足之資金以因應營業成長及資本支出之所需，故現階段本公司股利政策係以股票股利以不低於當年度可分配之股東紅利之百分之五十為原則。員工紅利以現金或股票發放之比率與該同一年度之股東紅利相同。

2.本次股東會擬議股利分配之情形：

本公司業經 94 年 3 月 30 日董事會決議通過，擬自 93 年可分配盈餘中提撥股東現金股利 77,250,000 元(每股配發 0.5167 元)，另提撥股東股票股利 77,250,000 元(每股配發 0.5167 元)轉作資本發行新股。

(七)本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

本公司 94 年度未編製財務預測，故不適用。

(八)員工分紅及董事、監察人酬勞

1. 公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍

本公司年度總決算如有盈餘時，應先提繳稅款、彌補以前年度之虧損，次提百分之十為法定盈餘公積及依主管機關要求提列之特別盈餘公積後，得並同以往年度累積盈餘，作為可分配盈餘，惟視業務狀況酌予保留外，依下列比率分派之

股東紅利百分之八十八。

員工紅利百分之十。

董監酬勞百分之二。

2. 董事會通過之擬議配發員工紅利

(1) 配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額

本公司董事會於94年3月30日決議通過，擬分派股東股票股利77,250,000元、現金股利77,250,000元、董監事酬勞3,511,364元及員工股票紅利8,778,410元、員工現金紅利8,778,408元。

(2) 擬議配發員工股票紅利股數及其佔盈餘轉增資之比率

本公司董事會於94年3月30日決議通過，擬以盈餘增資發行新股8,602,841股，其中員工股票紅利發行新股計877,841股，佔盈餘轉增資之比率為10.20%。

(3) 考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘

本公司93年度稅後淨利為246,179千元，擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞之金額為21,108千元，扣除後之金額為225,071千元，以93年度流通在外加權平均股數153,128千股計算，每股盈餘為1.47元。

3. 上年度盈餘用以配發員工分紅及董事、監察人酬勞之情形：無。

(九) 公司買回本公司股份情形：

94年4月30日

買回期次	第一次
買回目的	轉讓予員工
買回期間	93/8/25~93/10/24
買回價格區間	13元~20元
已買回股份種類及數量	普通股5,000,000股
已買回股份金額	67,235千元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	-
累積持有本公司股份數量	5,000,000
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	3.24%

四、公司債(含海外公司債)發行情形：

公司債種類	國內第一次無擔保可轉換公司債	
發行日期	93年5月19日	
面額	新台幣壹拾萬元整	
發行及交易地點	台灣	
發行價格	依面額十足發行	
總額	貳億元整	
利率	票面利率 0%	
期限	五年期 到期日：98年5月18日	
保證機構	無	
受託人	建華商業銀行股份有限公司信託部	
承銷機構	建華證券股份有限公司	
簽證律師	通律法律事務所 楊永成律師	
簽證會計師	致遠會計師事務所 鄧泗堂、張志銘會計師	
償還方法	除依轉換辦法轉換或贖回外，到期時以現金一次還本	
未償還金額	貳億元整	
贖回或提前清償之條款	略	
限制條款	略	
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	無	
其他權利	截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	新台幣五百萬元整
	發行及轉換(交換或認股)辦法	略
交換標的委託保管機構名稱	無	

轉換公司債資料

公司債種類		國內第一次無擔保可轉換公司債	
項目	年度	93年	94年4月30日
	轉換公司債市價	最高	100
最低		100	104
平均		100	105
轉換價格		新台幣 19.4 元	新台幣 19.4 元
發行日期及發行時轉換價格		發行日期：93.5.19 發行時轉換價格：新台幣 20 元	發行日期：93.5.19 發行時轉換價格：新台幣 20 元
履行轉換義務方式		發行新股	發行新股

五、特別股辦理情形：無

六、參與發行海外存託憑證之辦理情形：無

七、員工認股權證辦理情形：無

八、併購辦理情形：無

參、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務主要內容

- (1)半導體及其材料之研發、設計、製造、進口及代理銷售。
- (2)半導體晶圓材料及晶圓加工設備與零組件之設計、加工、進出口銷售及售後服務。
- (3)前項各產品之技術移轉及其諮詢顧問業務。
- (4)除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

2.營業比重

單位：新台幣仟元

產品／年度	93 年度營業比重	
	金額	比例(%)
4 吋矽晶圓	389,487	25.37
5 吋矽晶圓	373,637	24.33
6 吋矽晶圓	632,734	41.21
其他	139,604	9.09
合計	1,535,462	100.00

3.公司目前之產品項目：

(1)半導體級矽產品

- (a)4 吋矽晶圓/晶棒
- (b)5 吋矽晶圓/晶棒
- (c)6 吋矽晶圓/晶棒
- (d)雙面拋光片
- (e)超薄拋光片(THIN WAFER)
- (f)SOI 及鍵結片(SOI/BONDED WAFER)

(2)太陽能級矽產品(子公司上海晶技產品)

- (a)多晶矽、多晶酸洗
- (b)矽晶圓及其相關產品

(3)光電產品

- (a)藍、白光 LED 基板之 2 吋藍寶石(Sapphire)晶圓
- (b)LCD Projector 散熱片之 2 吋藍寶石(Sapphire)晶圓

4.計劃開發之新產品及服務

- (1)LED 及 LCD Projector 用途之 4 吋藍寶石(Sapphire)基板

(2)半導體級 8 吋矽晶圓/晶棒

(3)磊晶矽晶圓(EPI WAFER)

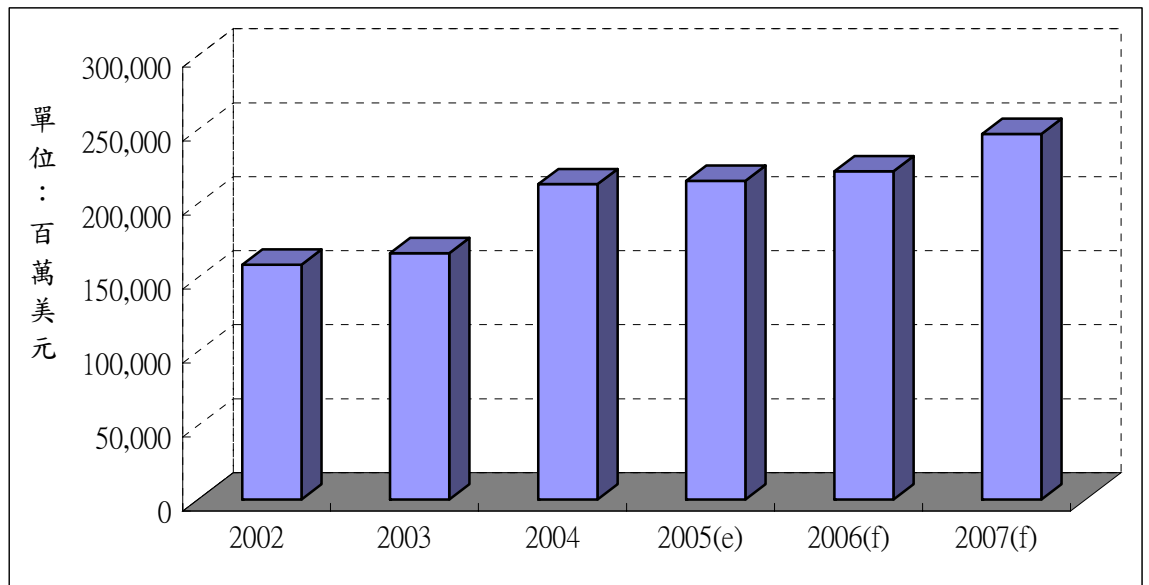
(二)產業概況

1.產業之現況與發展

(1)半導體產業

2004 年基於應用市場需求熱絡及全球經濟復甦，因此半導體市場呈現高速增長。根據 WSTS(2005.1)資料公佈，2004 年全球半導體銷售金額達 2,130 億美元，年成長率達 28%，預估 2005 年全球半導體產值較 2004 年成長 1.2%，達 2,153 億美元，並且預估 2006 年半導體市場將維持年成長率 3%，直到 2007 年半導體會重回兩位數的成長率。

全球半導體市場規模預估



資料來源：WSTS(2004/10)；工研院 IEK-ITIS 計畫(2005/03)

就我國方面，根據工研院 IEK 資料(2005/02)顯示，2004 年我國整體 IC 產業產值(含設計、製造、封裝、測試)為 10,990 億台幣，較 2003 年成長 34.2%。其中 IC 製造業為 6,239 億，成長率為 32.7%；晶圓代工業 3,985 億，成長率為 29%。相較於 2004 年全球半導體市場成長，國內 IC 業者表現略佳。

2003 年我國 IC 產業產值統計結果

單位：億台幣

	2002 年	2003 年	2004 年	04/03 成長率
總體 IC 產業產值	6,529	8,188	10,990	34.2%
IC 製造業	3,785	4,701	6,239	32.7%
晶圓代工	2,467	3,090	3,985	29.0%

資料來源：工研院 IEK 整理(2005/02)

(2) 矽晶圓產業

矽晶圓材料是半導體產業的起始材料(Starting Materials)，其材料品質影響 IC 製造良率甚鉅，矽晶圓之製造係以高純度的多晶矽(polysilicon)為原料，經由柴可斯基法(Czochralski Method, CZ 法)等長單晶方法，拉成一根約 1 公尺長的矽晶棒(Silicon Ingot)，其次再經切割、研磨、浸蝕、拋光等加工製程，即可形成一片片的拋光矽晶圓。

(a) 半導體級矽晶圓

半導體級矽晶圓可分為生產用矽晶圓及測試用矽晶圓兩種，生產用矽晶圓係用於生產半導體元件成品，另測試用矽晶圓係用於監控制程中溫度、電性、塵粒等性質。其中生產用矽晶圓尚可概分為拋光矽晶圓、磊晶矽晶圓及特殊用矽晶圓三類，根據半導體設備及材料協會(SEMI)資料(2005.02)顯示，上述晶圓 2004 年第 4 季之出貨數量比例分別為 74.97%、21.13%及 3.9%。

目前在矽晶圓材料市場，從晶圓尺寸大小來分類，有 3 吋、4 吋、5 吋、6 吋、8 吋及 12 吋矽晶圓之等規格；如從矽晶圓材料之阻抗特性來區分，則可分為低電阻、高電阻、超高電阻晶圓片三種；又如依據其摻入元素種類及多寡區分，則有輕摻硼、輕摻磷、重摻硼、重摻磷、重摻砷及重摻銻等六種矽晶圓材料。在應用方面，則可分為兩部份，一般 DRAM、SRAM 等 CMOS IC 大多以高電阻矽晶圓材料來製造，而此類產品因其製程技術在進入 0.35 μ m 以下後，除低密度產品仍以 4 吋、5 吋、6 吋廠產製外，餘多轉由 8 吋、12 吋廠產製。至於需低電阻、省電化之行動通訊、筆記型電腦、電力電子元件、類比 IC、功率 IC、光電元件、RF 元件、MEMS 元件、SOI 晶片及已部分取代傳統超厚磊晶片之鍵結片(Bonded Wafer)及擴散片(Diffused Wafer)，甚至如耐高壓元件之馬達控制、軌道車輛、國防工業、電源工業等產業所需之晶圓材料，則仍是 4 吋、5 吋、6 吋低電阻或超高電阻矽晶圓之市場。

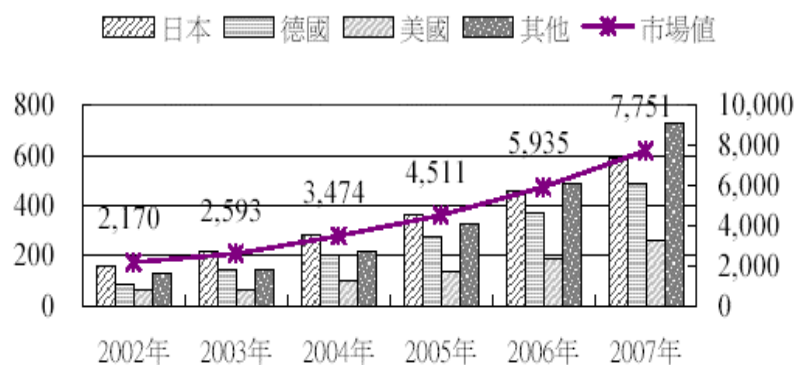
(b) 太陽能級矽晶圓

隨著人類的進步和科學技術的發展，人類在能源方面的消耗與日俱增。能源消費的快速增長在促進人類進步的同時，也對人類社會賴以生存

的環境造成了嚴重的破壞，能源與環境保護正成為當今世界普遍關注的熱點問題。1997年已開發國家於日本簽訂的京都議定書已在2005年生效，寄望最遲於2012年透過各國的力量，將二氧化碳以及其他五種有害氣體排放量比1990時降低5.2%的水準，其對產業的發展既深且遠。目前已有多國自行訂定替代能源的推動行程，除了能源價格高漲外，各國政府的補貼政策也是此一產業急速發展的重要推手。而太陽能電池作為一種可以再生的清潔能源日益受重視，隨著材料科學與創造技術的發展，成本迅速下降，太陽能電池的應用必將得到飛速發展。

根據光電協會PIDA的報導，2003年全球太陽電池市場量成長了32%，達到了574MW，市場金額則持續成長至2,593百萬美元。估計2004年市場量將較2003年成長38%，達到792MW，市場金額則成長34%，達到3,474百萬美元，預估未來仍有極大的成長空間，如下圖所示。

單位：MW、百萬美元

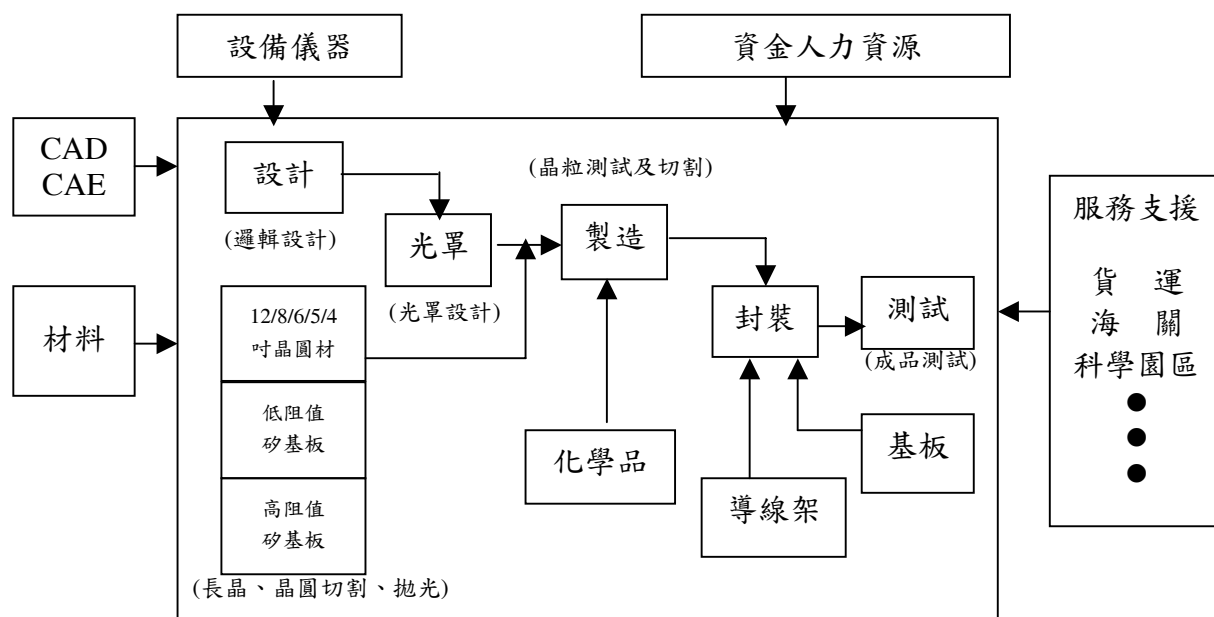


資料來源：PIDA，2004/12

- 2003年全球太陽電池市場量為574MW，市場金額 2,593百萬美元。
- 2004年全球太陽電池市場量估計為792MW，市場金額 3,474百萬美元。

因為矽多晶料的缺乏，估計2007年前太陽能產業均持續為賣方市場，由於轉投資公司上海晶技自1999年建廠完成以來，即從事矽多晶、多晶酸洗及其太陽能級相關產品加工製造及銷售等業務之優勢，今年以來即大幅擴充，估計2005年營收可望大幅成長為1億2500萬元人民幣，較2004年之人民幣4900萬元，成長比率將達250%，2006年以後將視多晶掌握增加情形再繼續擴充。

2. 產業上、中、下游之關聯性



資料來源：工研院 IT IS 計劃；合晶科技整理

3. 產品發展趨勢

(1) 產品品質及特性要求提高

隨著資訊電子產品省電化的需求趨勢，矽基板也逐漸走向低電阻化，使得重摻矽晶圓市場之需求，近年來大幅快速增加。由於摻雜質增多時，為使雜質能均勻滲雜，均勻分佈以保持矽晶圓一致之電性，其單晶成長技術也就愈困難。目前世界重摻矽晶圓仍只到 6 吋，未來預計當輕摻 12 吋矽晶圓漸趨成熟時，8 吋重摻市場才會明顯出現。此外，由於資訊電子產品輕薄短小化、行動化、環保化之發展趨勢，對矽晶圓片厚度之要求，只要在矽晶圓片受熱或外力作用，而仍不致彎曲或破片之虞下，有愈來愈薄之趨勢，以節省晶圓加工的製程步驟與成本。復以半導體元件廠製程能力的提高，除了對矽晶圓內部質量的要求外，對矽基板表面加工之機械性質之要求也愈高，例如對矽基板表面平坦度、區域平坦、彎曲度等等之要求，也愈為嚴格，合晶之產品開發均配合並滿足上述特性及要求來進行。

(2) SOI(Silicon on Insulator)需求成長

自 1990 年 IBM 成功地將 SOI 應用在其 Power IC 產品後，SOI 技術的新應用便不斷增加，預計 2003 年~2007 年 SOI 晶圓複合年成長率將達 47%。合晶於 2003 年獲經濟部工業局核准「微機電系統與智慧型電力原件之矽晶片」主導性新產品研發獎勵，日前已開發完成了雙面拋光(Double Side Polishing)矽晶圓與絕緣層上的矽(SOI, Silicon on Insulator)晶圓。該計畫開發出的矽晶圓可使用在微機電系統(MEMS, Micro Electro-Mechanical System)與電力元件(Power Device)、感測器(Sensors)、光電元件，以及製程

技術在 0.35 μ m 以上的 IC，應用層面包含汽車電子工業(例如偵測胎壓、驅動氣囊)、醫學儀器及更靈敏之感測器(如高靈敏度的耳溫槍、額溫槍、或氣體偵測)、製程控制用的感測器、消費性電子工業、電力控制電路、光開關(optical switch)、波導(wave guide)、投影顯示(projection displays)、光學掃描器(optical scanners)等等的運用，因而使得合晶科技成為國內第一家提供相關矽晶圓的上游原材料公司，預計可為國內的產業提供穩定而優質的服務，可望提升國內產業的世界競爭力。

4. 同業競爭情形

全世界矽晶圓材料市場佔有率，根據 2004 年 6 月 Dataquest 統計資料(如下表)，顯示 2003 年前十名計有日本信越(Shin-Etsu)、Sumco、Wacker、Memc、Komatsu、Toshiba、LG Siltron、Okmetic、合晶(Waferwork)、漢磊(Episil)。合晶排名為第九大，2004 年產能擴充及併入控股公司上海合晶之合併營收後已躍升為世界第八大。

Table 4-1 [\(Top\)](#) [\(Front Page\)](#)

Top 10 Merchant Silicon and Epitaxial Wafer Manufacturing Companies by Worldwide Revenue (Millions of Dollars)

2003 Rank	2002 Rank	Company	2002 Revenue	2003 Revenue	Change	2003 Market Share
1	1	Shin-Etsu Handotai	1,635.9	1,881.5	15.0%	30.1%
2	2	SUMCO	1,319.3	1,404.2	6.4%	22.4%
3	3	Siltronic (formerly Wacker Siltronic AG)	874.7	902.6	3.2%	14.4%
4	4	MEMC Electronic Materials (consolidated)	723.9	809.1	11.8%	12.9%
5	5	Komatsu Electronic Metals	482.7	556.1	15.2%	8.9%
6	6	Toshiba Ceramics	246.3	270.8	9.9%	4.3%
7	7	LG-Siltron	224.0	263.3	17.6%	4.2%
8	8	Okmetic	53.6	56.4	5.2%	0.9%
9	9	Waferwork	26.0	29.3	12.5%	0.5%
10	11	Episil	17.3	21.1	22.0%	0.3%
-	-	All Other Companies	60.3	66.6	10.6%	1.1%
-	-	All Companies	5,663.8	6,261.0	10.5%	100.0%

Source: Gartner Dataquest (June 2004)

1 MEMC includes Taisil in this table.

如就國內市場而言，目前之主要矽晶圓廠商約有 10 家，其中中德電子、台灣小松、合晶與中美矽晶是具備長晶、切片、研磨、拋光與清洗一貫製程的矽晶圓專業製造廠；台灣信越則只處理後段之拋光與清洗等製程；另外漢磊、嘉晶生產磊晶晶圓；昇陽、金敏及尚志則生產再生晶圓。

(三)技術及研發概況

1.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項目/年度	93 年度	94 年 1~4 月
研發支出	60,127	16,235
佔營業收入比率	3.92%	3.12%

2.開發成功之技術或產品

年度	項 目
92 年度	(A)建立以紅外線檢測 SOI 缺陷之技術與影像儲存技術 (B)建立雙面研磨(grinding)技術 (C)建立 SOI 元件層厚度測量技術
93 年度	(A)超低電阻摻紅磷晶棒 (B)低長晶 D-缺陷(COP)之高品質輕摻晶片 (C)超薄片雙拋晶片 (D)SOI 晶片製程開發 (E)2 吋 Sapphire 晶片技術開發

(四)長、短期業務發展計劃

1.短期發展計劃

(1)目標

成為世界最大的中小尺寸矽晶圓片生產供應商。

(2)策略

- A.建立一個善良負責的企業文化，使合晶對客戶、員工、股東及社會均能有所貢獻。
- B.深化核心技術之開發與投入，持久執著累積核心資源，以在科技事業不斷創新的環境中，隨時保持競爭優勢。
- C.建立品質系統(ISO/TS16949：2002)、環境系統(ISO-14001)、工業安全系統(OHSAS18001)及內稽內控系統，提供公司能安全快速成長的有效保障。
- D.提高自動化比率並建立 CAM 及 CIM 系統，強化生產效率及經營資訊管理功能。
- E.在半導體級矽產品方面，陸續擴充先進設備，以擴大規模經濟效益。至於太陽能級矽產品方面，在可掌握的矽多晶料下，快速擴充上海晶技產出。
- F.在半導體級矽晶圓方面，先集中資源，藉由重摻利基產品競爭優勢，迅速在市場打出知名度，使 Wafer Works 成為世界上重摻矽晶圓市場的知名品牌。

- G.利用重摻產品既有客戶，進一步循該管道銷售競爭較激烈之輕摻產品。
- H.與客戶建立互惠互惠、共存共榮的長期伙伴關係，使公司財產安全及穩健的成長。
- I.建立公司知名度，以利於吸收、留住人才，並能從資本市場取得公司成長所需之長期資金，協助公司達到成為一個世界最大中小尺吋矽晶圓生產供應商之目標。

2.長期發展計劃

(1)目標

成為世界級的電子材料生產供應商。

(2)發展策略

A.在垂直發展方面，執行如下三策略：

- a.開發中小尺吋各系列電阻、厚度、高附加價值晶片(如 SOI、Bonded Wafer、Diffused Wafer、EPI Wafer)，擴充產品線進而尋求提供現有大廠在中小尺吋矽晶圓產生光榮出局(Honor Exit)之服務機會。
- b.持續研發，俟 8 吋矽晶圓亦成為中小尺吋產品時，即迅速切入該市場，未來 12 吋市場亦同。
- c.利用子公司上海晶技透過不同品牌策略，積極擴充太陽能級矽晶圓相關產品市場，俾一方面能分享到全球太陽能產業快速成長的商機；另一方面使合晶在半導體級矽晶圓市場，已打下之良好口碑與品牌定位形象，仍能精益求精，隨著半導體市場成長而繼續加速成長，並能利用高檔半導體級技術，提升太陽能級產品競爭能力。

B.根據下列三主要原則，佈建水平發展商機：

- a.市場潛力大
- b.與本公司核心技術高度相關
- c.具競爭利基

C.在矽材料領域站穩及長期資金來源有所妥善規劃時，跨步前進，逐漸進入光電、通訊等其他材料領域，成為一個真正世界級的電子材料生產供應商。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區

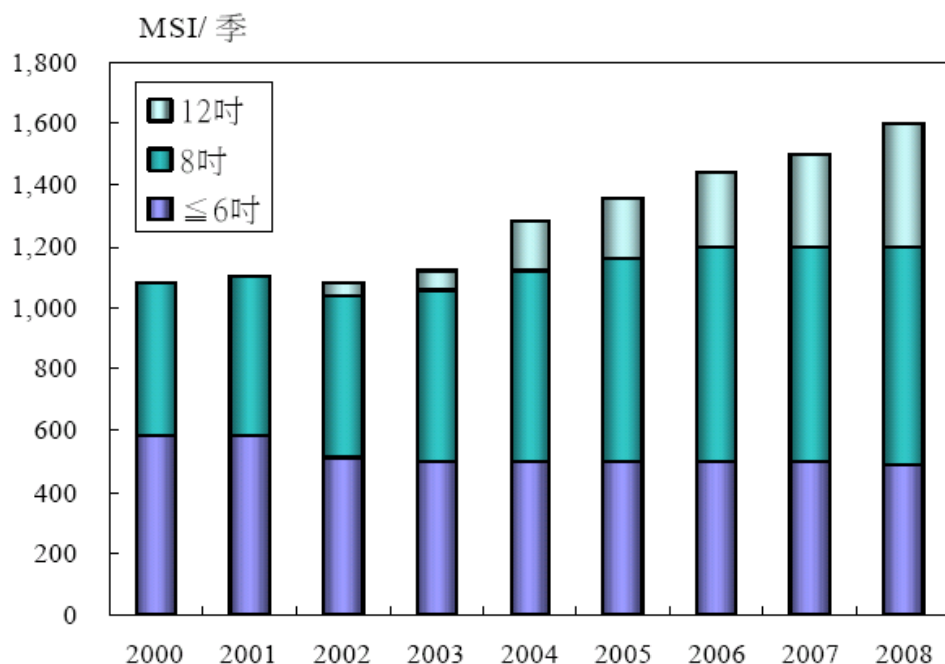
單位：新台幣仟元

銷售地區/年度	91 年度		92 年度		93 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
內銷	495,254	47.35	500,679	37.82	480,736	31.31
外銷						
美洲	289,924	27.72	357,538	27.01	480,528	31.29
歐洲	57,870	5.53	47,218	3.57	175,475	11.43
亞洲	202,933	19.40	418,293	31.60	398,723	25.97
小計	550,727	52.65	823,049	62.18	1,054,726	68.69
合計	1,045,981	100.00	1,323,728	100.00	1,535,462	100.00

2.市場未來供需狀況與成長性

就市場需求成長性方面，根據 Gartner Dataquest 以及工研院 IEK 整理的資料顯示，全球矽晶圓需求至 2008 年預估如下表。在市場供應方面，根據市場研究機構 The Information Network 於 2004 年底的報告中指出，半導體化學材料市場在 2004 年第四季達到高峰，2004 年市值約 130 億美元，較 2003 年成長 22.2%，而 2005 年半導體化學材料市場的市值為 140 億美元，年增率為 7.7%。其中空白矽晶圓在 2004 年的出貨金額成長 25.1%，為所有材料中成長最高的一類，在 2005 年仍可望維持成長比例最高，年增率達 8.8%。

全球矽晶圓廠產能需求趨勢



註：MSI (million of square inches)

資料來源：Gartner(2004/10)；工研院 IEK 整理(2005/01)

3. 競爭利基

(1) 獨立自主的研發能力

在高科技產業中，是否具備有獨立自主的研發能力，往往影響公司長遠的經營績效。擁有獨立自主的研發能力可使公司掌握自有自主的力量，另一方面，更是開創市場品牌，建立口碑及獲利的保證。本公司研發團隊，學經歷俱佳，具備自行研發新產品能力，小部分則委託國內大學研究，以加強公司之研發實力。

(2) 開發新產品符合未來發展趨勢

隨著 IC 設計朝向輕、薄、短、小及省電化的發展趨勢，行動通訊、資訊家電等產品無不力求節約能源消耗。本公司致力於開發利基型產品，並於 2000 年獲經濟部工業局通過「主導性新產品開發計畫」--低電阻矽基板產品開發，且已完成 6 吋重摻硼、重摻銻及重摻砷低電阻矽基板之開發，所開發之新產品符合未來矽晶圓材料發展趨勢，本項產品亦為本公司目前利基產品之一，另 2003 年本公司又獲經濟部工業局通過「微機電系統與智慧型電力元件之矽晶片開發計劃」研發獎勵，日前已開發完成了雙面拋光(Double Side Polishing)矽晶圓與絕緣層上的矽晶圓(SOI, Silicon on Insulator)，使得合晶成為國內第一家提供相關矽晶圓的上游原材料公司。

(3) 符合全球運籌模式之趨勢

本公司為服務各地區客戶之不同需求降低生產成本，除以美國孫公司為銷售據點，就近服務歐美地區，以便深耕歐美市場之外，並在上海亦設有工廠，利用當地低廉之人工成本，期望藉由降低生產成本、縮短交期加上台灣迅速的售後技術服務能力，強化產品競爭力，符合全球運籌模式之趨勢。

5. 發展遠景之有利及不利因素

(1) 有利因素

A. 產品發展符合市場需求趨勢

IC 半導體設計朝向輕薄短小省電化，行動通訊、資訊家電無不力求節約能源消耗及小型化、輕量化發展。本公司主力產品之低電阻及超薄矽基板能使 IC 半導體產品耗電量降低而達到節約能源及輕薄短小的設計目的。

B. 研發技術優良，產品品質穩定

本公司集合國內外矽晶圓材料專業人員，在矽晶圓材料研發已累積相當經驗，在技術上達到世界同步領先之水準。1999 年本公司通過 ISO-9002 認證，於 2001 年 6 月通過 QS-9000 及 SO-14001 認證，並於 2002 年 12 月通過 ISO-9001：2000 品質認證，再於 2005 年 1 月通過 ISO/TS16949：2002 認證，更是為產品高品質之保證。

C.積極拓展客戶，未來發展性強

本公司直接開拓台灣、日本、韓國、新加坡除中國大陸外亞洲客戶，北美孫公司則負責北美洲西部、西南部客戶，而大陸合資公司則服務中國大陸地區客戶。並透過北美東部及歐陸代理商耕耘當地市場。產品都以自有品牌"wafer works"，行銷世界，經銷網路廣泛，未來發展性強。

(2)不利因素及其因應對策

A.半導體市場每有供需失調情形，供過於求時經營艱苦

因應對策：

- a.與客戶保持聯繫、充分掌握未來需求，持續加速新產品開發速度，領先同業並提早進入市場，以獲取產品初期之較高利潤。
- b.提升自有品牌"wafer works"的知名度，產品追求高品質以爭取客戶信心，使產品由大量生產的價格取向，轉為高單價的客戶訂製材料的(ASW, Application Specific Wafer)。
- c.加強存貨管理，生管單位隨時依最新訂單及庫存水準，更新生產計劃，以控制存貨數量，避免大量屯積造成資金積壓。
- d.擴大轉投資公司上海晶技的太陽能級矽晶圓產能，除獲取太陽能產業迅速成長的商機利益外，並能平衡半導體市場景氣波動的影響。

B.產品多樣化，不利生產效能效率提升

因應對策：

- a.生產管理自動化，強化產銷協調能力，準確掌握產品交期，透過資訊系統隨時掌握市場需求變化，製造部門彈性調整生產計劃，以確實掌握交期滿足客戶需求，並同時能兼顧集中批量生產之效益。
- b.由於建立了產品品質、成本價格競爭優勢，已逐漸獲得許多世界上知名客戶的認證通過，爭取到相對較大量的訂單，而能提高生產效率。

C.原材料進口比例大，價格漲、跌及材料交期難掌握

因應對策：

- a.積極開發本地材料來源，避免進口材料交期、價格變動。
- b.爭取與上游供應商制定長期供應合約。
- c.定期檢討長期客戶訂單、價格，以反應實際原材料價格。

D.國內勞工不足，工資持續上揚，造成生產成本逐漸提高

因應措施：

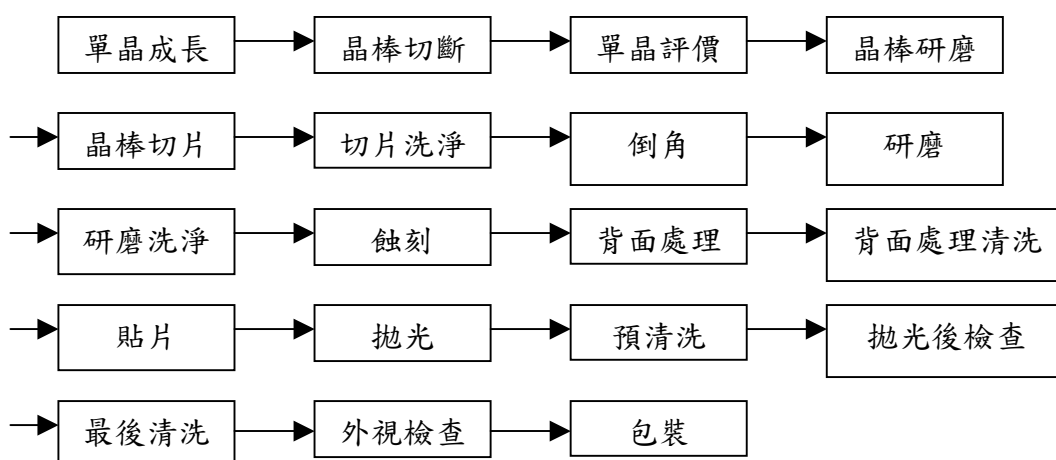
- a.引進高效率生產設備。
- b.國際分工，充分利用與大陸合資公司之比較利益，以應付市場擴充及彈性量產需求。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

矽晶圓材料是半導體製造廠最重要的起始材料，利用矽晶圓材料的半導體特性，若經過各種擴散、氣相沉積、顯氣、腐蝕、氧化等晶圓加工程序之後做出積體電路，再經測試、封裝而成各種 IC。本公司所製造的材料除了提供可以用來製造一般常見的 CMOS IC(如低密度記憶體、邏輯 IC 等)之外，另外針對電力電子產業亦提供低電阻矽基板材料。

2.產品之產製過程



(三)主要原料供應狀況

本公司主要產品為 4、5 及 6 吋矽晶圓等，其主要原料包括晶塊及產製過程所需之耗材等，其主要原材料之供應代理商名稱及供應狀況整理如下表所示：

主要原料	供應商	供應狀況
矽多晶料	Tokuyama、Asimi、 Hemlock、Wacker	良好
研磨粉及拋光漿	Fujimi	良好
坩堝	General EL	良好

(四)主要進銷貨廠商名單

1.最近二年度佔進貨總額 10%以上供應商資料

單位：新台幣仟元

項目	92 年度			93 年度		
	名稱	金額	占全年度進貨 淨額比率(%)	名稱	金額	占全年度進貨 淨額比率(%)
1	Tokuyama	125,923	20.46	上海合晶	149,509	17.19
2	Helitek	123,639	20.10	Tokuyama	115,351	13.26

2.最近二年度佔銷貨總額 10%以上銷貨客戶資料

單位：新台幣仟元

項目	92 年度			93 年度		
	客戶名稱	銷貨金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)
1	A	336,152	25.39	A	429,452	27.97
2	B	144,377	10.91			

(五)最近二年度生產量值

單位：仟片；新台幣仟元

主要商品	年度	92 年度			93 年度		
		產能	產量	產值	產能	產量	產值
4 吋矽晶圓		-	1,129	228,722	-	1,134	238,155
5 吋矽晶圓		-	752	287,418	-	840	304,556
6 吋矽晶圓		-	802	408,790	-	1,114	543,400
其他		-	175	20,252	-	212	53,137
合計		-	2,858	945,182	-	3,301	1,139,248
合計 (仟平方英吋)		60,000	51,629	-	71,000	62,241	-

註：本公司生產設備適用於 4、5、6 吋產品，按客戶訂單彈性安排生產，故無法區分產品別之產能，而以總產能(仟平方英吋)計之。

(六)最近二年度銷售量值表

單位：仟片；新台幣仟元

	92 年度				93 年度			
	內 銷		外 銷		內 銷		外 銷	
	量	值	量	值	量	值	量	值
4 吋矽晶圓	576	177,644	645	233,624	600	187,597	644	207,617
5 吋矽晶圓	214	89,251	580	301,711	204	83,369	633	288,497
6 吋矽晶圓	369	229,220	443	248,694	372	197,858	783	447,683
其他	10	4,564	177	39,020	18	11,912	244	110,929
合 計	1,169	500,679	1,845	823,049	1,194	480,736	2,304	1,054,726

三、最近二年度從業員工人數

年度		92 年度	93 年度	94 年截至 4 月 30 日
員工人數	管理人員	108	118	127
	研發技術人員	50	51	52
	作業人員	211	251	235
	合計	369	420	414
平均年歲		31	32	32
平均服務年資		2.3	2.4	2.6
學歷分布比率	博士(%)	1.90	1.91	1.94
	碩士(%)	8.94	8.81	8.94
	大專(%)	50.95	52.86	55.07
	高中(%)	37.13	35.71	33.33
	高中以下(%)	1.08	0.71	0.72

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受之損失(包括賠償)，處分之總額，並揭露其未來因應對策及可能之支出：無。

五、勞資關係

(一)公司員工福利、退休制度與其實施情形及勞資間之協議情形：

1.員工福利措施：

- (1)員工入股分紅。
- (2)團體保險。
- (3)年節獎金：端午節及中秋節。
- (4)年終獎金。
- (5)福利金補助：結婚、生育、死亡、嚴重傷病、災變、重大事故等。
- (6)教育訓練。
- (7)福利委員會提供：員工旅遊、社團活動、生日禮券、勞動節禮券。

2.退休制度

本公司依據勞動基準法制定退休金辦法，並於民國八十八年經桃園縣政府八八府勞動字第 055925 號函核准設立勞工退休準備金監督委員會，自八十八年度起按月提撥勞工退休基金至中央信託局專戶儲存及辦理員工退休事宜。

3.勞資間之協議情形：

本公司自成立以來勞資雙方關係和諧，勞資雙方權利義務均依據本公司工作規則各項辦理，每月並定期有勞資會議之舉行，勞方及資方代表各半，以討論、協商有關勞動條件之調整，勞資雙方互利互惠等相關事宜。

(二)最近年度迄年報刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

本公司設有完善之管理制度及溝通管道，勞資雙方關係良好無重大勞資糾紛之情事。

六、重要契約：目前仍有效存續及最近一年度到期之供銷、技術合作、工程、長期借款契約及其他足以影響投資人權益之重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
長期借款合同	中華開發	92.12.05~95.12.05	機器設備擔保貸款	負債比率不得高於 1.56 流動比率不得低於 1
長期借款合同	大眾銀行 新竹分行	94.02.04~96.02.04	信用借款	無
長期借款合同	玉山銀行	93.06.18~96.06.18	信用借款	無
長期借款合同	中華銀行 新竹分行	93.07.15~96.07.15	信用借款	無
長期借款合同	建華銀行 中壢分行	93.08.03~96.08.03	企業貸款債權證券化貸款	負債比率不得高於 1.50 流動比率不得低於 1
促進產業研究 發展貸款合約 暨計劃書	經濟部工業局	93.10.21~99.01.15	微機電系統與智慧型電力元 件之矽晶片開發計劃	開發計劃應限期完成
長期借款合同	台灣工銀 竹科分行	93.12.06~96.12.06	機器設備抵押貸款	無
長期借款合同	新竹商銀	94.01.14~97.01.14	信用借款	速動比率、流動比率、 財務槓桿、一年內到期 長期負債支付能力、利 息保障權等相關財務 比率與貸款時提供之 財務報表比較不得有 三項(含)以上已衰退逾 30%者
長期借款合同	合作金庫 中壢分行	94.03.17~99.03.17	信用借款	無
長期借款合同	台新商銀 新科分行	94.03.31~97.03.31	信用借款	負債比率不得高於 1.10 流動比率不得低於 1

肆、資金運用計畫及執行情形

一、計畫內容

前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年已完成且計畫效益尚未顯現者之分析：

前次公司債計畫內容：

(1)核准日期及文號：財政部證券暨期貨管理委員會 93 年 4 月 20 日台財證一字第 0930113132 號函。

(2)本計畫所需資金總額：新台幣二億元。

(3)資金來源：發行國內第一次無擔保轉換公司債新台幣二億元，年期五年，票面利率 0%。

(4)計畫項目、資金運用進度及預計可能產生之效益如下：

單位:新台幣仟元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	資金預定運用進度				
			93 年			94 年	
			第二季	第三季	第四季	第一季	第二季
償還銀行借款	93 年第二季	\$50,000	\$50,000	\$-	\$-	\$-	\$-
購買機器設備	94 年第二季	150,000	35,000	50,000	30,000	20,000	15,000
合計		\$200,000	\$85,000	\$50,000	\$30,000	\$20,000	\$15,000

預計可能產生效益：

1.償還銀行借款

預計九十三年四月募足可轉換公司債，流動比率及速動比率將由九十二年十二月三十一日 112.76%、70.42%分別提升至九十三年十二月三十一日之 171.83%、114.40%。九十三年度以募得之資金償還銀行借款後，可節省利息支出 723 仟元。九十三年度及以後年度以轉換公司債全數轉換之假設前提下，預計每年可節省利息支出 1,085 仟元。

2.購買機器設備

預計新機器設備投入生產後，產能由每月相當六吋 20 萬片擴充至每月 25 萬片，九十三年度營業收入及營業毛利分別增加 151,000 仟元及 33,000 仟元，九十四年度可使營業收入及營業毛利分別增加 360,000 仟及 79,000 仟元。

二、執行情形：本公司第一次國內無擔保轉換公司債於 93 年 5 月 17 日資金募集完成，截至年報刊印日止本次計畫已執行完畢。

伍、財務概況

一、最近五年度簡明財務資料

(一)簡明資產負債表

單位：仟元

項 目	年 度	最近五年度財務資料(註1)					截至94年 3月31日
		89年	90年	91年	92年	93年	
流動資產		413,873	414,977	549,246	757,627	927,427	1,127,873
基金及長期投資		523,053	441,098	404,458	487,005	630,715	647,569
固定資產		1,534,680	1,456,614	1,386,765	1,340,607	1,401,886	1,402,250
無形資產		51	-	-	-	-	-
其他資產		36,683	53,547	53,702	85,083	107,944	111,080
資產總額		2,508,340	2,366,236	2,394,171	2,670,322	3,067,972	3,288,772
流動負債	分配前	622,963	563,247	793,265	671,902	524,174	493,139
	分配後	622,963	563,247	793,265	671,902	註2	註2
長期負債		244,153	274,978	164,666	332,872	664,020	897,160
其他負債		-	2,235	6,815	11,086	83,000	83,930
負債總額	分配前	867,116	840,460	964,746	1,015,860	1,271,194	1,474,229
	分配後	867,116	840,460	964,746	1,015,860	註2	註2
股本		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,545,000	1,545,000
資本公積		230,331	230,331	230,421	230,421	68,505	68,505
保留盈餘	分配前	(126,245)	(260,764)	(348,437)	(117,810)	246,179	271,679
	分配後	(126,245)	(260,764)	(348,437)	(117,810)	註2	註2
長期股權投資未實現跌價損失		-	-	-	-	-	-
累積換算調整數		37,138	56,209	53,758	43,404	6,161	(1,574)
未認列為退休金成本之淨損失		-	-	-	-	-	-
庫藏股票		-	-	(6,317)	(2,347)	(69,067)	(69,067)
股東權益總額	分配前	1,641,224	1,525,776	1,429,425	1,654,462	1,796,778	1,814,543
	分配後	1,641,424	1,525,776	1,429,425	1,654,462	註2	註2

註1：以上各年度之財務報表均經會計查核簽證。

註2：九十三年度尚未經股東會決議，故無盈餘分配。

(二)簡明損益表

項目	年度	最近五年度財務資料(註1)					截至94年 3月31日
		89年	90年	91年	92年	93年	
營業收入		698,597	688,522	1,045,981	1,323,728	1,535,462	381,749
營業毛利(損)		(26,283)	25,127	108,209	292,595	368,927	45,313
營業(損)益		(135,441)	(85,086)	(12,551)	149,418	188,513	6,070
營業外收入及利益		59,218	23,803	11,263	40,133	91,347	34,610
營業外費用及損失		(45,440)	(73,236)	(86,385)	(33,924)	(33,681)	(15,180)
繼續營業部門稅前(損)益		(121,663)	(134,519)	(87,673)	155,627	246,179	25,500
繼續營業部門(損)益		(96,663)	(134,519)	(87,673)	230,627	246,179	25,500
本期損益		(96,663)	(134,519)	(87,673)	230,627	246,179	25,500
每股盈餘(元)(註2)		(0.65)	(0.87)	(0.56)	1.50	1.61	0.17

註1：以上各年度財務報表均經會計師查核簽證。

註2：每股盈餘係按各年度盈餘及資本公積轉增資後之增資比例追溯調整，以發行流通在外之普通股加權平均股數計算。

(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

1.最近五年度簽證會計師

年度	簽證會計師	查核意見
八十九年度	鄧泗堂、洪茂益	修正式無保留意見
九十年年度	鄧泗堂、洪茂益	修正式無保留意見
九十一年度	鄧泗堂、洪茂益	修正式無保留意見
九十二年年度	鄧泗堂、張志銘	修正式無保留意見
九十三年度	洪茂益、張志銘	修正式無保留意見

註：採權益法評價之長期股權投資經其他會計師查核，故會計師出具修正式無保留意見。

2.最近五年度更換簽證會計師之說明

因致遠會計師事務所內部工作調整，故負責簽證本公司財務報表之會計師，自民國九十三年十二月三十一日之財務報表起由原鄧泗堂會計師及張志銘會計師改為洪茂益會計師及張志銘會計師。

二、最近五年度財務分析

項目	年度	最近五年度財務資料					截至 94 年 3 月 31 日	
		89 年	90 年	91 年	92 年	93 年		
財務結構 (%)	負債占資產比率	34.57	35.52	40.30	38.04	41.43	44.83	
	長期資金占固定資產比率	122.85	123.63	114.95	148.24	175.53	193.38	
償債能力 (%)	流動比率(%)	66.44	73.68	68.85	112.76	176.93	228.71	
	速動比率(%)	39.09	46.60	46.54	70.42	85.62	131.20	
	利息保障倍數(倍)	(1.92)	(2.07)	(1.08)	5.67	13.87	5.13	
經營能力	應收款項週轉率(次)	6.37	4.41	5.43	4.85	4.90	4.88	
	平均收現日數	57	83	67	75	74	75	
	存貨週轉率(次)	5.17	3.65	4.95	4.43	3.26	2.94	
	應付款項週轉率(次)	9.35	7.76	17.05	17.02	10.67	9.30	
	平均售貨日數	71	100	74	82	112	124	
	固定資產週轉率(次)	0.48	0.46	0.74	0.97	1.12	1.09	
	總資產週轉率(次)	0.30	0.28	0.44	0.52	0.54	0.48	
獲利能力	資產報酬率(%)	(2.84)	(4.17)	(2.35)	10.10	9.08	0.04	
	股東權益報酬率(%)	(6.68)	(8.50)	(5.93)	14.96	14.27	5.65	
	占實收資本 比率 %	營業利益	(9.03)	(5.67)	9.99	12.20	1.57	1.57
		稅前純益	(8.11)	(8.97)	10.01	15.93	6.60	6.60
	純益率(%)	(13.84)	(19.54)	(8.38)	17.42	16.03	6.68	
	每股盈餘(元)(註 2)	(0.65)	(0.87)	(0.59)	1.50	1.61	0.17	
現金流量	現金流量比率(%)	(16.75)	5.69	(4.53)	32.76	60.98	(7.20)	
	現金流量允當比率(%)	(19.25)	(16.51)	(17.26)	(9.61)	34.66	48.98	
	現金再投資比率(%)	(5.03)	1.49	(1.70)	8.15	9.28	(1.14)	
槓桿度	營運槓桿度	(0.73)	(1.94)	(24.24)	3.18	3.23	13.40	
	財務槓桿度	-0.76/-1	-0.66/-1	-0.23/-1	1.29	1.11	(62.58)	

註 1：以上各年度財務報表均經會計師查核簽證。

註：分析項目之計算公式如下：

1 財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額

(2)長期資金佔固定資產比率＝(股東權益淨額＋長期負債)／固定資產淨額

2 償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債

(2)速動比率＝(流動資產－存貨－預付費用)／流動負債

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出

3 經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／
各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本／
各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額

(5)平均售貨日數＝365／存貨週轉率

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額／固定資產淨額

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／資產總額

4 獲利能力

(1)資產報酬率＝【稅後損益＋利息費用×(1－稅率)】／平均資產總額

(2)股東權益報酬率＝稅後損益／平均股東權益淨額

(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額

(4)每股盈餘＝(稅後淨利－特別股股利)／加權平均已發行股數

5 現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債

(2)現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本
支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(固定資產毛額＋其他
資產＋營運資金)

6 槓桿度

(1)營運槓桿度＝(銷貨收入淨額－變動營業成本及費用)／營業利益

(2)財務槓桿度＝營業利益／(營業利益－利息費用)

三、最近年度財務報告之監察人審查報告

合晶科技股份有限公司 監察人審查報告書

茲准

董事會造送本公司九十三年度經致遠會計師事務所洪茂益、張志銘會計師查核簽證之財務報表(包含資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表)，暨營業報告書，經本監察人等審查認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二百零一十九條之規定，報請 鑒察。

此 上

本公司九十四年度股東常會

合晶科技股份有限公司

監 察 人：陳致遠

監 察 人：李志鴻

中華民國九十四年 三 月 三十 日

四、最近年度財務報表

合晶科技股份有限公司 會計師查核報告

合晶科技股份有限公司民國九十三年十二月三十一日及民國九十二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十三年一月一日至十二月三十一日及民國九十二年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。上開財務報表中透過子公司間接轉投資持股 100% 而採權益法評價之被投資公司 Helitek Company Ltd.，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，有關 Helitek Company Ltd. 財務報表所列示之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國九十三年十二月三十一日及民國九十二年十二月三十一日透過子公司對 Helitek Company Ltd. 長期投資之金額分別為新台幣 214,881 仟元及 242,621 仟元，分別占合晶科技股份有限公司資產總額之 7.00% 及 9.09%，民國九十三年一月一日至十二月三十一日及民國九十二年一月一日至十二月三十一日分別間接認列投資(損)益新台幣(23,161)仟元及 15,174 仟元，分別占合晶科技股份有限公司稅前淨利之(9.41)% 及 9.75%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達合晶科技股份有限公司民國九十三年十二月三十一日及民國九十二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十三年一月一日至十二月三十一日及民國九十二年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

另合晶科技股份有限公司業已編製民國九十三年度及民國九十二年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此 致

合晶科技股份有限公司 公鑒

致遠會計師事務所
證期局核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(87)台財證(六)第 65315 號
(91)台財證(六)第 144183 號

洪茂益

會計師

張志銘

中華民國九十四年二月二十五日

合晶科技股份有限公司
資產負債表
民國九十三年十二月三十一日
及民國九十二年十二月三十一日
(金額均以新台幣仟元為單位)

資 產			九十二年十二月三十一日		九十二年十二月三十一日		負債及股東權益			九十二年十二月三十一日		九十二年十二月三十一日	
代碼	會計科目	附註	金 額	%	金 額	%	代碼	會計科目	附註	金 額	%	金 額	%
1100	流動資產						2100	流動負債					
1100	現金及約當現金	二及四.1	\$42,696	1.39	\$46,083	1.72	2100	短期借款	四.8及六	\$99,453	3.24	\$289,962	10.86
1120	應收票據淨額	二及四.2	3,052	0.10	8,158	0.30	2110	應付短期票券淨額	四.9	39,985	1.30	49,971	1.87
1140	應收帳款淨額	二、四.3及六	227,558	7.42	208,530	7.81	2120	應付票據		4,750	0.15	-	-
1153	應收帳款－關係人	五	72,123	2.35	104,913	3.93	2140	應付帳款		113,106	3.69	59,802	2.24
1160	其他應收款	二及十.2	14,755	0.48	12,087	0.45	2150	應付帳款－關係人	五	30,382	0.99	11,623	0.43
1180	其他應收款－關係人	五	50,051	1.63	26,717	1.00	2170	應付費用	二及四.12	94,524	3.08	70,728	2.65
1210	存貨淨額	二及四.4	434,690	14.17	251,736	9.43	2224	應付設備款		29,284	0.96	9,528	0.36
1250	預付款項	五	43,932	1.43	32,728	1.23	2272	一年內到期之長期借款	四.11及六	111,468	3.63	178,324	6.68
1280	其他流動資產		854	0.03	11,025	0.41	2280	其他流動負債	二、五及十.2	1,222	0.04	1,964	0.07
1286	遞延所得稅資產淨額	二及四.19	30,016	0.98	41,000	1.54		流動負債合計		524,174	17.08	671,902	25.16
1291	受限制銀行存款	六	7,700	0.25	14,650	0.55							
	流動資產合計		927,427	30.23	757,627	28.37	2400	長期負債					
1400	基金及長期投資	二及四.5					2410	應付公司債	二及四.10	200,928	6.55	-	-
1421	長期股權投資						2420	長期借款	四.11及六	463,092	15.09	332,872	12.46
142101	採權益法認列之長期投資		630,715	20.56	487,005	18.24		長期負債合計		664,020	21.64	332,872	12.46
1500	固定資產	二、四.6、 五、六及七					2800	其他負債					
1501	土地		259,131	8.45	259,131	9.70	2810	應計退休金負債	二及四.12	5,856	0.19	3,986	0.15
1521	房屋及建築物		210,409	6.86	210,409	7.88	2881	遞延貸項	二及四.5	77,144	2.52	7,100	0.27
1531	機器設備		1,521,903	49.61	1,401,112	52.47		其他負債合計		83,000	2.71	11,086	0.42
1551	運輸設備		4,371	0.14	3,826	0.14		負債合計		1,271,194	41.43	1,015,860	38.04
1561	辦公設備		31,829	1.03	27,299	1.02	3100	股本	四.13				
1681	什項設備		47,383	1.54	26,574	1.00	3110	普通股		1,545,000	50.36	1,500,000	56.17
	成本合計		2,075,026	67.63	1,928,351	72.21	3200	資本公積	四.14				
15x9	減：累計折舊		(901,787)	(29.39)	(701,223)	(26.26)	3211	普通股股票溢價		67,521	2.20	230,331	8.63
1671	未完工程		23,007	0.75	5,818	0.22	3220	庫藏股票交易		984	0.03	884	0.03
1672	預付設備款		205,640	6.70	107,661	4.03	3300	保留盈餘					
	固定資產淨額		1,401,886	45.69	1,340,607	50.20	3351	累積盈虧	四.15	246,179	8.03	(117,810)	(4.41)
1800	其他資產						3400	股東權益其他項目					
1820	存出保證金		437	0.01	335	0.01	3420	累積換算調整數	二	6,161	0.20	43,404	1.63
1830	遞延費用	二	37,294	1.22	25,748	0.97	3510	庫藏股票	二及四.16	(69,067)	(2.25)	(2,347)	(0.09)
1832	債券發行成本		229	0.01	-	-		股東權益合計		1,796,778	58.57	1,654,462	61.96
1848	催收款項淨額	二及四.7	-	-	-	-							
1860	遞延所得稅資產淨額	二及四.19	69,984	2.28	59,000	2.21							
	其他資產合計		107,944	3.52	85,083	3.19							
	資產總計		\$3,067,972	100.00	\$2,670,322	100.00		負債及股東權益總計		\$3,067,972	100.00	\$2,670,322	100.00

(請參閱財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

合晶科技股份有限公司
損益表
民國九十三年一月一日至十二月三十一日
及民國九十二年一月一日至十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，均以新台幣仟元為單位)

代碼	項 目	附註	九十三年度		九十二年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入					
4110	銷貨收入		\$1,504,452	97.98	\$1,308,168	98.82
4170	減：銷貨退回及折讓		(8,006)	(0.52)	(18,019)	(1.36)
	銷貨淨額		1,496,446	97.46	1,290,149	97.46
4600	勞務收入		39,016	2.54	33,579	2.54
	營業收入淨額	二、四.17及五	1,535,462	100.00	1,323,728	100.00
5000	營業成本	五	(1,171,444)	(76.29)	(1,028,533)	(77.70)
5900	營業毛利		364,018	23.71	295,195	22.30
5920	聯屬公司(未)實現利益	二	4,909	0.32	(2,600)	(0.20)
	已實現營業毛利		368,927	24.03	292,595	22.10
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(48,274)	(3.14)	(37,023)	(2.80)
6200	管理及總務費用		(72,013)	(4.69)	(62,769)	(4.74)
6300	研究發展費用		(60,127)	(3.92)	(43,385)	(3.27)
	營業費用合計		(180,414)	(11.75)	(143,177)	(10.81)
6900	營業淨利		188,513	12.28	149,418	11.29
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		169	0.01	249	0.02
7121	按權益法認列之投資收益	二及四.5	63,617	4.14	13,846	1.05
7130	處分固定資產利益	二及五	233	0.01	25	-
7140	處分投資利益	二	-	-	13	-
7150	存貨盤盈		30	-	-	-
7160	兌換利益	二及十.2	-	-	263	0.02
7260	存貨跌價回升利益	二	-	-	12,500	0.94
7480	其他收入	二、四.5及五	27,298	1.78	13,237	1.00
	營業外收入及利益合計		91,347	5.94	40,133	3.03
7500	營業外費用及損失					
7510	利息支出		(19,134)	(1.25)	(33,341)	(2.51)
7530	處分固定資產損失	二	(5)	-	-	-
7550	存貨盤損		-	-	(71)	(0.01)
7560	兌換損失	二及十.2	(8,831)	(0.57)	-	-
7570	存貨跌價及呆滯損失	二	(4,463)	(0.29)	-	-
7880	其他損失		(1,248)	(0.08)	(512)	(0.04)
	營業外費用及損失合計		(33,681)	(2.19)	(33,924)	(2.56)
7900	本期稅前淨利		246,179	16.03	155,627	11.76
8110	所得稅利益	二及四.19	-	-	75,000	5.66
9600	本期淨利		\$246,179	16.03	\$230,627	17.42
9950	基本每股盈餘(元)：	二及四.20				
7900	本期稅前淨利		\$1.61		\$1.01	
8110	所得稅利益		-		0.49	
9600	本期淨利		\$1.61		\$1.50	
9850	稀釋每股盈餘(元)：	二及四.20				
9810	本期淨利		\$1.55			
8111	所得稅費用		-			
9850	本期淨利		\$1.55			
	假設晶材科技股份有限公司對合晶科技股份有限公司股票之投資不視為庫藏股票之擬制資料：	二及四.20				
9600	本期淨利		\$246,279		\$231,421	
9950	基本每股盈餘(元)	二及四.20				
9910	本期淨利		\$1.61		\$1.50	
9850	稀釋每股盈餘(元)：					
9810	本期淨利		\$1.55			

(請參閱財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

合晶科技股份有限公司

股東權益變動表

民國九十三年一月一日至十二月三十一日
及民國九十二年一月一日至十二月三十一日

(金額均以新台幣仟元為單位)

項 目	附註	股 本	資本公積	累積虧損	累積 換算調整數	庫藏股票	合 計
民國九十二年一月一日餘額		\$1,500,000	\$230,421	\$(348,437)	\$53,758	\$(6,317)	\$1,429,425
子公司出售庫藏股票	二		794			3,970	4,764
外幣報表換算調整數	二				(10,354)		(10,354)
九十二年度淨利				230,627			230,627
民國九十二年十二月三十一日餘額		1,500,000	231,215	(117,810)	43,404	(2,347)	1,654,462
資本公積彌補虧損	四.14		(117,810)	117,810			-
資本公積轉增資	四.13	45,000	(45,000)				-
購入庫藏股	二					(67,220)	(67,220)
子公司出售庫藏股票	二		100			500	600
外幣報表換算調整數	二				(37,243)		(37,243)
九十三年度淨利				246,179			246,179
民國九十三年十二月三十一日餘額		<u>\$1,545,000</u>	<u>\$68,505</u>	<u>\$246,179</u>	<u>\$6,161</u>	<u>\$(69,067)</u>	<u>\$1,796,778</u>

(請參閱財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

合晶科技股份有限公司
現金流量表
民國九十三年一月一日至十二月三十一日
及民國九十二年一月一日至十二月三十一日
(金額均以新台幣仟元為單位)

項 目	九十三年度	九十二年度	項 目	九十三年度	九十二年度
營業活動之現金流量：			投資活動之現金流量：		
本期淨利	\$246,179	\$230,627	短期投資(增加)減少	-	13
調整項目：			受限制銀行存款(增加)減少	6,950	(3,396)
折舊費用	203,738	182,999	長期股權投資增加	(36,429)	(74,291)
各項攤提	32,264	24,294	購置固定資產	(248,923)	(138,217)
處分投資利益	-	(13)	出售固定資產	3,890	620
採權益法認列之投資損失(收益)	(63,617)	(13,846)	存出保證金(增加)減少	(102)	(100)
處分固定資產損(益)	(228)	(25)	遞延費用(增加)減少	(43,708)	(21,575)
估列公司債應付利息補償金	928	-	債券發行成本增加	(331)	-
遞延貸項轉列其他收入	(5,354)	-	投資活動之淨現金流入(出)	(318,653)	(236,946)
應收票據淨額(增加)減少	5,106	484			
應收帳款淨額(增加)減少	(19,028)	(59,054)	融資活動之現金流量：		
應收帳款－關係人(增加)減少	32,790	(39,562)	舉借(償還)短期借款	(190,509)	(227,032)
其他應收款(增加)減少	(2,668)	(11,668)	應付短期票券增加(減少)	(9,986)	(9,512)
其他應收款－關係人(增加)減少	(23,334)	28,542	舉借(償還)長期借款	63,364	248,135
存貨淨額(增加)減少	(182,954)	(79,902)	發行可轉換公司債	200,000	-
預付款項(增加)減少	(11,204)	(10,738)	購入庫藏股	(67,220)	-
其他流動資產(增加)減少	10,171	2,690	融資活動之淨現金流入(出)	(4,351)	11,591
遞延所得稅資產－流動(增加)減少	10,984	(41,000)			
遞延所得稅資產－非流動(增加)減少	(10,984)	(34,000)	本期現金及約當現金(減少)增加數	(3,387)	(5,223)
應付票據增加(減少)	4,750	(1,000)	期初現金及約當現金餘額	46,083	51,306
應付帳款增加(減少)	53,304	14,536	期末現金及約當現金餘額	\$42,696	\$46,083
應付帳款－關係人(減少)增加	18,759	8,441			
應付費用(減少)增加	23,796	17,306	現金流量資訊之補充揭露：		
其他流動負債增加(減少)	(742)	(3,250)	本期支付利息(不含資本化利息)	\$18,296	\$33,276
應計退休金負債增加(減少)	1,870	1,671	本期支付所得稅	\$-	\$13
遞延貸項增加(減少)	(4,909)	2,600	支付現金購置固定資產		
			購置固定資產	\$268,679	\$137,436
			應付設備款(增加)減少	(19,756)	781
			支付現金	\$248,923	\$138,217
			不影響現金流量之投資及融資活動：		
			累積換算調整數增加(減少)數	\$(37,243)	\$(10,354)
			一年內到期之長期借款	\$111,468	\$178,324
			長期股權投資轉列庫藏股票	\$1,847	\$2,347
			被投資公司出售本公司股票產生之資本公積	\$100	\$794
			技術作價轉列長期股權投資	\$80,307	\$-
營業活動之淨現金流入(出)	319,617	220,132			

(請參閱財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

合晶科技股份有限公司
財務報表附註
民國九十三年十二月三十一日
及民國九十二年十二月三十一日
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

一、公司沿革

合晶科技股份有限公司(以下簡稱本公司)於民國八十六年七月二十四日奉准設立。

本公司主要業務為：

1. 半導體及其材料之研發、設計、製造、進出口及代理銷售。
2. 半導體晶圓材料及晶圓加工設備與零組件之設計、加工、進出口銷售及售後服務。
3. 前各項產品之技術移轉及其諮詢顧問業務。

本公司股票於民國九十一年五月十三日經櫃檯買賣中心(九一)證櫃上字第一八三六四號函核准上櫃，並自民國九十一年五月十六日起於櫃檯買賣中心開始櫃檯買賣。

本公司民國九十三及九十二年十二月三十一日之員工人數分別為 442 人及 366 人。

二、重要會計政策之彙總說明

本財務報表係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製。重要會計政策彙總說明如下：

1. 外幣財務報表換算及外幣交易

(1)本公司之子公司(Wafer Works Investment Corp.)記帳貨幣即為其功能性貨幣，外幣財務報表換算為本國貨幣財務報表時，資產、負債科目均按資產負債表日之匯率換算；股東權益中除期初保留盈餘以上期期末換算後之餘額結轉外，其餘均按歷史匯率換算；股利按宣告之匯率換算；損益科目按加權平均匯率換算。依前段換算所產生之換算差額，列入「累積換算調整數」科目，作為股東權益之調整項目。

(2)本公司之交易事項係以新台幣為記帳單位。以外幣為計價基準之交易事項，係按交易發生時之匯率折算新台幣金額入帳，至資產負債表日未收取或未償付之外幣資產及負債，依財務會計準則公報第十四號規定，按該日之即期匯率予以調整，因調整而產生之兌換差額列為當期損益，另結清外幣資產或負債所產生之兌換差額亦列為當期損益。

合晶科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

2. 約當現金

約當現金係指隨時可轉換成定額現金，且即將到期而其利率變動對其價值影響甚小之投資，通常包括自投資日起三個月內到期或清償之國庫券、商業本票及銀行承兌匯票等。

3. 短期投資

短期投資係以取得成本為入帳基礎，成本之計算係採移動加權平均法，期末並按成本與市價孰低法評價。

4. 備抵呆帳

備抵呆帳係依據過去實際發生呆帳之經驗，衡量資產負債表日應收票據、應收帳款等各項債權之帳齡情形及其收回可能性予以評估提列。

5. 存 貨

存貨係採永續盤存制度，其成本之計算採加權平均法，期末則按成本與市價孰低法評價，比較成本與市價孰低時，係採總額法比較。市價之決定除在製品、製成品及商品係指淨變現價值外，餘係指重置成本。對於呆滯存貨則另提列備抵跌價損失。

6. 長期股權投資

- (1) 以取得成本為入帳基礎，並按一般公認會計原則之規定，分別採權益法或成本法予以評價。
- (2) 取得股票股利時，僅註記增加之股數，重新計算每股成本。股票出售時按加權平均法計算成本及出售損益。
- (3) 持有被投資公司表決權比例達20%或具有重大影響力，按權益法評價，並將帳列投資成本與股權淨值間之差額分二十年按年平均攤提，有關海外投資時外幣財務報表之換算依以下方式處理：
 - A. 若國外營運機構外幣財務報表之幣別非為功能性貨幣時，先將該外幣財務報表依功能性貨幣再衡量，再衡量所產生之兌換差額，列為當期損益。

合晶科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

- B. 國外營運機構之財務報表以功能性貨幣編製或再衡量後，若該功能性貨幣與本國貨幣不同時，需轉換為新台幣財務報表，其因換算產生之差額，列為「累積換算調整數」作為被投資公司股東權益之調整項目，本公司依持股比例承認之，並作為本公司股東權益之調整項目。
- (4) 本公司與採權益法評價之被投資公司間交易所產生之損益，於本年度尚未實現者，應加以消除；交易損益如屬折舊、折耗或攤銷性質之資產所產生者，依其效益年限分年承認；其餘之資產所產生者，俟實現年度始行認列。
- (5) 對持有股權比例超過百分之五十者，採權益法評價並編製合併報表，惟若被投資公司當年度總資產或營業收入未達本公司各該項金額百分之十，僅按權益法評價，不另編製合併報表，但所有未達編入合併報表標準之子公司合計總資產或營業收入已達本公司各該項金額百分之三十以上者，仍將總資產或營業收入達本公司各該項金額百分之三以上之子公司編入合併報表，嗣後除非所占比率降至百分之二十，否則仍繼續編入合併報表。

7. 固定資產

- (1) 現有固定資產均於購建時以成本入帳，重大改良及更新作為資本支出，列入固定資產，修理及維護支出則列作當年度費用。
- (2) 為新建及擴建工程與設備預付款項，於發生貸款後至財產達到可供使用狀態下的利息均予資本化。
- (3) 折舊係依所得稅法耐用年數表之年限，並預留殘值一年，以直線法計提。另已達耐用年限而繼續使用之設備，再按估計之耐用年限，並預留殘值一年，以直線法計提折舊。
- (4) 處分固定資產損益列為當年度之損益項目。

8. 遞延費用

係包括工廠電力、自來水工程裝置費及電腦軟體費與其他具有未來經濟效益之支出等，以實際發生成本為入帳基礎，並按一～十年平均攤提。

合晶科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

9. 衍生性金融商品交易

本公司為規避外幣債權債務之匯率變動風險，與銀行簽訂預售之遠期外匯買賣合約，並於訂約日以該日即期匯率衡量入帳，訂約日即期匯率與約定遠期匯率之差額，則於合約期間攤銷。至資產負債表日尚未結清之合約，則按資產負債表日之匯率調整，所產生之兌換損益列為當期損益。遠期外匯買賣合約所產生之應收及應付款項餘額互抵後，其差額列為資產或負債。遠期外匯買賣合約履約結清時所產生之兌換差額，列為結清年度之損益。

10. 退休金

本公司訂有員工退休辦法，自民國八十八年三月起，依「勞動基準法」之規定按每年已付薪資總額百分之二點三提撥退休準備金，並撥交由勞工退休準備金監督委員會專戶儲存及支用，由於此項退休準備金與本公司完全分離，故未包含於財務報表中。

本公司自八十七年底起，依照財務會計準則公報第十八號「退休金會計處理準則」，以八十七年十二月三十一日為衡量日完成精算，其累積給付義務超過退休基金資產公平價值部分，於資產負債表認列最低退休金負債，並自民國八十八年一月一日起認列淨退休金成本；有關未認列過渡性淨資產或淨給付義務係按十五年採直線法攤銷；未認列退休金損益係按十年採直線法攤銷。

11. 應付公司債

(1)附賣回權之轉換公司債約定賣回價格高於轉換公司債面額之利息補償金，於發行日至賣回權期間屆滿日之期間，按利息法認列利息費用並提列應付利息補償金。如債券持有人逾期未行使賣回權，致賣回權失效，則按利息法自約定賣回期限屆滿日次日起至到期日之期間攤銷已認列為負債之利息補償金。

(2)債券持有人行使轉換權利時，按帳面價值法處理，將該轉換公司債之發行成本、應付利息、債券持有人應繳回之債息、已認列之利息補償金負債及轉換公司債面額一併轉銷，並以該轉銷淨額超過債券換發普通股面額部份，列為資本公積。

12. 所得稅

所得稅估列係依財務會計準則公報第二十二號「所得稅之會計處理準則」之規定作跨期間與同期間之所得稅分攤。將應課稅暫時性差異所產生之所得稅影響數認列為遞延所得稅負債，與將可減除暫時性差異、虧損扣抵及所得稅抵減所產生之所得稅影響數認列為遞延所得稅資產，再評估其遞延所得稅資產之可實現性，認列其備抵評價金額。遞延所得稅資產或負債依其相關資產或負債之分類劃分為流

合晶科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

動或非流動項目，無相關之資產負債者，依預期回轉期間之長短期劃分為流動或非流動項目。

本公司未分配盈餘加徵百分之十營利事業所得稅部分，於股東會決議分配盈餘之日列為當期費用。

13. 收入認列

本公司之收入認列，係依照財務會計準則公報第三十二號「收入認列之會計處理準則」之規定處理。

14. 每股盈餘

本公司依財務會計準則公報第二十四號「每股盈餘」之規定計算每股盈餘。基本每股盈餘以普通股股東之本期淨利(損)除以普通股加權平均流通在外股數；稀釋每股盈餘則以普通股股東之本期淨利(損)調整具稀釋作用之潛在普通股之股利、具稀釋作用之潛在普通股於本期已認列之利息費用及具稀釋作用之潛在普通股因轉換而產生之任何其他收入與費用之變動後，除以普通股加權平均流通在外股數加上所有具稀釋作用之潛在普通股轉換為普通股之加權平均流通在外股數。

15. 庫藏股票

本公司依財務會計準則公報第三十號「庫藏股票會計處理準則」之規定，對於公司收回已發行股票作為庫藏股票時採成本法處理。本公司買回之庫藏股票成本在資產負債表作為股東權益減項。而庫藏股票交易之價差則作為資本公積調整列於股東權益項下；另本公司自民國九十一年一月一日起對於子公司晶材科技股份有限公司持有本公司股票之會計處理係依照財務會計準則第三十號公報「庫藏股票會計處理準則」規定視同庫藏股票處理之。

三、會計變動之理由及其影響

無此情形。

四、重要會計科目之說明

1. 現金及約當現金

	93.12.31	92.12.31
零用金	\$160	\$160
支票及活期存款	42,536	45,923
合 計	\$42,696	\$46,083

合晶科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

2. 應收票據淨額

	93.12.31	92.12.31
應收票據	\$3,052	\$8,158
減：備抵呆帳	-	-
淨 額	\$3,052	\$8,158

3. 應收帳款淨額

(1)

	93.12.31	92.12.31
應收帳款	\$228,610	\$209,530
減：備抵呆帳	(1,052)	(1,000)
淨 額	\$227,558	\$208,530

(2)有關質押情形請詳附註六。

4. 存貨淨額

(1) 存貨明細如下：

	93.12.31	92.12.31
原 料	\$132,119	\$35,752
物 料	85,141	53,699
在 製 品	154,746	111,148
製 成 品	78,802	60,185
商 品	2,345	4,952
合 計	453,153	265,736
減：備抵存貨跌價及呆滯損失	(18,463)	(14,000)
淨 額	\$434,690	\$251,736

(2) 民國九十三年及九十二年十二月三十一日存貨之投保金額分別為 260,000 仟元及 200,000 仟元。

(3) 上述存貨均未提供擔保或質押。

合晶科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

5. 長期股權投資

(1) 長期股權投資明細如下：

被投資公司名稱	持有股數	帳面價值	當期認列 投資(損)益	持股 比例
<u>93.12.31</u>				
<u>採權益法之長期投資</u>				
Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.	-	\$-	\$80,206	100.00%
Wafer Works Investment Corp.	19,769,600	621,088	(20,446)	100.00%
晶材科技股份有限公司	499,994	9,627	3,857	99.99%
合 計		<u>\$630,715</u>	<u>\$63,617</u>	
<u>92.12.31</u>				
<u>採權益法之長期投資</u>				
Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.	16,280,000	\$481,835	\$13,877	100.00%
晶材科技股份有限公司	499,994	5,170	(31)	99.99%
合 計		<u>\$487,005</u>	<u>\$13,846</u>	

(2) 民國九十三年及九十二年按權益法認列之投資損益，係採用該被投資公司經會計師查核之同期財務報表認列。

(3) 本公司為間接投資大陸需要，於民國九十三年度以現金 36,429 仟元及技術作價 80,307 仟元增加投資 Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.，是項投資案業奉經濟部投資審議委員會民國九十二年十二月十八日經審二字第○九二○三八六一六號函准予備查在案。

上述以技術作價取得長期股權投資係帳列遞延貸項 80,307 仟元，並預計於未來十年間投入技術服務時轉列其他收入，民國九十三年度已轉列其他收入 5,354 仟元，期末遞延貸項餘額為 74,953 仟元。

(4) 本公司於民國九十三年十二月間調整轉投資事業投資架構，將原本公司直接投資 Silicon Technology Investment (Cayman) Corp. 變更為由本公司透過投資設立 Wafer Works Investment Corp. 間接轉投資 Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.

合晶科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

(5) 本公司民國九十三年及九十二年持有 Wafer Works Investment Corp.及 Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.股權均達百分之五十以上，且其資產總額達本公司之百分之十，故依財務會計準則公報及證券發行人財務報告編製準則之規定，均予編製合併報表。另九十三年及九十二年持有晶材科技股份有限公司股權雖達百分之五十以上，但因其資產總額及營業收入均未達本公司各該項金額百分之十，故依財務會計準則公報及證券發行人財務報告編製準則之規定，得不編入合併報表。

(6) 上述長期股權投資均無提供作為擔保或質押之情形。

6. 固定資產

(1) 固定資產累計折舊之明細如下：

項 目	93.12.31	92.12.31
房屋及建築物	\$28,683	\$23,682
機器設備	828,732	641,647
運輸設備	3,150	2,688
辦公設備	21,827	19,345
什項設備	19,395	13,861
合 計	<u>\$901,787</u>	<u>\$701,223</u>

(2) 截至民國九十三年及九十二年十二月三十一日止，本公司固定資產投保保險金額分別為 1,350,000 仟元及 1,140,000 仟元。

(3) 民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日利息資本化明細如下：

	九十三年度	九十二年度
利息資本化前之利息總額	\$22,865	\$34,855
資本化利息之金額	3,731	1,514
資本化利率	2.90%	4.70%
資本化設備名稱	預付設備款	機器設備

(4) 上述固定資產提供擔保或質押情形請詳附註六。

合晶科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

7. 催收款淨額

	93.12.31	92.12.31
催收款	\$257	\$-
減：備抵呆帳	(257)	-
淨 額	\$-	\$-

8. 短期借款

	93.12.31	92.12.31
購料借款(一年內到期)	\$80,565	\$170,652
信用借款(一年內到期)	18,888	100,000
擔保借款(一年內到期)	-	19,310
合 計	\$99,453	\$289,962

(1) 民國九十三年及九十二年十二月三十一日短期借款之借款利率分別為 1.123%~3.533% 及 1.13%~2.85%。

(2) 提供短期借款之擔保品，請參閱財務報表附註六。

9. 應付短期票券淨額

應付短期票券淨額明細如下：

保證機構	發行期間	金 額	利率	擔保品
<u>93.12.31</u>				
商業本票：				
中華票券金融股份有限公司	93.11.15-94.01.14	\$30,000	1.152%	無
大中票券金融股份有限公司	93.11.09-94.01.07	10,000	1.110%	無
合 計		40,000		
減：應付短期票券折價		(15)		
淨 額		\$39,985		

合晶科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

92.12.31

商業本票：

合作金庫—中壢分行	92.11.17-93.1.16	\$30,000	1.17%	無
大眾銀行—新竹分行	92.11.18-93.1.16	20,000	1.00%	無
合 計		50,000		
減：應付短期票券折價		(29)		
淨 額		\$49,971		

10.應付公司債

(1)應付公司債明細如下：

	93.12.31	92.12.31
無擔保可轉換公司債面額	\$200,000	\$-
加：應付利息補償金	928	-
合 計	\$200,928	\$-

(2)本公司為配合償還借款及購置設備，於民國九十三年五月十九日發行國內第一次無擔保可轉換公司債，主要發行條款如下：

A.發行總額：

第一次發行公司債：發行總額新台幣 200,000 仟元，每張面額新台幣 100 仟元，依票面金額十足發行。

B.發行期間：發行期間五年，於民國 93 年 5 月 19 日發行，至 98 年 5 月 18 日到期。

C.債券票面利率及還本付息方式：票面利率 0%，除依轉換辦法規定轉換為本公司普通股者，或本公司提前贖回者，或債權人要求本公司提前贖回者外，到期時以現金一次還本。

D.擔保情形：

本轉換公司債為無擔保債券，惟如本轉換公司債發行後，本公司另發行其他有擔保附認股權或轉換公司債時，本轉換公司債亦將比照該有擔保附認股權或轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。

合晶科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

E.轉換期間：

債權人得於本轉換公司債發行之日起滿一個月後，至到期日前十日止，除依法暫停過戶期間及下列期間外，得隨時向本公司股務代理機構請求依發行及轉換辦法規定將所持有之本轉換公司債轉換為本公司新發行之普通股。

- (一)「本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽辦當年度無償配股基準日與配息基準日之公告日前三個營業日」後至「無償配股基準日與配息基準日(以較晚者)」之期間。
- (二)「本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽辦當年度現金增資認股基準日之公告日前三個營業日」後至「當年度現金增資認股基準日」之期間。
- (三)「本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽辦當年度之合併基準日之公告日前三個營業日」後至「當年度合併基準日」之期間，或「決定當年度之分割基準日之公告日前三個營業日」後至「當年度分割基準日」之期間。

F.轉換價格及其調整：

以民國九十三年五月五日為轉換價格基準日，依此計算發行時之轉換價格為20元。

本轉換公司債發行後，除本公司流通在外之具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份者外，遇有本公司已發行之普通股股份增加時(以低於轉換價格辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、員工紅利轉增資、公司合併、股票分割或現金增資參與發行海外存託憑證，但不包括本公司買回公司股份辦理銷除股份者)及有低於每股時價之轉換或認股價格再發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券，或非因辦理現金增資而賦與他人發行普通股認股權時，轉換價格依發行條款規定公式調整之。

截至民國九十三年十二月三十一日止，轉換價格已依上述規定修正為19.4元。

G.本公司對本轉換公司債之贖回權：

本轉換公司債發行滿一年後翌日起至發行期間屆滿前四十日止，於下列情形時：

合晶科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

- (1) 若本公司普通股在櫃檯買賣中心之收盤價連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之五十(含)其後三十個營業日內。
- (2) 本轉換公司債權人請求轉換後，其尚未轉換之債權總金額低於新台幣 20,000 仟元(發行總額之 10%)。

本公司得按以下之債券贖回收益率(自本債券發行日起至債券收回基準日止)計算收回價格，以現金收回其全部債券：

1. 發行滿一年後翌日起至發行滿二年之日(含)前，贖回價格訂為本債券面額加計按 0.75% 年收益率計算之利息補償金(自本債券發行日起，計算至贖回基準日止)。
2. 發行滿二年後之翌日起至本轉換公司債到期前四十日止，贖回價格訂為本債券面額。

- (3) 若債權人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前，未以書面回覆本公司股務代理機構(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳為憑)者，本公司得按當時之轉換價格，以通知期間屆滿日為轉換基準日，將其轉換公司債轉換為普通股。

H. 債券持有人之賣回權：

本公司應於本轉換公司債發行滿二年、三年及四年之前三十日，以掛號發給債權人一份「債券持有人賣回權行使通知書」，並函請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告本轉換公司債持有人賣回權之行使，債權人得於公告後三十日內以書面通知本公司股務代理機構(於送達時即生效力，並以該期間屆滿日為賣回基準日，採郵寄者以郵戳為憑)要求本公司以債券面額加計利息補償金(發行滿二年為債券面額之 101.5056%，收益率為 0.75%；發行滿三年、四年為債券面額之 100.00% 賣回，收益率為 0%)，將其所持有之本轉換公司債以現金贖回。

I. 受託人及重要約定：

- (1) 所有本公司收回(包括由次級市場買回)、償還或已轉換之本轉換公司債將被註銷，不再發行，其所表彰之轉換權利併同消滅。

合晶科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

- (2)本轉換公司債及所換發之普通股均為記名式，其過戶、異動登記、設質、遺失等均依「公開發行股票公司股務處理準則」之規定，另稅負事宜依當時之稅法之規定辦理。
- (3)本轉換公司債由建華銀行信託部為債權人之受託人，依發行及轉換辦法及受託契約代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行本轉換公司債發行事項之權利義務。
- (4)本轉換公司債由本公司股務代理機構辦理還本付息及轉換事宜。
- (5)凡持有本轉換公司債之債權人不論係於發行時認購或中途買受者，對於本公司與受託人之間所訂受託契約規定、受託人之權利義務及發行轉換公司債辦法，均予同意並授與受託人有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷，並同意授受本公司債發行及轉換辦理。至於受託契約內容，債權人得在規定營業時間內，隨時至本公司或受託人營業處所查閱。

11. 長期借款

- (1) 民國九十三年及九十二年十二月三十一日之長期借款內容如下：

債權人	利率		期間	借款金額	
	93.12.31	92.12.31		93.12.31	92.12.31
擔保借款	2.96%~3.60%	3.65%~5.715%	89.09.15- 99.01.15	\$178,615	\$310,136
信用借款	1.00%~3.40%	3.65%~5.50%	92.11.26- 96.06.18	395,945	201,060
合計				574,560	511,196
減：一年內到期之長期借款				(111,468)	(178,324)
一年以上到期之長期借款				\$463,092	\$332,872

- (2) 上述長期借款按月(季)平均攤還本金，而對台新銀行一新科分行則為借款期間3個月，到期日後再續借。
- (3) 上述與中華開發工業銀行之借款(該借款已於民國九十三年一月十五日償還完畢)，依合約規定不得將所取得之資金在大陸地區從事直接或間接投資或技術合作，亦不得以使用本授信資金所取得之財產、信用或其他對價(簡稱變價資產)，或以變價資產更為交易而取得之資產、信用或其他資產(衍生資產)，在大陸地區從事直接或間接投資或技術合作。

合晶科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

- (4) 本公司承諾債權人中華開發工業銀行，在民國九十二年六月底起之流動比率不得低於一，負債比率不得高於 1.56，若未能達到上述財務比率，應按當年六月底授信餘額千分之二計收違約金，於當年七月底前繳付。
- (5) 本公司承諾債權人台新商銀，負債資產比率不得高於 0.75，流動比率不得低於 0.75，違反比率須經該行同意。
- (6) 本公司承諾債權人建華商銀，負債淨值比率不得高於 1.5，流動比率不得低於 1，違反比率須經該行同意。
- (7) 有關資產提供質押擔保情形，請詳附註六。

12. 退休金

- (1) 民國九十三及九十二年度認列之退休金成本明細如下：

	九十三年度	九十二年度
服務成本	\$5,517	\$4,038
利息成本	633	489
退休基金資產之預期報酬	(359)	(311)
未認列過渡性淨給付義務攤銷數	98	98
未認列退休金損失攤銷數	-	-
淨退休金成本	<u>\$5,889</u>	<u>\$4,314</u>

- (2) 民國九十三及九十二年十二月三十一日之基金提撥狀況與帳載應計退休金負債調節如下：

	93.12.31	92.12.31
給付義務：		
既得給付義務	\$(1,745)	\$(1,281)
非既得給付義務	(16,964)	(13,179)
累積給付義務	(18,709)	(14,460)
未來薪資增加之影響數	(6,353)	(3,630)
預計給付義務	(25,062)	(18,090)
退休基金資產公平價值	13,456	10,269
提撥狀況	(11,606)	(7,821)
未認列過渡性淨給付義務	885	984
未認列退休金損(益)	1,460	406
應計退休金負債	<u>\$(9,261)</u>	<u>\$(6,431)</u>

合晶科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

民國九十三年及九十二年十二月三十一日預計於未來一年內撥付中央信託局之應計退休金負債分別為 3,405 仟元及 2,445 仟元，帳列應付費用項下。

(3) 計算淨退休金成本所用之精算假設如下：

	93.12.31	92.12.31
折現率	3.50%	3.50%
未來薪資水準增加率	2.00%	1.50%
退休基金資產預期長期投資報酬率	3.50%	3.50%

(4) 截至民國九十三年及九十二年十二月三十一日止，本公司職工退休辦法之既得給付為 1,745 仟元及 1,281 仟元。

13. 股本

本公司民國九十二年一月一日額定股本為 2,500,000 仟元，每股面額 10 元，計分為 250,000,000 股，業已發行 150,000,000 股，每股面額 10 元，實收股本為 1,500,000 仟元。

民國九十三年六月十五日經股東會決議辦理以資本公積 45,000 仟元轉增資，並於民國九十三年七月二十九日經董事會決議以同年八月三十一日為增資基準日，前述增資案業於民國九十三年十月五日完成變更登記，增資後額定股本為 2,500,000 仟元，每股面額 10 元，分為 250,000,000 股，已發行 154,500,000 股。

14. 資本公積

- (1) 以現金增資溢價發行之資本公積，依公司法規定，資本公積除用以彌補公司虧損及撥充資本外，不得使用。公司非於盈餘公積填補資本虧損，仍有不足時，不得以資本公積補充之。
- (2) 以現金增資溢價發行之資本公積轉增資撥充者，每年以一次為限，且不得於現金增資年度將該增資溢價發行之資本公積撥充資本，而每次轉增資均須依規定限額辦理。
- (3) 本公司於民國九十三年六月十五日股東常會決議，以資本公積彌補虧損 117,810 元。

合晶科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

15. 盈餘分配及股利政策

(1) 盈餘分配

年度總決算如有盈餘時，應先提繳稅款、彌補以前年度之虧損，次提百分之十為法定盈餘公積及依主管機關要求提列之特別盈餘公積後，得並同以往年度累積盈餘，作為可分配盈餘，惟視業務狀況酌予保留外，依下列比率分派之：

- (1) 股東紅利百分之八十八。
- (2) 員工紅利百分之十。
- (3) 董監酬勞百分之二。

(2) 股利政策

本公司股利政策係依據營運規劃、投資計畫、資本預算及內外部環境變化由董事會予以訂定。本公司係屬營運成長階段之資本密集行業，需保留充足之資金以因應營業成長及資本支出之所需，故現階段本公司股利政策係以股票股利以不低於當年度可分配之股東紅利之百分之五十為原則。

員工紅利以現金或股票發放之比率與該同一年度之股東紅利相同。

本公司民國九十二及九十一年度為累積虧損，故無盈餘分派情形；另配合財政部證期會民國九十二年一月三十日台財證六字第○九二○○○○四五七號函規定，有關九十四年度董事會擬議之九十三年度盈餘分配案及股東會決議通過盈餘分配案之員工紅利及董監事酬勞等相關訊息，可至公開資訊觀測站中查詢。

16. 庫藏股票

- (1) 子公司晶材科技股份有限公司持有本公司股票自長期投資轉列庫藏股票之變動情形如下：

	<u>期初股數</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期減少</u>	<u>期末股數</u>
93.01.01-93.12.31	<u>233,500 股</u>	<u>- 股</u>	<u>50,000 股</u>	<u>183,500 股</u>
92.01.01-92.12.31	<u>630,500 股</u>	<u>- 股</u>	<u>397,000 股</u>	<u>233,500 股</u>

合晶科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

有關當期該庫藏股票之處分價款、期末帳面價值及市價列示如下：

	處分價款	期末帳面價值	市價或股權淨值
93.12.31	600 仟元	1,847 仟元	2,349 仟元
92.12.31	4,764 仟元	2,347 仟元	3,129 仟元

(2)本公司於民國九十三年八月三十一日起自證券集中交易市場陸續買回本公司股份，截至民國九十三年十二月三十一日止，其增減變動情形如下：

收回原因	期初股數	本期增加	本期減少	期末股數
轉讓予員工	-	5,000,000 股	-	5,000,000 股

證券交易法規定公司買回已發行在外股份之數量比例，不得超過公司已發行股份總數百分之十，收買股份之總金額，不得逾保留盈餘加計發行股份溢價及已實現之資本公積之金額，若以民國九十三年十二月三十一日為計算基礎，買回股數最高上限為 15,450 仟股，收買股份金額最高上限為 313,700 仟元。本公司截至民國九十三年十二月三十一日止，買回之庫藏股票股數為 5,000 仟股，買回之庫藏股金額為 67,220 仟元。

(3)本公司庫藏股票係依公司法規定持有，依法不得享有表決權。但子公司持有母公司股票視同庫藏股票處理者，仍享有股東權益。

(4)本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押，亦不得享有股利之分派、表決權等權利，另所買回之股份自購入完成日起三年內應將其轉讓予員工，逾期末轉讓者，視為未發行股份，應辦理資本額變更登記。

17. 營業收入淨額

	九十三年度	九十二年度
營業收入包括：		
成品銷售	\$1,504,452	\$1,308,168
勞務提供	39,016	33,579
減：銷貨退回或折讓	(8,006)	(18,019)
營業收入淨額	\$1,535,462	\$1,323,728

合晶科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

18. 用人、折舊及攤銷費用

功能別 性質別	九十三年度			九十二年度		
	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合 計
用人費用						
薪資費用	\$101,160	\$51,644	\$152,804	\$84,654	\$43,731	\$128,385
勞健保費用	8,823	4,265	13,088	8,253	3,437	11,690
退休金費用	3,722	2,167	5,889	2,822	1,492	4,314
其他用人費用	49,105	14,147	63,252	42,219	11,451	53,670
折舊費用	191,717	12,021	203,738	174,759	8,240	182,999
攤銷費用	27,928	4,336	32,264	20,289	4,005	24,294

19. 所得稅

(1) 遞延所得稅負債與資產：	93.12.31	92.12.31		
① 遞延所得稅資產總額	\$170,920	\$201,492		
② 遞延所得稅負債總額	\$-	\$-		
③ 遞延所得稅資產之備抵評價金額	\$70,920	\$101,492		
	93.12.31	92.12.31		
	暫時性 差異金額	所得稅 影響金額		
	暫時性 差異金額	所得稅 影響金額		
④ 產生遞延所得稅資產或負債之暫時性 差異：				
存貨跌價損失之認列所產生之可減除 暫時性差異	\$18,463	\$4,616	\$14,000	\$3,500
兌換損益之認列所產生之可減除(應課 稅)暫時性差異	2,039	510	301	75
職工福利之認列所產生之可減除暫時 性差異	461	115	1,002	251
退休金費用之認列所產生之可減除暫 時性差異	9,837	2,459	7,008	1,752
未實現銷貨毛利之認列所產生之可減 除暫時性差異	2,191	548	7,100	1,775
逾二年應付款項轉列收入之認列所產 生之可減除暫時性差異	3,453	863	-	-
投資損益之認列所產生之可減除暫時 性差異	10,864	2,716	70,625	17,656

合晶科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

技術作價投資轉列收入之認列所產生 之可減除暫時性差異	74,953	18,738	-	-
⑤產生遞延所得稅資產之所得稅抵減		63,280		57,910
⑥虧損扣抵產生之所得稅抵減	308,298	77,075	474,293	118,573
		<u>93.12.31</u>		<u>92.12.31</u>
(2)遞延所得稅資產－流動		\$54,609		\$72,977
備抵評價－遞延所得稅資產－流動		(24,593)		(31,977)
淨遞延所得稅資產－流動		30,016		41,000
遞延所得稅負債－流動		-		-
流動遞延所得稅資產與負債抵銷後淨額		<u>\$30,016</u>		<u>\$41,000</u>
		<u>93.12.31</u>		<u>92.12.31</u>
(3)遞延所得稅資產－非流動		\$116,311		\$128,515
備抵評價－遞延所得稅資產－非流動		(46,327)		(69,515)
淨遞延所得稅資產－非流動		69,984		59,000
遞延所得稅負債－非流動		-		-
非流動遞延所得稅資產與負債抵銷後淨額		<u>\$69,984</u>		<u>\$59,000</u>
		<u>93.12.31</u>		<u>92.12.31</u>
(4)所得稅費用估列如下：		<u>九十三年度</u>		<u>九十二年度</u>
應付所得稅(當期所得稅費用)		\$48,322		\$20,460
兌換損益之認列所產生之遞延所得稅費用 (利益)		(435)		1,039
未實現銷貨毛利之認列所產生之遞延所得 稅費用(利益)		1,227		(650)
存貨跌價損失之認列所產生之遞延所得稅 費用(利益)		(1,116)		3,125
逾二年應付款項轉列收入之認列所產生之 遞延所得稅利益		(863)		-
投資損益之認列所產生之遞延所得稅費用		14,940		3,469
職工福利之認列所產生之遞延所得稅費用		136		519
退休金費用之認列所產生之遞延所得稅利 益		(707)		(489)
技術作價投資轉列收入之認列所產生之遞 延所得稅利益		(18,738)		-
產生遞延所得稅資產之所得稅抵減		(31,248)		(12,673)
虧損扣抵之認列所產生之所得稅利益		(1,149)		12,145
逾期未使用投資抵減數		20,203		-

合晶科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

遞延所得稅資產備抵評價回轉數	(30,572)	(101,945)
所得稅利益	\$-	\$(75,000)

(5) 本公司民國八十九年度(含)以前之營利事業所得稅結算申報案件均經國稅局核定在案。

(6) 所得稅抵減之法令依據、抵減項目、可抵減稅額、尚未抵減餘額及最後抵減年度列示如下：

法令依據	抵減項目	可抵減稅額	尚未抵減餘額	最後抵減年度
促進產業升級條例	機器設備	\$4,517	\$4,517	94
促進產業升級條例	機器設備	3,557	3,557	95
促進產業升級條例	機器設備	4,989	4,989	96
促進產業升級條例	機器設備	8,639	8,639	97
促進產業升級條例	研究及發展支出	6,362	6,362	94
促進產業升級條例	研究及發展支出	6,751	6,751	95
促進產業升級條例	研究及發展支出	12,298	12,298	96
促進產業升級條例	研究及發展支出	16,167	16,167	97
	合 計	\$63,280	\$63,280	

(7) 截至民國九十三年十二月三十一日止，本公司尚未使用之可扣抵虧損金額及期限如下：

虧損年度	得扣抵之最後年度	申報虧損金額
89	94	\$148,312
90	95	110,617
91	96	49,369
合 計		\$308,298

(8) 本公司增資擴展生產晶棒、晶圓之投資計劃，符合重要科技事業屬於製造業及技術服務業部份獎勵辦法規定，業經經濟部工業局工中二字第○八七二○二四二六一號函核准在案，並經財政部於民國九十一年八月二十一日經台財稅字第○九一○四五四七八八號函核准自產品開始銷售之日民國九十三年一月一日起連續五年內免徵營利事業所得稅。

合晶科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

(9) 截至民國九十三年及九十二年十二月三十一日有關股東可扣抵稅額帳戶之資訊內容如下：

	93.12.31(預計)	92.12.31(實際)
股東可扣抵稅額帳戶餘額	\$3,698	\$3,698
八十七年度以後未分配盈餘	246,179	-
股東可扣抵稅額比率	1.50%	-

20. 每股盈餘

本公司為複雜資本結構，茲揭露每股盈餘如下：

	九十三年度		九十二年度
期初流通在外股數	150,000,000	股	150,000,000
期初長期股權投資轉列庫藏股票	(233,500)		(630,500)
子公司出售持有本公司庫藏股	40,983		113,789
購回庫藏股	(1,179,105)		
93.08.31資本公積轉增資 (150,000,000×3%)	4,500,000		4,500,000
基本每股盈餘之流通在外加權平均股數	153,128,378	股	153,983,289

	金額(分子)		股數 (分母)	每股盈餘(元)	
	稅前	稅後		稅前	稅後
<u>九十三年度：</u>					
基本每股盈餘					
屬於普通股股東之本期純益	\$246,179	\$246,179	153,128,378	\$1.61	\$1.61
具稀釋作用之潛在普通股之影響 1.5056% 轉換公司債	928	928	6,394,006		
屬於普通股股東之本期純益加潛在普通股之影響	\$247,107	\$247,107	159,522,384	\$1.55	\$1.55
<u>九十二年度：</u>					
基本每股盈餘					
本期純益	\$155,627	\$230,627	153,983,289 股	\$1.01	\$1.50

合晶科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

假設民國九十三年及九十二年子公司對本公司股票之投資不視為庫藏股票時之擬制資料如下：

	金 額 (分子)		股數 (分母)	每股盈餘 (元)	
	稅 前	稅 後		稅 前	稅 後
<u>九十三年度：</u>					
基本每股盈餘					
本期純益	\$246,279	\$246,279	153,320,895	\$1.61	\$1.61
具稀釋作用之潛在普通股之影響	928	928	6,394,006		
1.5056% 轉換公司債					
屬於普通股股東之本期純益加潛在普通股之影響	<u>\$247,207</u>	<u>\$247,207</u>	159,714,901	<u>\$1.55</u>	<u>\$1.55</u>
<u>九十二年度：</u>					
基本每股盈餘					
本期純益	<u>\$156,421</u>	<u>\$231,421</u>	154,500,000 股	<u>\$1.01</u>	<u>\$1.50</u>

五、關係人交易

(一)關係人名稱及關係

關係人名稱	與本公司之關係
Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.	原為本公司之子公司，自九十三年十二月起變更為本公司之孫公司
晶材科技股份有限公司	本公司之子公司
Helitek Company Ltd.	原為本公司之孫公司，自九十三年十二月起變更為本公司之曾孫公司
上海晶技電子材料有限公司	原為本公司之孫公司，自九十三年十二月起變更為本公司之曾孫公司
上海合晶硅材料有限公司 (原名為晶華電子材料有限公司)	原為本公司子公司採成本法評價之被投資公司，自九十三年度起為本公司之孫公司，另自九十三年十二月起變更為本公司之曾孫公司

合晶科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

(二)與關係人間重大交易事項

1.本公司與關係人交易事項明細如下：

(1) 銷 貨

	九十三年度		九十二年度	
	金額	佔該科目淨額百分比	金額	佔該科目淨額百分比
Helitek Company Ltd.	\$429,499	27.97%	\$336,152	25.40%
上海合晶硅材料有限公司	12,122	0.80	26,281	1.98
晶材科技股份有限公司	3,637	0.23	-	-
Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.	-	-	13,231	1.00
上海晶技電子材料有限公司	2,493	0.16	975	0.07
合 計	\$447,751	29.16%	\$376,639	28.45%

上述關係人交易之計價方式與一般客戶相當，而收款條件係採交貨後 60 天以電匯方式收款，與一般廠商相當。

(2) 進 貨

	九十三年度		九十二年度	
	金額	佔該科目淨額百分比	金額	佔該科目淨額百分比
Helitek Company Ltd.	\$31,351	3.60%	\$130,224	21.16%
上海合晶硅材料有限公司	116,006	13.33	14,417	2.34
晶材科技股份有限公司	69	0.01	-	-
上海晶技電子材料有限公司	13,381	1.54	2,562	0.42
Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.	-	-	85	0.01
合 計	\$160,807	18.48%	\$147,288	23.93%

上述關係人交易之計價方式與一般廠商相當，而付款條件係交貨後 60 天以電匯方式付款，與一般廠商相當。

合晶科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

(3) 其他收入

	九十三年度		九十二年度	
	金額	佔該科目淨額百分比	金額	佔該科目淨額百分比
上海晶技電子材料有限公司	\$641	2.35%	\$6,564	49.59%
Helitek Company Ltd.	1,126	4.12	3,393	25.63
上海合晶硅材料有限公司	13,168	48.24	640	4.84
Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.	135	0.49	27	0.20
合 計	\$15,070	55.20%	\$10,624	80.26%

上述其他收入係本公司民國九十三年及九十二年度代 Hilitek Company Ltd.、Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.、上海晶技電子材料有限公司及上海合晶硅材料有限公司採購原物料收取之手續費。

2. 本公司與關係人之債權債務情形如下(均未計息)：

	93.12.31		92.12.31	
	金額	佔該科目淨額百分比	金額	佔該科目淨額百分比
<u>(1)應收帳款—關係人</u>				
Helitek Company Ltd.	\$69,473	23.18%	\$96,885	30.03%
上海合晶硅材料有限公司	1,970	0.66	7,435	2.31
上海晶技電子材料有限公司	680	0.23	-	-
Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.	-	-	593	0.18
合 計	\$72,123	24.07%	\$104,913	32.52%
<u>(2)其他應收款—關係人(不含資金融通)</u>				
上海晶技電子材料有限公司	\$4,535	7.00%	\$13,056	33.65%
Helitek Company Ltd.	219	0.34	9,857	25.40
上海合晶硅材料有限公司	45,297	69.89	3,804	9.80
合 計	\$50,051	77.23%	\$26,717	68.85%

本公司代 Helitek Company Ltd.、上海晶技電子材料有限公司及上海合晶硅材料有限公司採購原物料之代墊款項。

合晶科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

(3)預付款項

晶材科技股份有限公司	\$-	-%	\$96	0.29%
------------	-----	----	------	-------

(4)應付帳款－關係人

Helitek Company Ltd.	\$270	0.19%	\$7,061	9.88%
晶材科技股份有限公司	69	0.05	-	-
上海合晶硅材料有限公司	25,204	17.56	2,449	3.43
上海晶技電子材料有限公司	4,839	3.37	2,113	2.96
合 計	\$30,382	21.17%	\$11,623	16.27%

(5)其他流動負債－其他應付款

Helitek Company Ltd.	\$203	16.61%	\$99	5.04%
----------------------	-------	--------	------	-------

本公司委託 Helitek Company Ltd. 代為採購消耗品之應付款項，帳列其他流動負債項下。

(6)其他流動負債－暫收款

上海晶技電子材料有限公司	\$-	-%	\$434	22.10%
--------------	-----	----	-------	--------

3.本公司與關係人資金融通情形如下：

其他應收款	最高餘額	期末餘額	利率區間	利息總額
92.12.31				
Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.	\$73,053	\$-	-%	\$-

4.截至民國九十三年十二月三十一日止，本公司為關係人上海合晶硅材料有限公司背書保證為 46,789 仟元，以作為該公司向銀行借款之擔保。

5.本公司民國九十三年及九十二年度委由關係人代採購固定資產及九十二年度向關係人購買固定資產明細如下：

資產種類	關係人	購買價格	價格決定之 參考依據
九十三年度 機器設備	Helitek Company Ltd.	\$59,499	議價
九十二年度 機器設備	Helitek Company Ltd.	\$46,007	議價

合晶科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

6.本公司民國九十三年度出售固定資產予關係人明細如下：

資產種類	關係人名稱	帳面價值	售價	處分(損)益	價格決定之參考依據
機器設備	上海合晶硅材料有限公司	\$3,656	\$3,889	\$233	議價

六、質押之資產

截至民國九十三年及九十二年十二月三十一日止，本公司有下列資產業已提供金融機構作為融資之擔保品：

質押資產名稱	金額	擔保性質
<u>93.12.31</u>		
受限制銀行存款	\$2,300	外勞保證金擔保
受限制銀行存款	5,000	台北關稅局擔保金
受限制銀行存款	400	台北關稅局擔保金
固定資產－土地	258,550	長、短期擔保借款
固定資產－房屋及建築物	162,283	長、短期擔保借款
固定資產－機器設備	502,286	長期擔保借款
固定資產－預付設備款	18,643	長期擔保借款
合計	<u>\$949,462</u>	
<u>92.12.31</u>		
應收帳款	\$19,751	短期擔保借款
受限制銀行存款	2,278	外勞保證金擔保
受限制銀行存款	6,972	短期擔保借款
受限制銀行存款	5,400	台北關稅局擔保金
固定資產－土地	258,550	長、短期擔保借款
固定資產－房屋及建築物	166,344	長、短期擔保借款
固定資產－機器設備	639,173	長期擔保借款
固定資產－預付設備款	42,800	長期擔保借款
合計	<u>\$1,141,268</u>	

合晶科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

七、重大承諾事項及或有事項

1.截至民國九十三年十二月三十一日止，本公司已開發未使用之信用狀金額（外幣單位：仟元）如下：

幣別	信用狀總額	已繳保證金
日 幣	¥ 19,836 仟元	\$-
美 金	USD 85 仟元	\$-

2.截至民國九十三年十二月三十一日止，本公司尚未完成之重大工程合約明細如下：

簽約人	合約性質	合約金額	(已)預付金額	未付金額
Helitek Company Ltd.	長晶爐等機器設備	\$43,234	\$43,234	\$-
KCA TENCOR	SPI	27,552	24,832	2,720
創技工業股份有限公司	單面拋光機	18,000	15,300	2,700
合 計		\$88,786	\$83,366	\$5,420

上列已付金額分別帳列固定資產未完工程及預付設備款項下。

八、重大之災害損失

無此事項。

九、重大之期後事項

無此事項。

十、其 他

1.金融商品之公平價值

金融商品	93.12.31		92.12.31	
	帳面價值	公平價值	帳面價值	公平價值
<u>非衍生性金融商品</u>				
資產				
現金及約當現金	\$42,696	\$42,696	\$46,083	\$46,083

合晶科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

應收票據及款項淨額(含關係人款)	302,733	302,733	321,601	321,601
其他應收款(含關係人款)	62,049	62,049	38,804	38,804
受限制銀行存款	7,700	7,700	14,650	14,650
長期股權投資	630,715	647,152	487,005	487,232
負債				
短期借款	99,453	99,453	289,962	289,962
應付短期票券淨額	39,985	39,985	49,971	49,971
應付票據及款項(含關係人款)	148,238	148,238	71,425	71,425
應付費用	94,524	94,524	70,728	70,728
應付設備款	29,284	29,284	9,528	9,528
應付公司債	200,928	200,000	-	-
長期負債(含一年內到期者)	574,560	574,560	511,196	511,196
衍生性金融商品				
其他應收款				
應收遠期外匯淨額	2,757	2,757	-	-
其他流動負債				
應付遠期外匯淨額	-	-	470	470

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下：

- (1) 短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值，因為此類商品到期日甚近，其帳面價值應屬估計公平價值之合理基礎。此方法應用於現金及約當現金、應收票據及款項、其他應收款、受限制銀行存款、短期借款、應付短期票券淨額、應付票據及款項、應付費用及應付設備款等。
- (2) 長(短)期投資如有市場價格可循時，則以此市場價格為公平價值。若無市場價格可供參考時，則依財務或其他資訊估計公平價值。
- (3) 長期借款以其預期現金流量之折現價值估計公平價值。應付短期票券折現率以平均有效收益率為準，而長期借款折現率則以本公司所能獲得類似條件(相近之到期日)之長期借款利率為準。
- (4) 上櫃應付公司債因有市場價格可循，故以此市場價格為公平價值。
- (5) 衍生性金融商品之公平價值，係假設本公司若依約定在報表日終止合約，預計所能取得或必須支付之金額。一般均包括當期末結清合約之未實現損益。

合晶科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

2、衍生性金融商品資訊

(1)合約金額(或名目本金金額)及公平價值：

民國九十三年十二月三十一日及九十二年十二月三十一日，尚未到期之遠期外匯合約金額如下：

金融商品	幣別	合約金額 (仟元)	公平價值(仟 元)	保證金	交割期日	到期值 (仟元)
<u>93.12.31</u>						
預售遠期外匯	USD	\$5,000	NTD 158,750	無	94.01.07~ 94.02.26	NTD 161,507
<u>92.12.31</u>						
預售遠期外匯	USD	\$2,000	NTD 67,960	無	93.01.12~ 93.03.22	NTD 67,490

(2)信用風險：

本公司之交易對象均為信用良好之銀行，因此交易相對人未履行合約而發生損失之風險甚小。

(3)市場價格風險：

因本公司從事遠期外匯買賣合約均係為避險性質，其因匯率變動產生之損益大致會與被避險項目之損益相抵銷，故市場價格風險並不重大。

(4)流動性風險、現金流量風險及未來現金需求之金額、期間、不確定性：

本公司購入遠期外匯之履約價格係依當時市場價格訂定之固定成本，其期間長短係配合本公司既有之外幣債權之到期日而決定，因此，於合約到期時，本公司將以到期之外幣債權債務結清，故無籌資風險，且不致有重大之現金流量風險。

(5)持有衍生性金融商品之種類、目的及達成該目的之策略：

本公司之衍生性金融商品均因非交易目的而持有。訂定遠期外匯合約主要係為規避外幣債權、債務及承諾因匯率變動產生之風險。本公司之避險策略係以達成能夠規避大部分市場價格風險為目的。本公司以與被避險項目公平價值變動呈高度負相關之衍生性金融商品作為避險工具，並作定期評估。

(6)衍生性金融商品於財務報表上之表達方法：

本公司因買賣遠期外匯合約所產生之應收及應付款項餘額互為抵減，其差額列為流動負債，民國九十三及九十二年列於其他應收款及其他流動負債之餘額分

合晶科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

別為 2,757 仟元及 470 仟元，其產生之兌換利益(損失)計 859 仟元及(4,537)仟元帳列於損益表之營業外收入(支出)項下。

十一、附註揭露事項

(一) 重大交易事項相關資訊

1. 對他人資金融通者：無。
2. 為他人背書保證者：參閱附表一。
3. 期末持有有價證券者：參閱附表二。
4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：參閱附表三。
5. 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：無。
6. 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：無。
7. 與關係人進、銷貨交易金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：參閱附表四。
8. 本公司應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：無。
9. 本公司從事衍生性商品交易：請參閱附註十.2。

(二) 轉投資事業相關資訊：

1. 對被投資公司具有重大影響力或控制能力時，應揭露被投資公司之相關資訊：參閱附表五。
2. 對被投資公司具有控制能力時，應揭露被投資公司上述 1~9 項相關資訊：
 - 2.1 對他人資金融通者：參閱附表六。
 - 2.2 為他人背書保證者：無。

合晶科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

2.3 期末持有有價證券者：參閱附表七。

2.4 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：參閱附表八。

2.5 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：無。

2.6 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：無。

2.7 與關係人進、銷貨交易金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：參閱附表九。

2.8 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：無。

2.9 本公司從事衍生性商品交易：無。

合晶科技股份有限公司財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

(三)大陸投資資訊之揭露

1. 大陸被投資公司名稱、主要營業項目、實收資本額、投資方式、資金匯出入情形、持股比例、投資損益、期末投資帳面價值、已匯回投資損益及赴大陸地區投資限額：

單位：新台幣/仟元

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	本公司直接或間接投資之持股比例	本期認列投資(損)益	期末投資帳面價值	截至本期末止已匯回投資收益	本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准投資金額	依經濟部投審會規定本公司赴大陸地區投資限額
					匯出	收回								
上海合晶硅材料有限公司(原名為晶華電子材料有限公司)	經營晶圓、已滲雜業務	385,181 仟元 (註3)	透過轉投資第三地現有公司再投資大陸公司	\$193,386 (註3)	\$110,981 (註2、3)	\$-	\$304,367 (註3)	75%	\$71,715 (註1、3)	\$359,847 (註3)	\$-	\$326,709 (註3)	\$326,709 (註3)	\$718,711
上海晶技電子材料有限公司	經營晶圓、已滲雜業務	22,342 仟元 (註3)	透過轉投資第三地現有公司再投資大陸公司	\$22,342 (註3)	\$-	\$-	\$22,342 (註3)	100.00%	\$18,078 (註1、3)	\$61,624 (註3)	\$-			

註1：係依經台灣母公司簽證會計師查核簽證之財務報表按權益法認列投資收益。

註2：合晶本期增加 Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.之投資款 36,429 仟元，再以 Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.

投資上海合晶硅材料有限公司 30,674 仟元，另技術作價投資上海合晶硅材料有限公司 80,307 仟元。

註3：外幣金額已依年底匯率換算為新台幣。

2. 進貨金額及百分比與相關應付款項之期末餘額：

	進貨		應付款項	
	金額	佔本公司 進貨淨額 百分比	金額	佔該科目 餘額 百分比
上海合晶硅材料有限公司	\$116,006	13.33%	\$25,204	17.56%
上海晶技電子材料有限公司	13,381	1.54	4,839	3.37
合計	<u>\$129,387</u>	<u>14.87%</u>	<u>\$30,043</u>	<u>20.93%</u>

上述交易之計價方式與一般廠商相當，而付款條件係交貨後 60 天以電匯方式付款，與一般廠商相當。

3. 銷貨金額及百分比與相關應收款項之期末餘額：

	銷貨		應收款項	
	金額	佔本公司 銷貨淨額 百分比	金額	佔該科目 餘額 百分比
上海合晶硅材料有限公司	\$12,122	0.80%	\$1,970	0.66%
上海晶技電子材料有限公司	2,493	0.16	680	0.23
合計	<u>\$14,615</u>	<u>0.96%</u>	<u>\$2,650</u>	<u>0.89%</u>

上述交易之計價方式與一般客戶相當，而收款條件係採交貨後 60 天以電匯方式收款，與一般客戶相當。

4. 財產交易金額及其所產生損益：

資產種類	關係人名稱	帳面價值	售價	處分(損)益	價格決定之參考依據
機器設備	上海合晶硅材料 有限公司	<u>\$3,656</u>	<u>\$3,889</u>	<u>\$233</u>	議價

5. 票據背書及保證或提供擔保之期末餘額及目的：

本公司民國九十三年度為上海合晶硅材料有限公司背書保證 46,789 仟元，以作為該公司向銀行借款之擔保。

6. 資金融通之最高餘額、期末餘額利率區間及當期利息總額：無。

7. 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項，如勞務提供或收受等：

本公司民國九十三年度為上海晶技電子材料有限公司及上海合晶硅材料有限公司代購原料收取之其他收入為 641 仟元及 13,168 仟元；截至民國九十三年十二月三十一日止，本公司為上海晶技電子材料有限公司及上海合晶硅材料有限公司代採購原物料之代墊款項分別為 4,535 仟元及 45,297 仟元，本公司帳列其他應收款項下。

十二、 部門別財務資訊

1. 產業別財務資訊：本公司係製造矽晶圓材料為主要產品，製造過程一貫作業，並無其他主要產品，故無揭露其產業別資訊之適用。
2. 地區別財務資訊：本公司無國外營運部門。
3. 外銷銷貨資訊：

	九十三年度	九十二年度
美洲	\$480,528	\$358,000
歐洲	175,475	46,549
亞洲	389,811	387,634
合計	<u>\$1,045,814</u>	<u>\$792,183</u>

4. 重要客戶資訊：本公司對單一客戶之銷貨收入占本公司營業收入淨額 10% 以上者如下：

客戶名稱	九十三年度	九十二年度
A 客戶	<u>\$429,452</u>	<u>\$336,152</u>

五、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表

合晶科技股份有限公司及其子公司 會計師查核報告

合晶科技股份有限公司及其子公司民國九十三年十二月三十一日及重編後民國九十二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十三年一月一日至十二月三十一日及重編後民國九十二年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。列入上開合併財務報表之子公司中，有關民國九十三年度 Helitek Company Ltd. 之財務報表，暨民國九十二年度 Helitek Company Ltd. 及上海合晶硅材料有限公司之財務報表，未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關上述合併個體財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告，上述合併個體民國九十三年十二月三十一日及民國九十二年十二月三十一日之資產總額分別為新台幣 286,900 仟元及新台幣 872,177 仟元，分別佔合併資產總額之 7.77% 及 28.81%，民國九十三年一月一日至十二月三十一日及民國九十二年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為新台幣 701,509 仟元及 1,013,023 仟元，分別佔合併營業收入淨額之 32.36% 及 60.16%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則暨一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達合晶科技股份有限公司及其子公司民國九十三年十二月三十一日及民國九十二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十三年一月一日至十二月三十一日及民國九十二年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如合併財務報表附註一.(四)所述，合晶科技股份有限公司及其子公司民國九十二年度之合併財務報表因編製主體變動業經重編。

此 致

合晶科技股份有限公司 公鑒

致遠會計師事務所
證期會核准辦理公開發行公司財務報告
查核簽證文號：(87)台財證(六)第 65315 號
(91)台財證(六)第 144183 號

洪茂益

會計師

張志銘

中華民國九十四年二月二十五日

合晶科技股份有限公司及其子公司
合併資產負債表
民國九十三年十二月三十一日
及民國九十二年十二月三十一日(重編後)
(金額均以新台幣仟元為單位)

資 產			九十二年十二月三十一日		九十二年十二月三十一日		負債及股東權益			九十二年十二月三十一日		九十二年十二月三十一日	
代碼	會計科目	附註	金 額	%	金 額	%	代碼	會計科目	附註	金 額	%	金 額	%
1100	流動資產						2100	流動負債					
1100	現金及約當現金	二及四.1	\$154,724	4.19	\$147,894	4.89	2100	短期借款	四.8及六	\$535,646	14.51	\$352,155	11.63
1120	應收票據淨額	二及四.2	55,551	1.51	41,484	1.37	2110	應付短期票券淨額	四.9	39,985	1.08	49,971	1.65
1140	應收帳款淨額	二、四.3及六	457,237	12.38	388,430	12.83	2120	應付票據		4,750	0.13	4,481	0.15
1178	其他應收款	二及十.2	17,697	0.48	17,330	0.57	2140	應付帳款		157,272	4.26	114,173	3.77
1210	存貨淨額	二及四.4	640,870	17.36	373,184	12.33	2150	應付帳款－關係人	五	69	-	-	-
1250	預付款項	五	54,416	1.47	42,633	1.41	2160	應付所得稅	二及四.19	1,077	0.03	-	-
1280	其他流動資產		2,523	0.07	11,155	0.37	2170	應付費用	二及四.12	110,356	2.99	77,053	2.55
1286	遞延所得稅資產淨額	二及四.19	31,171	0.84	41,094	1.36	2190	其他應付款－關係人	五	23,409	0.64	68,301	2.26
1291	受限制銀行存款	六	294,953	7.99	14,650	0.48	2224	應付設備款		29,284	0.79	9,528	0.31
	流動資產合計		1,709,142	46.29	1,077,854	35.61	2272	一年內到期之長期借款	四.11及六	111,468	3.02	182,009	6.01
1400	基金及長期投資						2280	其他流動負債	二及十.2	85,682	2.32	68,297	2.26
1421	長期股權投資	二及四.5						流動負債合計		1,098,998	29.77	925,968	30.59
142101	採權益法認列之長期投資		9,627	0.26	5,170	0.17	2400	長期負債					
1500	固定資產	二、四.6、六及七					2410	應付公司債	二及四.10	200,928	5.44	-	-
1501	土地		267,340	7.24	267,870	8.85	2420	長期借款	四.11及六	463,092	12.54	367,052	12.12
1521	房屋及建築物		396,286	10.73	413,007	13.64		長期負債合計		664,020	17.98	367,052	12.12
1531	機器設備		1,886,619	51.10	1,816,837	60.01	2800	其他負債					
1551	運輸設備		13,878	0.38	13,908	0.46	2810	應計退休金負債	二及四.12	5,856	0.16	3,986	0.13
1561	辦公設備		97,714	2.65	37,611	1.24	2883	少數股權		126,598	3.43	75,852	2.51
1681	什項設備		51,007	1.38	84,347	2.79		其他負債合計		132,454	3.59	79,838	2.64
	成本合計		2,712,844	73.48	2,633,580	86.99		負債合計		1,895,472	51.34	1,372,858	45.35
15x9	減：累計折舊		(1,181,132)	(31.99)	(995,189)	(32.87)	3100	股本	四.13				
1671	未完工程		36,997	1.00	31,286	1.03	3110	普通股		1,545,000	41.84	1,500,000	49.55
1672	預付設備款		209,684	5.68	107,784	3.56	3211	資本公積	四.14				
	固定資產淨額		1,778,393	48.17	1,777,461	58.71	3220	普通股股票溢價		67,521	1.83	230,331	7.61
1700	無形資產						3300	庫藏股票交易		984	0.02	884	0.03
1782	土地使用權	二	18,465	0.50	1,067	0.04	3351	保留盈餘					
1800	其他資產						3400	累積盈虧	四.15	246,179	6.67	(117,810)	(3.89)
1820	存出保證金		1,157	0.03	658	0.02	3420	股東權益其他項目					
1830	遞延費用	二	42,828	1.16	33,736	1.11	3510	累積換算調整數	二	6,161	0.17	43,404	1.43
1832	債券發行成本		229	0.01	-	-		庫藏股票	二及四.16	(69,067)	(1.87)	(2,347)	(0.08)
1848	催收款淨額	二及四.7	-	-	-	-		股東權益合計		1,796,778	48.66	1,654,462	54.65
1860	遞延所得稅資產淨額	二及四.19	69,984	1.89	60,767	2.01							
1889	合併借項	二	62,425	1.69	70,607	2.33							
	其他資產合計		176,623	4.78	165,768	5.47							
	資產總計		\$3,692,250	100.00	\$3,027,320	100.00		負債及股東權益總計		\$3,692,250	100.00	\$3,027,320	100.00

(請參閱合併財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

合晶科技股份有限公司及其子公司
合併損益表
民國九十三年一月一日至十二月三十一日
及民國九十二年一月一日至十二月三十一日(重編後)
(金額除每股盈餘外，均以新台幣仟元為單位)

科目代碼	項 目	附 註	九十三年度		九十二年(重編後)	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入					
4110	銷貨收入		\$2,136,979	98.57	\$1,668,303	99.08
4170	減：銷貨退回及折讓		(8,006)	(0.37)	(18,053)	(1.07)
	銷貨淨額		2,128,973	98.20	1,650,250	98.01
4600	勞務收入		39,016	1.80	33,579	1.99
	營業收入淨額	二、四.17及五	2,167,989	100.00	1,683,829	100.00
5000	營業成本	五	(1,529,621)	(70.55)	(1,238,325)	(73.54)
5900	營業毛利		638,368	29.45	445,504	26.46
6000	營業費用					
6100	推銷費用		(51,320)	(2.36)	(40,995)	(2.43)
6200	管理及總務費用		(214,463)	(9.89)	(175,150)	(10.40)
6300	研究發展費用		(60,127)	(2.77)	(43,385)	(2.58)
	營業費用合計		(325,910)	(15.02)	(259,530)	(15.41)
6900	營業淨利		312,458	14.43	185,974	11.05
7100	營業外收入及利益					
7110	利息收入		1,146	0.05	745	0.04
7121	按權益法認列之投資收益	二及四.5	3,857	0.18	-	-
7130	處分固定資產利益	二	2,459	0.11	6,855	0.41
7140	處分投資利益	二	-	-	13	-
7150	存貨盤盈		30	-	-	-
7160	兌換利益	二及十.2	-	-	153	0.01
7210	租金收入		-	-	130	0.01
7260	存貨跌價回升利益	二	-	-	12,500	0.74
7480	其他收入		28,724	1.32	13,134	0.78
	營業外收入及利益合計		36,216	1.66	33,530	1.99
7500	營業外費用及損失					
7510	利息支出		(26,051)	(1.20)	(37,097)	(2.20)
7521	採權益法認列之投資損失	二及四.5	-	-	(31)	-
7530	處分固定資產損失	二	(5,991)	(0.28)	-	-
7550	存貨盤損		-	-	(71)	(0.01)
7560	兌換損失	二及十.2	(9,056)	(0.42)	-	-
7570	存貨跌價及呆滯損失	二	(9,445)	(0.44)	-	-
7880	其他損失		(3,671)	(0.17)	(13,950)	(0.83)
	營業外費用及損失合計		(54,214)	(2.51)	(51,149)	(3.04)
7900	本期稅前淨利		294,460	13.58	168,355	10.00
8110	所得稅利益(費用)	二及四.19	(24,017)	(1.11)	67,563	4.01
8900	綜合純益		270,443	12.47	235,918	14.01
9200	取得多數股權前淨利		-	-	(5,291)	(0.31)
9400	少數股權淨利		(24,264)	(1.12)	-	-
9600	合併純益		\$246,179	11.35	\$230,627	13.70
9950	基本每股盈餘(元)	二及四.20				
7900	本期稅前淨利		\$1.76		\$1.06	
9600	本期淨利		\$1.61		\$1.50	
9850	稀釋每股盈餘(元)					
9810	本期稅前淨利		\$1.70			
9850	本期淨利		\$1.55			
	假設晶材科技股份有限公司對合晶科技股份有限公司股票之投資不視為庫藏股票之擬制資料：	二及四.20				
9600	本期淨利		\$246,279		\$231,421	
9950	基本每股盈餘(元)	二及四.20				
9600	本期淨利		\$1.61		\$1.50	
9850	稀釋每股盈餘					
9810	本期淨利		\$1.55			

(請參閱合併財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

合晶科技股份有限公司及其子公司

合併股東權益變動表

民國九十三年一月一日至十二月三十一日

及民國九十二年一月一日至十二月三十一日(重編後)

(金額均以新台幣仟元為單位)

項 目	附註	股 本	資本公積	累積盈虧	累積 換算調整數	庫藏股票	合 計
民國九十二年一月一日餘額		\$1,500,000	\$230,421	\$(348,437)	\$53,758	\$(6,317)	\$1,429,425
子公司出售庫藏股票	二		794			3,970	4,764
外幣報表換算調整數	二				(10,354)		(10,354)
九十二年度淨利				230,627			230,627
民國九十二年十二月三十一日餘額		1,500,000	231,215	(117,810)	43,404	(2,347)	1,654,462
資本公積彌補虧損	四.14		(117,810)	117,810			-
資本公積轉增資	四.13	45,000	(45,000)				-
購入庫藏股	二及四.16					(67,220)	(67,220)
子公司出售庫藏股票	二		100			500	600
外幣報表換算調整數	二				(37,243)		(37,243)
九十三年度淨利				246,179			246,179
民國九十三年十二月三十一日餘額		<u>\$1,545,000</u>	<u>\$68,505</u>	<u>\$246,179</u>	<u>\$6,161</u>	<u>\$(69,067)</u>	<u>\$1,796,778</u>

(請參閱合併財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

合晶科技股份有限公司及其子公司
合併現金流量表
民國九十三年一月一日至十二月三十一日
及民國九十二年一月一日至十二月三十一日(重編後)
(金額均以新台幣仟元為單位)

項 目	九十三年度	九十二年度 (重編後)	項 目	九十三年度	九十二年度 (重編後)
營業活動之現金流量：			投資活動之現金流量：		
本期淨利	\$246,179	\$230,627	出售短期投資	-	13
調整項目：			受限制銀行存款增加	(280,303)	(14,650)
少數股權淨利	24,264	-	購置固定資產	(276,645)	(231,684)
取得多數股權前淨利	-	5,291	出售固定資產	15,479	42,839
折舊費用	249,538	237,636	土地使用權增加	(19,279)	-
各項攤提	40,771	32,490	存出保證金(增加)減少	(499)	(397)
處分投資利益	-	(13)	遞延費用(增加)減少	(43,587)	(22,194)
採權益法認列之投資損失(收益)	(3,857)	31	債券發行成本增加	(331)	-
處分固定資產損失	5,991	-	取得多數股權價款	-	(176,229)
處分固定資產利益	(2,459)	(6,855)	投資活動之淨現金流出	(605,165)	(402,302)
估列公司債應付利息補償金	928	-			
應收票據淨額(增加)減少	(14,067)	(15,558)	融資活動之現金流量：		
應收帳款淨額(增加)減少	(68,807)	(66,048)	其他應付款一關係人增加(減少)	(44,892)	68,301
應收帳款一關係人(增加)減少	-	2,183	子公司發放現金股利及員工紅利	(24,901)	(1,626)
其他應收款(增加)減少	(367)	46,032	舉借(償還)短期借款	183,491	(166,024)
其他應收款一關係人(增加)減少	-	2,128	應付短期票券增加(減少)	(9,986)	(9,512)
存貨淨額(增加)減少	(267,686)	(87,606)	舉借(償還)長期借款	25,499	184,363
預付款項(增加)減少	(11,783)	6,295	發行可轉換公司債	200,000	-
其他流動資產(增加)減少	8,632	30,536	購入庫藏股	(67,220)	-
遞延所得稅資產淨額一流動(增加)減少	9,923	(41,094)	子公司少數股權現金增資款	35,240	-
遞延所得稅資產淨額一非流動(增加)減少	(9,217)	(34,169)	融資活動之淨現金流入	297,231	75,502
應付票據增加(減少)	269	(6,956)			
應付帳款增加(減少)	43,099	16,120	匯率影響數	30,809	6,197
應付帳款一關係人增加(減少)	69	(6,815)	本期現金及約當現金(減少)數	6,830	(23,265)
應付所得稅增加(減少)	1,077	(290)	期初現金及約當現金餘額	147,894	171,159
應付費用增加(減少)	33,303	9,181	期末現金及約當現金餘額	\$154,724	\$147,894
遞延所得稅負債一流動增加(減少)	-	(1,161)			
其他流動負債增加(減少)	42,286	(10,933)	現金流量資訊之補充揭露：		
應計退休金負債增加(減少)	1,870	1,671	本期支付利息(不含資本化利息)	\$25,065	\$37,778
合併借項(增加)減少	-	(23,825)	本期支付所得稅	\$21,135	\$2,515
少數股權增加(減少)	(8,758)	(11,206)	支付現金購置固定資產	\$296,401	\$230,903
換算調整數增加(減少)	(37,243)	(10,354)	購置固定資產	(19,756)	781
			應付設備款(增加)減少	\$276,645	\$231,684
			支付現金		
營業活動之淨現金流(出)入	283,955	297,338	不影響現金流量之投資及融資活動：		
			一年內到期之長期借款	\$111,468	\$182,009
			累積換算調整數之增加(減少)數	\$(37,243)	\$(10,354)
			長期股權投資轉列庫藏股票	\$1,847	\$2,347
			被投資公司出售本公司股票產生之資本公積	\$100	\$794

(請參閱合併財務報表附註)

負責人：

經理人：

主辦會計：

合晶科技股份有限公司及其子公司
合併財務報表附註
民國九十三年十二月三十一日
及民國九十二年十二月三十一日(重編後)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

一、公司沿革

(一) 本公司-合晶科技股份有限公司

合晶科技股份有限公司(以下簡稱本公司)於民國八十六年七月二十四日奉准設立。

本公司主要業務為：

1. 半導體及其材料之研發、設計、製造、進出口及代理銷售。
2. 半導體晶圓材料及晶圓加工設備與零組件之設計、加工、進出口銷售及售後服務。
3. 前各項產品之技術移轉及其諮詢顧問業務。

本公司股票於民國九十一年五月十三日經櫃檯買賣中心(九一)證櫃上字第一八三六四號函核准上櫃，並自民國九十一年五月十六日起於櫃檯買賣中心開始櫃檯買賣。

本公司及其子公司民國九十三及九十二年十二月三十一日之員工人數分別為883人及812人。

(二) 列入本關係企業合併財務報表之從屬公司：

從屬公司名稱	與本公司之關係	業務性質	本公司之持股或出資比率
Wafer Works Investment Corp.	本公司出資額超過其資本總額 50%	投資控股	100%
Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.	本公司出資額超過其資本總額 50%	對科技事業之投資及半導體矽晶圓材料銷售	民國九十二年度係由本公司 100% 持有之子公司，民國九十三年度則變更由 Wafer Works Investment Corp. 轉投資而持有 100% 股權之孫公司。

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

上海合晶硅材料有限公司	本公司出資額超過其資本總額 50%	經營晶圓製造	由孫公司 Silicon Technology (Cayman) Corp. 轉投資而持有 75% 之曾孫公司。
Wafermaster Investment Corp.	本公司出資額超過其資本總額 50%	投資控股	係由子公司 Wafer Works Investment Corp. 轉投資而持有 100% 股權之孫公司。
Helitek Company Ltd.	本公司出資額超過其資本總額 50%	半導體矽晶圓材料之製造及銷售	民國九十二年度係由子公司 Silicon Technology Investment (Cayman) Corp. 轉投資而持有 100% 股權之孫公司，民國九十三年度則變更由 Wafermaster Investment Corp. 轉投資而持有 100% 股權之曾孫公司。
上海晶技電子材料有限公司	本公司出資額超過其資本總額 50%	經營晶圓、已滲雜業務	民國九十二年度係由孫公司 Silicon Technology Investment (Cayman) Corp. 轉投資而持有 100% 股權之孫公司，民國九十三年度則變更由孫公司 Wafermaster Investment Corp. 轉投資而持有 100% 股權之曾孫公司。

(三) 未列入本關係企業合併財務報表之從屬公司：

從屬公司名稱	本公司持股或出資比例	未合併之原因
晶材科技股份有限公司	99.99%	其總資產及營業收入均未達母公司各該項金額百分之十以上。

(四) 列入合併報表子公司本期增減變動情形：

本公司本期新增子公司「上海合晶硅材料有限公司」，持股達 75%，依財務會計準則第七號規定應編入合併報表；為使報表編製主體一致，因是重編民國九十二年度合併財務報表。

(五) 從屬公司會計期間與母公司不同之調整及處理方式：不適用。

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

(六) 國外從屬公司營業之特殊風險：不適用。

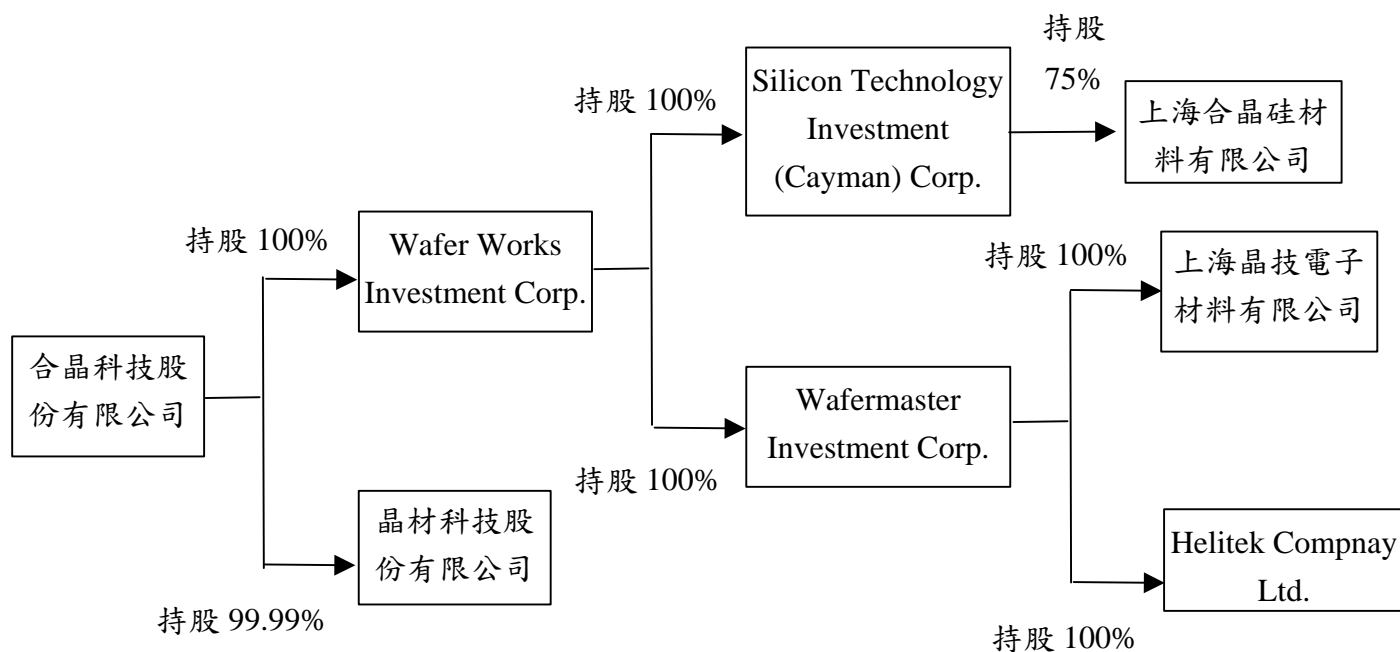
二、重要會計政策之彙總說明

本財務報表係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製。重要會計政策彙總說明如下：

1. 合併財務報表之編製政策

(1) 母公司：合晶科技股份有限公司。

(2) 截至民國九十三年十二月三十一日止，本公司長期股權投資結構圖如下：



(3) 屬公司間交易所產生之損益科目及債權債務科目均予相互沖銷，詳閱附註十.(三)。

(4) 合併借(貸)項：

係母公司取得子公司股權成本高於(或低於)子公司該項股權之淨值，依財務會計準則公報第五號第 39 段規定無法分析其產生原因者，本公司按二十年平均攤提。

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

2. 外幣財務報表換算及外幣交易

- (1) 本公司之交易事項係以新台幣為記帳單位，子公司及子公司合併之被投資公司之交易事項分別以當地流通之貨幣為記帳單位。以外幣為準之交易事項係按交易發生時之匯率折算記帳貨幣入帳。至於資產負債表日未收取或未償付之外幣債權或債務，則按資產負債表日之匯率調整，當期損益或股東權益，因匯率變動所發生之損失或利益，列為當期損益。

子公司及子公司合併之被投資公司其記帳貨幣單位列示如下：

公司名稱	記帳單位
Wafer Works Investment Corp.	美金
Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.	美金
Wafermaster Investment Corp.	美金
Helitek Company Ltd.	美金
上海晶技電子材料有限公司	人民幣
上海合晶硅材料有限公司	人民幣

- (2) 編製合併報表時，國外子公司之財務報表均換算為新台幣財務報表。所有資產、負債科目均按資產負債表日之匯率換算，股東權益中，除期初保留盈餘以上期期末結算之餘額結轉外，其餘均按歷史匯率換算，損益科目按當期加權平均匯率換算。因外幣財務報表換算所產生之差額作為股東權益項下之換算調整數。

3. 約當現金

約當現金係指隨時可轉換成定額現金，且即將到期而其利率變動對其價值影響甚小之投資，通常包括自投資日起三個月內到期或清償之國庫券、商業本票及銀行承兌匯票等。

4. 短期投資

短期投資係以取得成本為入帳基礎，成本之計算係採移動加權平均法，期末並按成本與市價孰低法評價。

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

5. 備抵呆帳

備抵呆帳係依據過去實際發生呆帳之經驗，衡量資產負債表日應收票據、應收帳款等各項債權之帳齡情形及其收回之可能性，予以評估提列。

6. 存 貨

存貨係採永續盤存制度，其成本之計算採加權平均法，期末則按成本與市價孰低法評價，比較成本與市價孰低時，係採總額法比較。市價之決定除在製品、製成品及商品係指淨變現價值法外，餘係指重置成本。對於呆滯存貨則另提列備抵跌價損失。

7. 長期股權投資

- (1) 以取得成本為入帳基礎，並按一般公認會計原則之規定，分別採權益法或成本法予以評價。
- (2) 取得股票股利時，僅註記增加之股數，重新計算每股成本。股票出售時按加權平均法計算成本及出售損益。
- (3) 持有被投資公司表決權比例達 20% 或具有重大影響力，按權益法評價，並將帳列投資成本與股權淨值間之差額分二十年逐年平均攤提，有關海外投資時外幣財務報表之換算依以下方式處理：
 - A. 若國外營運機構外幣財務報表之幣別非為功能性貨幣時，先將該外幣財務報表依功能性貨幣再衡量，再衡量所產生之兌換差額，列為當期損益。
 - B. 國外營運機構之財務報表以功能性貨幣編製或再衡量後，若該功能性貨幣與本國貨幣不同時，需轉換為新台幣財務報表，其因換算產生之差額，列為「累積換算調整數」作為被投資公司股東權益之調整項目，本公司依持股比例承認之，並作為本公司股東權益之調整項目。
- (4) 本公司與採權益法評價之被投資公司間交易所產生之損益，於本年度尚未實現者，應加以消除；交易損益如屬折舊、折耗或攤銷性質之資產所產生者，依其效益年限分年承認；其餘之資產所產生者，俟實現年度始行認列。

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

- (5) 對持有表決權比例超過百分之五十者，採權益法評價並編製合併報表，惟若被投資公司當年度總資產或營業收入未達本公司各該項金額百分之十，僅按權益法評價，不另編製合併報表，但所有未達編入合併報表標準之子公司合計總資產或營業收入已達本公司各該項金額百分之三十以上者，仍將總資產或營業收入達本公司各該項金額百分之三以上之子公司編入合併報表，嗣後除非所占比率降至百分之二十，否則仍繼續編入合併報表。

8. 固定資產

- (1) 現有固定資產均於購建時以成本入帳，重大改良及更新作為資本支出，列入固定資產，修理及維護支出則列作當年度費用。
- (2) 為新建及擴建工程與設備之預付款項，於發生貸款後至財產達到可供使用狀態下，其為該資產所支出款項而負擔之利息，應予資本化。
- (3) 折舊係依資產之估計耐用年數，以直線法計提。另已達耐用年限而繼續使用之設備，再按估計之耐用年限，並預留殘值一年，以直線法計提折舊。
- (4) 處分固定資產損益列為當年度之損益項目。

9. 無形資產

係土地使用權，其具有未來經濟效益之支出，以實際發生成本為入帳基礎，並按15~30年平均攤銷。

10. 遞延費用

係包括工廠電力、自來水工程裝置費及電腦軟體費與其他具有未來經濟效益之支出，以實際發生成本為入帳基礎，並按一~十年平均攤提。

11. 衍生性金融商品交易

本公司為規避外幣債權債務之匯率變動風險，與銀行簽訂預售之遠期外匯買賣合約，並於訂約日以該日即期匯率衡量入帳，訂約日即期匯率與約定遠期匯率之差額，則於合約期間攤銷。至資產負債表日尚未結清之合約，則按資產負債表日之匯率調整，所產生之兌換損益列為當期損益。遠期外匯買賣合約所產生之應收及應付款項餘額互抵後，其差額列為資產或負債。遠期外匯買賣合約履約結清時所產生之兌換差額，列為結清年度之損益。

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

12. 退休金

- (1) 本公司訂有員工退休辦法，依「勞動基準法」之規定，報經主管機關核准，自民國八十八年三月起算按每年已付薪資總額百分之二點三提撥退休準備金，並撥交由勞工退休準備金監督委員會專戶儲存及支用，由於此項退休準備金與本公司完全分離，故未包含於財務報表中。

本公司自八十七年底起，依照財務會計準則公報第十八號「退休金會計處理準則」，以八十七年十二月三十一日為衡量日完成精算，其累積給付義務超過退休基金資產公平價值部分，於資產負債表認列最低退休金負債，並自民國八十八年一月一日起認列淨退休金成本；有關未認列過渡性淨資產或淨給付義務係按十五年採直線法攤銷；未認列退休金損益係按十年採直線法攤銷。

- (2) Helitek Company Ltd. 依當地法令規定，每期依員工薪資之一定比率報繳當地政府，公司無須支付退休金。

13. 應付公司債

- (1) 附賣回權之轉換公司債約定賣回價格高於轉換公司債面額之利息補償金，於發行日至賣回權期間屆滿日之期間，按利息法認列利息費用並提列應付利息補償金。如債券持有人逾期未行使賣回權，致賣回權失效，則按利息法自約定賣回期限屆滿日次日起至到期日之期間攤銷已認列為負債之利息補償金。

- (2) 債券持有人行使轉換權利時，按帳面價值法處理，將該轉換公司債之發行成本、應付利息、債券持有人應繳回之債息、已認列之利息補償金負債及轉換公司債面額一併轉銷，並以該轉銷淨額超過債券換發普通股面額部份，列為資本公積。

14. 所得稅

所得稅估列係依財務會計準則公報第二十二號「所得稅之會計處理準則」之規定作跨期間與同期間之所得稅分攤。將應課稅暫時性差異所產生之所得稅影響數認列為遞延所得稅負債，與將可減除暫時性差異、虧損扣抵及所得稅抵減所產生之所得稅影響數認列為遞延所得稅資產，再評估其遞延所得稅資產之可實現性，認列其備抵評價金額。遞延所得稅資產或負債依其相關資產或負債之分類劃分為流動或非流動項目，無相關之資產負債者，依預期回轉期間之長短期劃分為流動或非流動項目。

本公司未分配盈餘加徵百分之十營利事業所得稅部分，於股東會決議分配盈餘之日列為當期費用。

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

Helitek Company Ltd.之所得稅會計處理係依美國當地財務會計準則 SFAS NO.109「所得稅會計」，使用資產負債表法來處理遞延所得稅，衡量其未來所得稅影響數來認列遞延所得稅資產及負債，再評估其遞延所得稅資產之可實現性，估列備抵評價金額，與本公司並無重大差異。

15. 收入認列

本公司之收入認列，係依照財務會計準則公報第三十二號「收入認列之會計處理準則」之規定處理。

16. 每股盈餘

本公司依財務會計準則公報第二十四號「每股盈餘」之規定計算每股盈餘。基本每股盈餘以普通股股東之本期淨利(損)除以普通股加權平均流通在外股數；稀釋每股盈餘則以普通股股東之本期淨利(損)調整具稀釋作用之潛在普通股之股利、具稀釋作用之潛在普通股於本期已認列之利息費用及具稀釋作用之潛在普通股因轉換而產生之任何其他收入與費用之變動後，除以普通股加權平均流通在外股數加上所有具稀釋作用之潛在普通股轉換為普通股之加權平均流通在外股數。

17. 庫藏股票

本公司依財務會計準則公報第三十號「庫藏股票會計處理準則」之規定，對於公司收回已發行股票作為庫藏股票時採成本法處理。本公司買回之庫藏股票成本在資產負債表作為股東權益減項。而庫藏股票交易之價差則作為資本公積調整列於股東權益項下；另本公司自民國九十一年一月一日起對於子公司晶材科技股份有限公司持有本公司股票之會計處理係依照財務會計準則第三十號公報「庫藏股票會計處理準則」規定視同庫藏股票處理之。

三、會計變動之理由及其影響

無此情形。

四、重要會計科目之說明

1. 現金及約當現金

	93.12.31	92.12.31(重編後)
零用金	\$302	\$367
支票及活期存款	154,422	147,527
合計	\$154,724	\$147,894

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

2. 應收票據淨額

	93.12.31	92.12.31(重編後)
應收票據	\$55,551	\$41,484
減：備抵呆帳	-	-
淨 額	<u>\$55,551</u>	<u>\$41,484</u>

3. 應收帳款淨額

(1)應收帳款明細如下：

	93.12.31	92.12.31(重編後)
應收帳款	\$465,073	\$391,491
減：備抵呆帳	(7,836)	(3,061)
淨 額	<u>\$457,237</u>	<u>\$388,430</u>

(2)有關資產提供作為擔保或質押之情形，詳閱附註六。

4. 存貨淨額

(1)存貨明細如下：

	93.12.31	92.12.31(重編後)
原 料	\$223,950	\$77,301
物 料	86,502	54,854
在 製 品	166,956	146,690
製 成 品	185,470	96,528
商 品	2,345	13,112
合 計	665,223	388,485
減：備抵存貨跌價損失	(24,353)	(15,301)
淨 額	<u>\$640,870</u>	<u>\$373,184</u>

(2)民國九十三年及九十二年十二月三十一日存貨之投保保險金額分別為 326,501 仟元及 305,967 仟元。

(3)上述存貨無提供作為擔保或質押之情形。

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

5. 長期股權投資

(1) 民國九十三年及九十二年十二月三十一日長期股權投資明細如下：

被投資公司名稱	持有股數	帳面價值	當期認列投資(損)益	持股比例
<u>93.12.31</u>				
採權益法之長期投資				
晶材科技股份有限公司	499,994	\$9,627	\$3,857	99.99%
<u>92.12.31(重編後)</u>				
採權益法之長期投資				
晶材科技股份有限公司	499,994	\$5,170	\$(31)	99.99%

(2) 上述長期股權投資均無提供作為擔保或質押之情形。

6. 固定資產

(1) 固定資產累計折舊之明細如下：

項 目	93.12.31	92.12.31(重編後)
房屋及建築物	\$83,452	\$89,290
機器設備	1,034,959	852,700
運輸設備	7,906	8,352
辦公設備	24,141	27,763
什項設備	30,674	17,084
合 計	\$1,181,132	\$995,189

(2) 截至民國九十三年及九十二年十二月三十一日止，本公司固定資產投保保險金額分別為 2,234,318 仟元及 2,112,383 仟元。

(3) 民國九十三年及九十二年一月一日至十二月三十一日利息資本化明細如下：

	九十三年度	九十二年度
利息資本化前之利息總額	\$29,782	\$38,611
資本化利息之金額	3,731	1,514
資本化利率	2.90%	4.70%
資本化設備名稱	預付設備款	機器設備

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

(4) 上述固定資產提供擔保或質押情形請詳附註六。

7. 催收款淨額

	93.12.31	92.12.31
催收款	\$257	\$-
減：備抵呆帳	(257)	-
淨 額	\$-	\$-

8. 短期借款

	93.12.31	92.12.31(重編後)
購料借款(一年內到期)	\$80,565	\$170,652
信用借款(一年內到期)	18,888	100,000
擔保借款(一年內到期)	436,193	81,503
合 計	\$535,646	\$352,155

(1) 民國九十三年及九十二年十二月三十一日短期借款之借款利率分別為 1.123%~5.58% 及 1.13%~7.18%。

(2) 提供短期借款之擔保品，請參閱財務報表附註六。

9. 應付短期票券淨額

應付短期票券淨額明細如下：

保證機構	發行期間	金 額	利率	擔保品
<u>93.12.31</u>				
商業本票：				
中華票券金融股份有限公司	93.11.15-94.01.14	\$30,000	1.152%	無
大中票券金融股份有限公司	93.11.09-94.01.07	10,000	1.110%	無
合 計		40,000		
減：應付短期票券折價		(15)		
淨 額		\$39,985		

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

92.12.31

商業本票：

合作金庫—中壢分行	92.11.17-93.1.16	\$30,000	1.17%	無
大眾銀行—新竹分行	92.11.18-93.1.16	20,000	1.00%	無
合 計		50,000		
減：應付短期票券折價		(29)		
淨 額		\$49,971		

10.應付公司債

(1)應付公司債明細如下：

	93.12.31	92.12.31
無擔保可轉換公司債面額	\$200,000	\$-
加：應付利息補償金	928	-
合 計	\$200,928	\$-

(2)本公司為配合償還借款及購置設備，於民國九十三年五月十九日發行國內第一次無擔保可轉換公司債，主要發行條款如下：

A.發行總額：

第一次發行公司債：發行總額新台幣 200,000 仟元，每張面額新台幣 100 仟元，依票面金額十足發行。

B.發行期間：發行期間五年，於民國 93 年 5 月 19 日發行，至 98 年 5 月 18 日到期。

C.債券票面利率及還本付息方式：票面利率 0%，除依轉換辦法規定轉換為本公司普通股者，或本公司提前贖回者，或債權人要求本公司提前贖回者外，到期時以現金一次還本。

D.擔保情形：

本轉換公司債為無擔保債券，惟如本轉換公司債發行後，本公司另發行其他有擔保附認股權或轉換公司債時，本轉換公司債亦將比照該有擔保附認股權或轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

E.轉換期間：

債權人得於本轉換公司債發行之日起滿一個月後，至到期日前十日止，除依法暫停過戶期間及下列期間外，得隨時向本公司股務代理機構請求依發行及轉換辦法規定將所持有之本轉換公司債轉換為本公司新發行之普通股。

- (一)「本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽辦當年度無償配股基準日與配息基準日之公告日前三個營業日」後至「無償配股基準日與配息基準日(以較晚者)」之期間。
- (二)「本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽辦當年度現金增資認股基準日之公告日前三個營業日」後至「當年度現金增資認股基準日」之期間。
- (三)「本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心洽辦當年度之合併基準日之公告日前三個營業日」後至「當年度合併基準日」之期間，或「決定當年度之分割基準日之公告日前三個營業日」後至「當年度分割基準日」之期間。

F.轉換價格及其調整：

以民國九十三年五月五日為轉換價格基準日，依此計算發行時之轉換價格為20元。

本轉換公司債發行後，除本公司流通在外之具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份者外，遇有本公司已發行之普通股股份增加時(以低於轉換價格辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、員工紅利轉增資、公司合併、股票分割或現金增資參與發行海外存託憑證，但不包括本公司買回公司股份辦理銷除股份者)及有低於每股時價之轉換或認股價格再發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券，或非因辦理現金增資而賦與他人發行普通股認股權時，轉換價格依發行條款規定公式調整之。

截至民國九十三年十二月三十一日止，轉換價格已依上述規定修正為19.4元。

G.本公司對本轉換公司債之贖回權：

本轉換公司債發行滿一年後翌日起至發行期間屆滿前四十日止，於下列情形時：

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

- (1) 若本公司普通股在櫃檯買賣中心之收盤價連續三十個營業日超過當時轉換價格達百分之五十(含)其後三十個營業日內。
- (2) 本轉換公司債權人請求轉換後，其尚未轉換之債權總金額低於新台幣 20,000 仟元(發行總額之 10%)。

本公司得按以下之債券贖回收益率(自本債券發行日起至債券收回基準日止)計算收回價格，以現金收回其全部債券：

1. 發行滿一年後翌日起至發行滿二年之日(含)前，贖回價格訂為本債券面額加計按 0.75% 年收益率計算之利息補償金(自本債券發行日起，計算至贖回基準日止)。
 2. 發行滿二年後之翌日起至本轉換公司債到期前四十日止，贖回價格訂為本債券面額。
- (3) 若債權人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前，未以書面回覆本公司股務代理機構(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳為憑)者，本公司得按當時之轉換價格，以通知期間屆滿日為轉換基準日，將其轉換公司債轉換為普通股。

H. 債券持有人之賣回權：

本公司應於本轉換公司債發行滿二年、三年及四年之前三十日，以掛號發給債權人一份「債券持有人賣回權行使通知書」，並函請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告本轉換公司債持有人賣回權之行使，債權人得於公告後三十日內以書面通知本公司股務代理機構(於送達時即生效力，並以該期間屆滿日為賣回基準日，採郵寄者以郵戳為憑)要求本公司以債券面額加計利息補償金(發行滿二年為債券面額之 101.5056%，收益率為 0.75%；發行滿三年、四年為債券面額之 100.00% 賣回，收益率為 0%)，將其所持有之本轉換公司債以現金贖回。

I. 受託人及重要約定：

- (1) 所有本公司收回(包括由次級市場買回)、償還或已轉換之本轉換公司債將被註銷，不再發行，其所表彰之轉換權利併同消滅。

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

- (2)本轉換公司債及所換發之普通股均為記名式，其過戶、異動登記、設質、遺失等均依「公開發行股票公司股務處理準則」之規定，另稅負事宜依當時之稅法之規定辦理。
- (3)本轉換公司債由建華銀行信託部為債權人之受託人，依發行及轉換辦法及受託契約代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行本轉換公司債發行事項之權利義務。
- (4)本轉換公司債由本公司股務代理機構辦理還本付息及轉換事宜。
- (5)凡持有本轉換公司債之債權人不論係於發行時認購或中途買受者，對於本公司與受託人之間所訂受託契約規定、受託人之權利義務及發行轉換公司債辦法，均予同意並授與受託人有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷，並同意授受本公司債發行及轉換辦理。至於受託契約內容，債權人得在規定營業時間內，隨時至本公司或受託人營業處所查閱。

11. 長期借款

- (1) 民國九十三年及九十二年十二月三十一日之長期借款內容如下：

債權人	利率		期間	借款金額	
	93.12.31	92.12.31		93.12.31	92.12.31 (重編後)
擔保借款	2.96%~3.60%	3.65%~5.715%	89.09.15- 99.01.15	\$178,615	\$348,001
信用借款	1.00%~3.40%	3.65%~5.50%	92.11.26- 96.06.18	395,945	201,060
合計				574,560	549,061
減：一年內到期之長期借款				(111,468)	(182,009)
一年以上到期之長期借款				\$463,092	\$367,052

- (2) 上述長期借款按月(季)平均攤還本金，而對台新銀行—新科分行則為借款期間3個月，到期日後再續借。
- (3) 上述與中華開發工業銀行之借款(該借款已於民國九十三年一月十五日償還完畢)，依合約規定不得將所取得之資金在大陸地區從事直接或間接投資或技術合作，亦不得以使用本授信資金所取得之財產、信用或其他對價(簡稱變價資產)，或以變價資產更為交易而取得之資產、信用或其他資產(衍生資產)，在大

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

陸地區從事直接或間接投資或技術合作。

- (4) 本公司承諾債權人中華開發工業銀行，在民國九十二年六月底起之流動比率不得低於一，負債比率不得高於 1.56，若未能達到上述財務比率，應按當年六月底授信餘額千分之二計收違約金，於當年七月底前繳付。
- (5) 本公司承諾債權人台新商銀，負債比率不得高於 0.75，流動比率不得低於 0.75，違反比率須經該行同意。
- (6) 本公司承諾債權人建華商銀，負債比率不得高於 1.5，流動比率不得低於 1，違反比率須經該行同意。
- (7) 有關資產提供質押擔保情形，請詳附註六。

12. 退休金

(1) 民國九十三及九十二年度認列之退休金成本明細如下：

	九十三年度	九十二年度
服務成本	\$5,517	\$4,038
利息成本	633	489
退休基金資產之預期報酬	(359)	(311)
未認列過渡性淨給付義務攤銷數	98	98
未認列退休金損失攤銷數	-	-
淨退休金成本	<u>\$5,889</u>	<u>\$4,314</u>

(2) 民國九十三及九十二年十二月三十一日之基金提撥狀況與帳載應計退休金負債調節如下：

	93.12.31	92.12.31
給付義務：		
既得給付義務	\$(1,745)	\$(1,281)
非既得給付義務	(16,964)	(13,179)
累積給付義務	(18,709)	(14,460)
未來薪資增加之影響數	(6,353)	(3,630)
預計給付義務	(25,062)	(18,090)
退休基金資產公平價值	13,456	10,269
提撥狀況	(11,606)	(7,821)
未認列過渡性淨給付義務	885	984
未認列退休金損(益)	1,460	406
應計退休金負債	<u>\$(9,261)</u>	<u>\$(6,431)</u>

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

民國九十三年及九十二年十二月三十一日預計於未來一年內撥付中央信託局之應計退休金負債分別為 3,405 仟元及 2,445 仟元，帳列應付費用項下。

(3)計算淨退休金成本所用之精算假設如下：

	93.12.31	92.12.31
折現率	3.50%	3.50%
未來薪資水準增加率	2.00%	1.50%
退休基金資產預期長期投資報酬率	3.50%	3.50%

(4)截至民國九十三年及九十二年十二月三十一日止，本公司職工退休辦法之既得給付為 1,745 仟元及 1,281 元。

13.股本

本公司民國九十二年一月一日額定股本為 2,500,000 仟元，每股面額 10 元，計分為 250,000,000 股，業已發行 150,000,000 股，每股面額 10 元，實收股本為 1,500,000 仟元。

民國九十三年六月十五日經股東會決議辦理以資本公積 45,000 仟元轉增資，並於民國九十三年七月二十九日經董事會決議以同年八月三十一日為增資基準日，前述增資案業於民國九十三年十月五日完成變更登記，增資後額定股本為 2,500,000 仟元，每股面額 10 元，分為 250,000,000 股，已發行 154,500,000 股。

14.資本公積

- (1) 以現金增資溢價發行之資本公積，依公司法規定，資本公積除用以彌補公司虧損及撥充資本外，不得使用。公司非於盈餘公積填補資本虧損，仍有不足時，不得以資本公積補充之。
- (2) 以現金增資溢價發行之資本公積轉增資撥充者，每年以一次為限，且不得於現金增資年度將該增資溢價發行之資本公積撥充資本，而每次轉增資均須依規定限額辦理。
- (3) 本公司於民國九十三年六月十五日股東常會決議，以資本公積彌補虧損 117,810 元。

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

15. 盈餘分配及股利政策

(1) 盈餘分配

年度總決算如有盈餘時，應先提繳稅款、彌補以前年度之虧損，次提百分之十為法定盈餘公積及依主管機關要求提列之特別盈餘公積後，得並同以往年度累積盈餘，作為可分配盈餘，惟視業務狀況酌予保留外，依下列比率分派之：

- (1) 股東紅利百分之八十八。
- (2) 員工紅利百分之十。
- (3) 董監酬勞百分之二。

(2) 股利政策

本公司股利政策係依據營運規劃、投資計畫、資本預算及內外部環境變化由董事會予以訂定。本公司係屬營運成長階段之資本密集行業，需保留充足之資金以因應營業成長及資本支出之所需，故現階段本公司股利政策係以股票股利以不低於當年度可分配之股東紅利之百分之五十為原則。

員工紅利以現金或股票發放之比率與該同一年度之股東紅利相同。

本公司民國九十二及九十一年度為虧損，故無盈餘分配；另配合財政部證期會民國九十二年一月三十日台財證六字第○九二○○○○四五七號函規定，有關九十四年度董事會擬議之九十三年度盈餘分配案及股東會決議通過盈餘分配案之員工紅利及董監事酬勞等相關訊息，可至公開資訊觀測站中查詢。

16. 庫藏股票

- (1) 子公司晶材科技股份有限公司持有本公司股票自長期投資轉列庫藏股票之變動情形如下：

	期初股數	本期增加	本期減少	期末股數
93.01.01-93.12.31	233,500 股	-股	50,000 股	183,500 股
92.01.01-92.12.31	630,500 股	-股	397,000 股	233,500 股

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

有關當期該庫藏股票之處分價款、期末帳面價值及市價列示如下：

	處分價款	期末帳面價值	市價或股權淨值
93.12.31	600 仟元	1,847 仟元	2,349 仟元
92.12.31	4,764 仟元	2,347 仟元	3,129 仟元

(2)本公司於民國九十三年八月三十一日起自證券集中交易市場陸續買回本公司股份，截至民國九十三年十二月三十一日止，其增減變動情形如下：

收回原因	期初股數	本期增加	本期減少	期末股數
轉讓予員工	-	5,000,000 股	-	5,000,000 股

證券交易法規定公司買回已發行在外股份之數量比例，不得超過公司已發行股份總數百分之十，收買股份之總金額，不得逾保留盈餘加計發行股份溢價及已實現之資本公積之金額，若以民國九十三年十二月三十一日為計算基礎，買回股數最高上限為 15,450 仟股，收買股份金額最高上限為 313,700 仟元。本公司截至民國九十三年十二月三十一日止，買回之庫藏股票股數為 5,000 仟股，買回之庫藏股金額為 67,220 仟元。

(3)本公司庫藏股票係依公司法規定持有，依法不得享有表決權。但子公司持有母公司股票視同庫藏股票處理者，仍享有股東權益。

(4)本公司持有之庫藏股票依證券交易法規定不得質押，亦不得享有股利之分派、表決權等權利，另所買回之股份自購入完成日起三年內應將其轉讓予員工，逾期末轉讓者，視為未發行股份，應辦理資本額變更登記。

17.營業收入淨額

	九十三年度	九十二年度 (重編後)
營業收入包括：		
成品銷售	\$2,136,979	\$1,668,303
勞務提供	39,016	33,579
減：銷貨退回或折讓	(8,006)	(18,053)
營業收入淨額	<u>\$2,167,989</u>	<u>\$1,683,829</u>

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

18. 用人、折舊及攤銷費用

功能別 性質別	九十三年度			九十二年度(重編後)		
	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合計	屬於營業 成本者	屬於營業 費用者	合計
用人費用						
薪資費用	\$130,927	\$65,537	\$196,464	\$91,547	\$63,055	\$154,602
勞健保費用	8,823	4,265	13,088	8,253	3,437	11,690
退休金費用	3,722	2,167	5,889	2,822	1,492	4,314
其他用人費用	49,105	17,537	66,642	42,219	14,246	56,465
折舊費用	232,809	16,729	249,538	211,110	26,526	237,636
攤銷費用	27,928	12,843	40,771	20,289	12,201	32,490

19. 所得稅

(1) 遞延所得稅負債與資產：		93.12.31		92.12.31(重編後)	
① 遞延所得稅資產總額		\$185,960		\$216,537	
② 遞延所得稅負債總額		\$-		\$-	
③ 遞延所得稅資產之備抵評價金額		\$84,805		\$114,676	
		93.12.31		92.12.31(重編後)	
		暫時性 差異金額	所得稅 影響金額	暫時性 差異金額	所得稅 影響金額
④ 產生遞延所得稅資產或負債之暫時性差異：					
存貨跌價損失之認列所產生之可減除暫時性差異	\$23,219	\$5,743	\$14,000	\$3,500	
呆帳費用之認列所產生之可減除暫時性差異	4,641	1,584	-	-	
兌換損益之認列所產生之可減除(應課稅)暫時性差異	2,039	510	301	75	
職工福利之認列所產生之可減除暫時性差異	461	115	1,002	251	
退休金費用之認列所產生之可減除暫時性差異	9,837	2,459	7,008	1,752	
未實現銷貨損益之認列所產生之可減除暫時性差異	2,191	436	7,477	1,869	
逾二年應付款項轉列收入之認列所產生之可減除暫時性差異	3,453	863	-	-	

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

投資損(益)之認列所產生之可減除 (應課稅)暫時性差異	10,864	2,716	70,625	17,656
技術作價投資轉列收入之認列所產 生之可減除暫時性差異	74,953	18,738	-	-
其他損益之認列所產生之可減除暫 時性差異	-	10,654	-	-
⑤產生遞延所得稅資產之所得稅抵減		63,280		57,910
⑥本公司虧損扣抵產生之所得稅抵減	308,298	77,075	474,293	118,573
⑦子公司虧損扣抵產生之所得稅抵減		1,787		14,951
		93.12.31	92.12.31(重編後)	
(2)遞延所得稅資產－流動		\$59,994	\$73,071	
備抵評價－遞延所得稅資產－流動		(28,823)	(31,977)	
淨遞延所得稅資產－流動		31,171	41,094	
遞延所得稅負債－流動		-	-	
流動遞延所得稅資產與負債抵銷後淨額		\$31,171	\$41,094	
		93.12.31	92.12.31(重編後)	
(3)遞延所得稅資產－非流動		\$125,966	\$143,466	
備抵評價－遞延所得稅資產－非流動		(55,982)	(82,699)	
淨遞延所得稅資產－非流動		69,984	60,767	
遞延所得稅負債－非流動		-	-	
非流動遞延所得稅資產與負債抵銷後淨額		\$69,984	\$60,767	
(4)所得稅費用估列如下：				
		九十三年度	九十二年 度 (重編後)	
應付所得稅(當期所得稅費用)		\$71,391	\$22,816	
兌換損益之認列所產生之遞延所得稅費用(利益)		(435)	1,039	
銷貨毛利之認列所產生之遞延所得稅利益		-	(48)	
未實現銷貨毛利之認列所產生之遞延所得稅費 用(利益)		1,433	(792)	
存貨跌價損失之認列所產生之遞延所得稅費用 (利益)		(2,243)	3,125	
呆帳費用之認列所產生之所得稅利益		(1,584)	-	
逾二年應付款項轉列收入之認列所產生之所得 稅利益		(863)	-	
投資損益之認列所產生之遞延所得稅費用		14,940	3,469	
職工福利之認列所產生之遞延所得稅費用		136	519	
退休金費用之認列所產生之遞延所得稅利益		(707)	(489)	
技術作價投資轉列收入之認列所產生之所得稅		(18,738)	-	

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

利益		
其他損益之認列所產生之遞延所得稅費用	(10,654)	-
產生遞延所得稅資產之所得稅抵減	(31,248)	(12,673)
虧損扣抵之認列所產生之所得稅費用	12,015	19,801
逾期末使用投資抵減數	20,203	-
備抵遞延所得稅資產評價提列(回轉)數	(29,871)	(104,330)
以前年度調整數	242	-
所得稅費用(利益)	<u>\$24,017</u>	<u>\$(67,563)</u>

(5)本公司民國八十九年度(含)以前之營利事業所得稅結算申報案件均經國稅局核定在案。

(6)所得稅抵減之法令依據、抵減項目、可抵減稅額、尚未抵減餘額及最後抵減年度列示如下：

法令依據	抵減項目	可抵減稅額	尚未抵減餘額	最後抵減年度
促進產業升級條例	機器設備	\$4,517	\$4,517	94
促進產業升級條例	機器設備	3,557	3,557	95
促進產業升級條例	機器設備	4,989	4,989	96
促進產業升級條例	機器設備	8,639	8,639	97
促進產業升級條例	研究及發展支出	6,362	6,362	94
促進產業升級條例	研究及發展支出	6,751	6,751	95
促進產業升級條例	研究及發展支出	12,298	12,298	96
促進產業升級條例	研究及發展支出	16,167	16,167	97
	合 計	<u>\$63,280</u>	<u>\$63,280</u>	

(7)截至民國九十三年十二月三十一日止，本公司尚未使用之可扣抵虧損金額及期限如下：

虧損年度	得扣抵之最後年度	申報虧損金額
89	94	\$148,312
90	95	110,617
91	96	49,369
合 計		<u>\$308,298</u>

(8)本公司增資擴展生產晶棒、晶圓之投資計劃，符合重要科技事業屬於製造業及技術服務業部份獎勵辦法規定，業經經濟部工業局工中二字第○八七二○二四二六一號函核准在案，並經財政部於民國九十一年八月二十一日經台財稅字第○九一○四五四七八八號函核准自產品開始銷售之日民國九十三年一月一日起連續五年內免徵營利事業所得稅。

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

(9)截至民國九十三年及九十二年十二月三十一日有關股東可扣抵稅額帳戶之資訊內容如下：

	93.12.31(預計)	92.12.31(實際)
股東可扣抵稅額帳戶餘額	\$3,698	\$3,698
八十七年度以後未分配盈餘	246,179	-
股東可扣抵稅額比率	1.50%	-

20. 每股盈餘

本公司為複雜資本結構，茲揭露每股盈餘如下：

	九十三年度	九十二年度
期初流通在外股數	150,000,000 股	150,000,000 股
期初長期股權投資轉列庫藏股票	(233,500)	(630,500)
子公司出售持有本公司庫藏股	40,983	113,789
購回庫藏股	(1,179,105)	
93.08.31資本公積轉增資 (150,000,000×3%)	4,500,000	4,500,000
基本每股盈餘之流通在外加權平均股數	<u>153,128,378 股</u>	<u>153,983,289 股</u>

	金額(分子)		股數 (分母)	每股盈餘(元)	
	稅前	稅後		稅前	稅後
<u>九十三年度：</u>					
基本每股盈餘					
屬於普通股股東之本 期純益	\$270,196	\$246,179	153,128,378 股	<u>\$1.76</u>	<u>\$1.61</u>
具稀釋作用之潛在普通 股之影響 1.5056% 轉 換公司債	928	928	6,394,006 股		
屬於普通股股東之本 期純益加潛在普通 股之影響	<u>\$271,124</u>	<u>\$247,107</u>	159,522,384 股	<u>\$1.70</u>	<u>\$1.55</u>

九十二年(重編後)：

基本每股盈餘					
本期純益	<u>\$163,064</u>	<u>\$230,627</u>	153,983,289 股	<u>\$1.06</u>	<u>\$1.50</u>

假設民國九十三年及九十二年子公司對本公司股票之投資不視為庫藏股票時之擬

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

制資料如下：

	金額 (分子)		股數 (分母)	每股盈餘 (元)	
	稅前	稅後		稅前	稅後
<u>九十三年度：</u>					
基本每股盈餘					
本期純益	\$270,296	\$246,279	153,320,895 股	\$1.76	\$1.61
具稀釋作用之潛在普通股之影響 1.5056% 轉換公司債	928	928	6,394,006 股		
屬於普通股股東之本期純益加潛在普通股之影響	<u>\$271,224</u>	<u>\$247,207</u>	159,714,901 股	<u>\$1.70</u>	<u>\$1.55</u>
<u>九十二年(重編後)：</u>					
基本每股盈餘					
本期純益	<u>\$163,858</u>	<u>\$231,421</u>	154,500,000 股	<u>\$1.06</u>	<u>\$1.50</u>

五、關係人交易

(一)關係人名稱及關係

關係人名稱	與本公司之關係
晶材科技股份有限公司	本公司之子公司
上海有色新材料(集團)有限公司	對上海合晶硅材料有限公司採權益法評價之投資公司

(二)與關係人間重大交易事項

1. 本公司與關係人之交易事項明細如下：

(1)銷貨

	九十三年度		九十二年(重編後)年度	
	金額	佔該科目淨額百分比	金額	佔該科目淨額百分比
晶材科技股份有限公司	<u>\$3,637</u>	<u>0.16%</u>	<u>\$-</u>	<u>-%</u>

上述關係人交易之計價方式與一般客戶相當，而收款條件係採交貨後 60 天以電匯方式收款，與一般客戶相當。

(2)進貨

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

	九十三年度		九十二年度	
	金額	佔該科目淨額百分比	金額	佔該科目淨額百分比
晶材科技股份有限公司	\$69	-%	\$-	-%

上述關係人交易之計價方式與一般客戶相當，而付款條件係採交貨後 60 天以電匯方式付款，與一般客戶相當。

2.本公司與關係人之債權債務情形如下(均未計息)：

(1)晶材科技股份有限公司

	93.12.31		92.12.31	
	金額	佔該科目淨額百分比	金額	佔該科目淨額百分比
應付帳款－關係人	\$69	0.04%	\$-	-%
預付款項	\$-	-%	\$96	0.23%

(2)上海有色新材料(集團)有限公司

	93.12.31		92.12.31	
	金額	佔該科目淨額百分比	金額	佔該科目淨額百分比
其他應付款－關係人	\$23,409	100.00%	\$68,301	100.00%

六、質押之資產

(1) 截至民國九十三年及九十二年十二月三十一日止，本公司有下列資產業已提供金融機構作為融資之擔保品：

質押資產名稱	金額	擔保性質
<u>93.12.31</u>		
受限制銀行存款	\$287,253	短期擔保借款
受限制銀行存款	2,300	外勞保證金擔保
受限制銀行存款	5,000	台北關稅局擔保金
受限制銀行存款	400	台北關稅局擔保金
固定資產－土地	258,550	長、短期擔保借款

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

固定資產－房屋及建築物	162,283	長、短期擔保借款
固定資產－機器設備	502,286	長期擔保借款
固定資產－預付設備款	18,643	長期擔保借款
合 計	<u>\$1,236,715</u>	

92.12.31(重編後)

應收帳款	\$19,751	短期擔保借款
受限制銀行存款	2,278	外勞保證金擔保
受限制銀行存款	6,972	短期擔保借款
受限制銀行存款	5,400	台北關稅局擔保金
固定資產－土地	258,550	長、短期擔保借款
固定資產－房屋及建築物	166,344	長、短期擔保借款
固定資產－機器設備	639,173	長期擔保借款
固定資產－預付設備款	42,800	長期擔保借款
合 計	<u>\$1,141,268</u>	

(2) 民國九十二年十二月三十一日止，子公司有下列資產業已提供金融機構等作為融資之擔保品：

質押資產名稱	金 額	抵質押機構	擔保性質
92.12.31			
固定資產－土地	\$8,739	美國銀行 A	長期借款
固定資產－房屋及建築物	92,517	美國銀行 A	長期借款
合 計	<u>\$101,256</u>		

七、重大承諾事項及或有事項

1. 截至民國九十三年十二月三十一日止，本公司已開發未使用之信用狀金額(外幣單位：仟元)如下：

幣別	信用狀總額	已繳保證金
日 幣	19,836 仟元	\$-
美 金	85 仟元	

2. 截至民國九十三年十二月三十一日止，本公司尚未完成之重大工程合約明細如下：

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

簽約人	合約性質	合約金額	(已)預付金額	未付金額
KCA TENCOR	SPI	\$27,552	\$24,832	\$2,720
創技工業股份有限公司	單面拋光機	18,000	15,300	2,700
合計		\$45,552	\$40,132	\$5,420

上列已付金額分別帳列固定資產未完工程及預付設備款項下。

八、重大之災害損失

無此事項。

九、重大之期後事項

無此事項。

十、其他

(一)金融商品之公平價值

金融商品	93.12.31		92.12.31(重編後)	
	帳面價值	公平價值	帳面價值	公平價值
<u>非衍生性金融商品</u>				
資產				
現金及約當現金	\$154,724	\$154,724	\$147,894	\$147,894
應收票據及款項淨額	512,788	512,788	429,914	429,914
其他應收款	14,940	14,940	17,330	17,330
受限制銀行存款	294,953	294,953	14,650	14,650
長期股權投資	9,627	9,627	5,170	5,170
負債				
短期借款	535,646	535,646	352,155	352,155
應付短期票券淨額	39,985	39,985	49,971	49,971
應付票據及款項(含關係人款)	162,091	162,091	118,654	118,654
應付費用	110,356	110,356	77,053	77,053
應付設備款	29,284	29,284	9,528	9,528
應付公司債	200,928	200,000	-	-
長期負債(含一年內到期者)	607,321	607,321	626,836	626,836
<u>衍生性金融商品</u>				

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

其他應收款

應收遠期外匯淨額	2,757	2,757	-	-
----------	-------	-------	---	---

其他流動負債

應付遠期外匯淨額	-	-	470	470
----------	---	---	-----	-----

本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下：

- (1) 短期金融商品以其在資產負債表上之帳面價值估計其公平價值，因為此類商品到期日甚近，其帳面價值應屬估計公平價值之合理基礎。此方法應用於現金及約當現金、應收票據及款項、其他應收款、受限制銀行存款、短期借款、應付短期票券淨額、應付票據及款項、應付費用及應付設備款等。
- (2) 長(短)期投資如有市場價格可循時，則以此市場價格為公平價值。若無市場價格可供參考時，則依財務或其他資訊估計公平價值。
- (3) 長期借款以其預期現金流量之折現價值估計公平價值，折現率以本公司所能獲得類似條件(相近之到期日)之長期借款利率為準。
- (4) 上櫃應付公司債因有市場價格可循，故以此市場價格為公平價格。
- (5) 衍生性金融商品之公平價值，係假設本公司若依約定在報表日終止合約，預計所能取得或必須支付之金額。一般均包括當期末結清合約之未實現損益。

(二)衍生性金融商品資訊

(1)合約金額(或名目本金金額)及公平價值：

民國九十三年十二月三十一日及九十二年十二月三十一日，尚未到期之遠期外匯合約金額如下：

金融商品	幣別	合約金額 (仟元)	公平價值 (仟元)	保證金	交割期日	到期值 (仟元)
<u>93.12.31</u>						
預售遠期外匯	USD	\$5,000	NTD 158,750	無	94.01.07~ 94.02.06	NTD 161,507
<u>92.12.31</u>						
預售遠期外匯	USD	\$2,000	NTD67,960	無	93.01.12~ 93.03.22	NTD67,960

(2)信用風險：

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)

(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

本公司之交易對象均為信用良好之銀行，因此交易相對人未履行合約而發生損失之風險甚小。

(3)市場價格風險：

因本公司從事遠期外匯買賣合約均係為避險性質，其因匯率變動產生之損益大致會與被避險項目之損益相抵銷，故市場價格風險並不重大。

(4)流動性風險、現金流量風險及未來現金需求之金額、期間、不確定性：

本公司購入遠期外匯之履約價格係依當時市場價格訂定之固定成本，其期間長短係配合本公司既有之外幣債權之到期日而決定，因此，於合約到期時，本公司將以到期之外幣債權債務結清，故無籌資風險，且不致有重大之現金流量風險。

(5)持有衍生性金融商品之種類、目的及達成該目的之策略：

本公司之衍生性金融商品均因非交易目的而持有。訂定遠期外匯合約主要係為規避外幣債權、債務及承諾因匯率變動產生之風險。本公司之避險策略係以達成能夠規避大部分市場價格風險為目的。本公司以與被避險項目公平價值變動呈高度負相關之衍生性金融商品作為避險工具，並作定期評估。

(6)衍生性金融商品於財務報表上之表達方法：

本公司因買賣遠期外匯合約所產生之應收及應付款項餘額互為抵減，其差額列為流動負債，民國九十三年及九十二年列於其他應收款及其他流動負債之餘額分別為 2,757 及 470 仟元，其產生之兌換利益(損失)計 859 及(4,537)仟元帳列於損益表之營業外收入(支出)項下。

(三)控制公司與從屬公司間及從屬公司與從屬公司間已消除之重大交易事項(外幣單位：仟元)：

交易事項	交易公司及借(貸)金額						
	合晶	Wafer Works Investment Crop.	Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.	Wafermaster Investment Corp.	上海合晶硅材料有限公司	上海晶技電子材料有限公司	Helitek Company Ltd.
<u>民國九十三年度</u>							
1.沖銷長期投資與股東權益							
A.沖銷本期認列子公司投資收益							
合晶對Silicon	80,206		(80,206)				
合晶對Wafer Works	(20,446)	20,446					

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

Silicon對上海合晶			USD2,247		USD(2,247)		
Silicon對上海晶技			USD310			USD(310)	
Silicon對Helitek			USD(125)				USD125
Wafer Works對Silicon		USD217	USD(217)				
Wafer Works對 Wafermaster		USD(337)		USD337			
Wafermaster對上海晶技				USD230		USD(230)	
Wafermaster對Helitek				USD(568)			USD568
B.沖銷本期認列子公司累 積換算調整數							
合晶對Wafer Works	6,161	(6,161)					
Wafer Works對Silicon			USD25	USD(25)			
Silicon對上海合晶			USD24		USD(24)		
C.沖銷期初累積換算調整 數							
合晶對Silicon	(43,404)		43,404				
D.沖銷子公司期初股東權 益							
合晶對Wafer Works	635,373	(635,373)					
Wafer Works對Silicon			USD17,676	USD(17,676)			
Wafer Works對 Wafermaster			USD9,000		USD(9,000)		
Silicon對上海合晶			USD6,385		USD(6,385)		
Wafermaster對上海晶技				USD1,639		USD(1,639)	
Wafermaster對Helitek				USD4,078			USD(4,078)
2.沖銷相互間債權債務科目							
A.應收款項							
合晶應收上海合晶	(1,970)				1,970		
合晶應收上海晶技	(680)					680	
合晶應收Helitek	(69,473)						69,473
上海合晶應收Helitek					USD(29)		USD29
B.應付款項							
合晶應付上海合晶	25,204				(25,204)		
合晶應付上海晶技	4,839					(4,839)	
合晶應付Helitek	270						(270)
上海晶技應付上海合晶					USD(99)	USD99	
上海合晶應付上海晶技					USD163	USD(163)	
C.其他應收款							
合晶應收上海合晶	(45,297)				45,297		

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

合晶應收上海晶技	(4,535)		4,535	
合晶應收Helitek	(219)			219
D.其他應付款				
合晶應付Helitek	203			(203)
3.沖銷損益科目				
A.進銷貨交易				
合晶銷貨予上海合晶	12,122	(12,122)		
合晶銷貨予上海晶技	2,493		(2,493)	
合晶銷貨予Helitek	429,499			(429,499)
上海合晶銷貨予合晶	(116,006)	116,006		
上海晶技銷貨予合晶	(13,381)		13,381	
Helitek銷貨予合晶	(31,351)			31,351
上海合晶銷貨予上海晶 技		USD215	USD(215)	
上海晶技銷貨予上海晶 技		USD(139)	USD139	
上海晶技銷貨予Helitek			USD 7	USD (7)
上海合晶銷貨予Helitek		USD1,590		USD(1,590)
Helitek銷售予上海合晶		USD(853)		USD853
Helitek銷售設備予合晶	(59,499)			59,499
B.未實現銷貨毛利				
合晶銷售予Helitek	(2,191)			2,191
上海合晶銷售予合晶	16,258	(16,258)		
Helitek銷售予合晶	179			(179)
C.已實現銷貨毛利				
合晶銷售予Helitek	7,100			(7,100)
Helitek銷貨予合晶	(227)			227
D.其他交易				
a.其他收入				
合晶對Silicon	135	(135)		
合晶對上海合晶	13,168	(13,168)		
合晶對上海晶技	641		(641)	
合晶對Helitek	1,126			(1,126)
b.技術作價攤銷				
合晶對上海合晶	5,359	(5,359)		
c.合併借(貸)項攤銷				
Silicon對上海合晶		USD(70)	USD70	

交易公司及借(貸)金額

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

交易事項	合 晶	Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.	Helitek Company Ltd.	上海晶技 電子材料 有限公司	上海合晶 硅材料有 限公司
<u>民國九十二年度(重編後)</u>					
1. 沖銷長期投資與股東權益					
A. 沖銷本期認列子公司投資利益					
合晶對Silicon	13,847	(13,847)			
Silicon對Helitek		USD 441	USD (441)		
Silicon對上海晶技		USD (20)		USD 20	
B. 沖銷本期認列子公司累積換算調整數					
合晶對Silicon	(10,354)	10,354			
C. 沖銷期初累積換算調整數					
合晶對Silicon	53,758	(53,758)			
D. 沖銷子公司期初股東權益					
合晶對Silicon	(404,278)	404,278			
Silicon對Helitek		USD (3,722)	USD 3,722		
Silicon對上海晶技		USD (1,375)		USD 1,375	
Silicon對上海合晶		USD (8,725)			UKSD 8,725
2. 沖銷相互間債權債務科目					
A. 應收款項					
合晶應收Helitek	(96,885)		96,885		
合晶應收Silicon	(593)	593			
Helitek應收上海合晶			(3,062)		3,062
Helitek應收上海晶技			(94)	94	
合晶應收上海合晶	(7,435)				7,435
B. 應付款項					
合晶應付Helitek	7,061		(7,061)		
合晶應付上海晶技	2,113			(2,113)	
合晶應付上海合晶	2,449				(2,449)
Helitek應付上海合晶			28,772		(28,772)
上海合晶應付合晶	(3,804)				3,804
3. 沖銷損益科目					
A. 進銷貨交易					
合晶銷貨予Helitek	336,152		(336,152)		
合晶銷貨予上海合晶	26,281				(26,281)

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

Helitek銷貨予合晶	(130,224)		130,224	
Helitek銷貨予上海合晶			99,853	(99,853)
合晶銷貨予Silicon	13,231	(13,231)		
Silicon銷貨予合晶	(85)	85		
上海晶技銷貨予Silicon		(485)	485	
合晶銷貨予上海晶技	975			(975)
Silicon銷貨予上海晶技		743		(743)
Helitek銷貨予上海晶技			427	(427)
上海晶技銷貨予合晶	(2,562)			2,562
上海合晶銷售予Helitek			(219,684)	219,684
上海合晶銷售予合晶	(14,417)			14,417
D.未實現銷貨毛利				
合晶銷貨予Helitek	(7,100)		7,100	
Helitek銷貨予合晶	287		(287)	
C.已實現銷貨毛利				
合晶銷貨予Helitek	4,500		(4,500)	
Helitek銷貨予合晶	(257)		257	
D.其他交易				
a.其他收入				
合晶對Helitek	3,393		(3,393)	
合晶對Silicon	27	(27)		
合晶對上海晶技	6,564			(6,564)
合晶對上海合晶	640			(640)
b.合併借項攤銷				
Silicon對Helitek		USD (199)	USD199	

十一、附註揭露事項

(一) 重大交易事項相關資訊

1. 對他人資金融通者：無。
2. 為他人背書保證者：參閱附表一。
3. 期末持有有價證券者：參閱附表二。
4. 累積買進、賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：參閱附表三。
5. 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：無。
6. 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：無。

合晶科技股份有限公司及其子公司合併財務報表附註(續)
(金額除另予註明外，均以新台幣仟元為單位)

7. 與關係人進、銷貨交易金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：參閱附表四。
8. 本公司應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：無。
9. 本公司從事衍生性商品交易：請參閱附註十.2。

(二) 轉投資事業相關資訊：

1. 對被投資公司具有重大影響力或控制能力時，應揭露被投資公司之相關資訊：參閱附表五。
2. 對被投資公司具有控制能力時，應揭露被投資公司上述 1~9 項相關資訊：
 - (1)對他人資金融通者：參閱附表六。
 - (2)為他人背書保證者：無。
 - (3)期末持有有價證券者：參閱附表七。
 - (4)累積買進、賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：參閱附表八。
 - (5)取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：無。
 - (6)處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：無。
 - (7)與關係人進、銷貨交易金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：參閱附表九。
 - (8)應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：無。
 - (9)本公司從事衍生性商品交易：無。

(三)大陸投資資訊之揭露

1. 大陸被投資公司名稱、主要營業項目、實收資本額、投資方式、資金匯出入情形、持股比例、投資損益、期末投資帳面價值、已匯回投資損益及赴大陸地區投資限額：

單位：新台幣/仟元

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本期期初自台灣匯出累積投資金額	本期匯出或收回投資金額		本期期末自台灣匯出累積投資金額	本公司直接或間接投資之持股比例	本期認列投資(損)益	期末投資帳面價值	截至本期止已匯回投資收益	本期期末累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准投資金額	依經濟部投審會規定本公司赴大陸地區投資限額
					匯出	收回								
上海合晶硅材料有限公司(原名為晶華電子材料有限公司)	經營晶圓、已滲雜業務	385,181 仟元 (註3)	透過轉投資第三地現有公司再投資大陸公司	\$193,386 (註3)	\$110,981 (註2、3)	\$-	\$304,367 (註3)	75%	\$71,715 (註1、3)	\$359,847 (註3)	\$-	\$326,709 (註3)	\$326,709 (註3)	\$718,711
上海晶技電子材料有限公司	經營晶圓、已滲雜業務	22,342 仟元 (註3)	透過轉投資第三地現有公司再投資大陸公司	\$22,342 (註3)	\$-	\$-	\$22,342 (註3)	100.00%	\$18,078 (註1、3)	\$61,624 (註3)	\$-			

註1：係依經台灣母公司簽證會計師查核簽證之財務報表按權益法認列投資收益。

註2：合晶本期增加Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.之投資款36,429仟元，再以Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.投資上海合晶硅材料有限公司30,674仟元，另技術作價投資上海合晶硅材料有限公司80,307仟元。

註3：外幣金額已依年底匯率換算為新台幣。

註4：上述有關上海合晶硅材料有限公司及上海晶技電子材料有限公司於編製合併財務報表時業已沖銷，請參閱十.(三)。

2. 進貨金額及百分比與相關應付款項之期末餘額及百分比：

	進貨		應付款項	
	金額	佔本公司進貨 淨額百分比	金額	佔該科目餘 額百分比
合晶對上海晶技	\$13,381	2.04%	\$4,839	3.37%
合晶對上海合晶	116,006	7.56	25,204	17.56
Helitek 對上海合晶	53,140	7.58	926	1.05
上海晶技對上海合晶	7,192	5.40	3,160	20.31
合 計	<u>\$189,719</u>		<u>\$34,129</u>	

3. 銷貨金額及百分比與相關應收款項之期末餘額及百分比：

	銷貨		應收款項	
	金額	佔本公司銷貨 淨額百分比	金額	佔該科目餘 額百分比
合晶對上海晶技	\$2,493	0.16%	\$680	0.23%
合晶對上海合晶	12,122	0.80	1,970	0.66
Helitek 對上海晶技	245	0.03	-	-
Helitek 對上海合晶	28,522	4.07	-	-
上海晶技對上海合晶	4,661	2.35	5,202	16.21
合 計	<u>\$48,043</u>		<u>\$7,852</u>	

4. 財產交易金額及其所產生損益數額：

資產種類	關係人名稱	帳面價值	售價	處份利益	價格決定之 參考依據
機器設備	上海合晶硅材料有限公司	<u>\$3,656</u>	<u>\$3889</u>	<u>\$233</u>	議價

5. 票據背書及保證或提供擔保品之期末餘額及其目的：

本公司民國九十三年度為上海合晶硅材料有限公司背書保證 46,789 仟元，以作為該公司向銀行借款之擔保。

6. 資金融通之最高餘額、期末餘額、利率區間及當期利息總額：

民國九十三年度本公司百分之百持股之轉投資公司 Helitek Company Ltd.與上海晶技電子材料有限公司資金融通情形如下：

交易對象	最高餘額	期末餘額	利率區間	利息收入
上海晶技電子材料有限公司	\$6,796	\$6,796	9.75%	\$625

7. 其他對當期損益或財務狀況有重大影響之交易事項，如勞務之提供或收受等：

本公司民國九十三年度為上海晶技電子材料有限公司及上海合晶硅材料有限公司代購原料收取之其他收入為 641 仟元及 13,168 仟元；截至民國九十三年十二月三十一日止，本公司為上海晶技電子材料有限公司及上海合晶硅材料有限公司代採購原物料之代墊款項分別為 4,535 仟元及 45,297 仟元，本公司帳列其他應收款項下。

8. 上述有關本公司、Helitek、上海晶技及上海合晶間交易於編製合併財務報表時業已沖銷，請參閱附註十.(三)。

十二、部門別財務資訊

1. 產業別財務資訊：本公司係製造矽晶圓材料為主要產品，製造過程一貫作業，並無其他主要產品，故無揭露其產業別資訊之適用。

2. 地區別財務資訊：本公司民國九十三年及九十二年有關地區別財務資訊列示如下：

	美洲及 其他地區	台灣	調整及沖銷	合併
<u>九十三年度</u>				
來自企業以外客戶之收入	\$1,076,640	\$1,091,349	\$-	\$2,167,989
來自企業內之收入	313,997	444,114	(758,111)	-
收入合計	<u>\$1,390,637</u>	<u>\$1,535,463</u>	<u>\$(758,111)</u>	<u>\$2,167,989</u>
部門利益	<u>\$258,471</u>	<u>\$368,927</u>	<u>\$10,970</u>	<u>\$638,368</u>
投資收益淨額				3,857
公司一般費用				(321,714)
利息費用				(26,051)
繼續營業部門之稅前利益				<u>\$294,460</u>
可辨認資產	<u>\$1,447,085</u>	<u>\$2,426,290</u>	<u>\$(190,752)</u>	<u>\$3,682,623</u>
長期股權投資				9,627
資產合計				<u>\$3,692,250</u>
折舊	<u>\$45,800</u>	<u>\$203,738</u>	<u>\$-</u>	<u>\$249,538</u>
資本支出	<u>\$55,897</u>	<u>\$292,631</u>	<u>\$(28,296)</u>	<u>\$320,232</u>
<u>九十二年度(重編後)</u>				
來自企業以外客戶之收入	\$736,740	\$947,089	\$-	\$1,683,829
來自企業內之收入	414,586	376,639	(791,225)	-
收入合計	<u>1,151,326</u>	<u>\$1,323,728</u>	<u>\$(791,225)</u>	<u>\$1,683,829</u>
部門利益	<u>\$104,503</u>	<u>\$292,595</u>	<u>\$48,406</u>	<u>\$445,504</u>

投資損失淨額				(31)
公司一般費用				(240,021)
利息費用				(37,097)
繼續營業部門之稅前利益				<u>\$168,355</u>
可辨認資產	<u>\$956,027</u>	<u>\$2,159,492</u>	<u>\$(93,369)</u>	<u>\$3,022,150</u>
長期股權投資				<u>5,170</u>
資產合計				<u>\$3,027,320</u>
折舊	<u>\$54,637</u>	<u>\$182,999</u>	<u>\$-</u>	<u>\$237,636</u>
資本支出	<u>\$94,086</u>	<u>\$159,792</u>	<u>\$-</u>	<u>\$253,878</u>

3. 外銷銷貨資訊：

	九十三年度	九十二年度 (重編後)
美洲	<u>\$1,121,918</u>	<u>\$472,216</u>
歐洲	<u>175,475</u>	<u>46,980</u>
亞洲	<u>884,560</u>	<u>1,131,615</u>
合計	<u>\$2,181,953</u>	<u>\$1,650,811</u>

4. 重要客戶資訊：本公司對單一客戶之銷貨收入占本公司營業收入淨額 10% 以上者如下：

客戶名稱	九十三年度	九十二年度 (重編後)
A 客戶	<u>\$429,452</u>	<u>\$336,152</u>

合晶科技股份有限公司

附表一

為他人背書保證：

單位：新台幣仟元

編號 (註1)	背書保證者 公司名稱	被背書保證對象		對單一企業背 書保證限額	本期最高背 書保證餘額	期末背書保證 餘額	以財產擔 保之背書 保證金額	累計背書保證金 額佔最近期財務 報表淨值之比率	背書保證最高 限額(註3)
		公司名稱	關係(註2)						
1	合晶科技股 份有限公司	上海合晶硅材料有 限公司	本公司之曾孫公 司	\$309,000	\$46,789	\$46,789	\$-	2.60%	\$309,000

註1：編號欄之填寫方法如下：

- 1.發行人填0
- 2.被投資公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註2：背書保證者與被書保證對象之關係有下列六種，標示種類即：

- 1.有業務關係之公司。
- 2.直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司。
- 3.母公司與子公司持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司。
- 4.對公司直接或經由子公司間接持有普通股股權超過百分之五十之母公司。
- 5.基於承攬工程需要之同業依合約規定互保之公司。
- 6.因共同投資關係由各出資股東依其持股比率對其背書保證之公司。

註3：依本公司「背書保證作業程序」規定，本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之二十。對單一企業背書保證額度以不超過以本公司實收資本額百分之十為限，惟對子公司則以本公司實收資本額百分之二十為限。

合晶科技股份有限公司

附表一

為他人背書保證：

單位：新台幣仟元

編號 (註1)	背書保證者 公司名稱	被背書保證對象		對單一企業背 書保證限額	本期最高背 書保證餘額	期末背書保證 餘額	以財產擔 保之背書 保證金額	累計背書保證金 額佔最近期財務 報表淨值之比率	背書保證最高 限額(註3)
		公司名稱	關係(註2)						
1	合晶科技股 份有限公司	上海合晶硅材料有 限公司	本公司之曾孫公 司	\$309,000	\$46,789	\$46,789	\$-	2.60%	\$309,000

註1：編號欄之填寫方法如下：

- 1.發行人填0
- 2.被投資公司按公司別由阿拉伯數字1開始依序編號。

註2：背書保證者與被書保證對象之關係有下列六種，標示種類即：

- 1.有業務關係之公司。
- 2.直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司。
- 3.母公司與子公司持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司。
- 4.對公司直接或經由子公司間接持有普通股股權超過百分之五十之母公司。
- 5.基於承攬工程需要之同業依合約規定互保之公司。
- 6.因共同投資關係由各出資股東依其持股比率對其背書保證之公司。

註3：依本公司「背書保證作業程序」規定，本公司對外背書保證之總額不得超過當期淨值百分之二十。對單一企業背書保證額度以不超過以本公司實收資本額百分之十為限，惟對子公司則以本公司實收資本額百分之二十為限。

合晶科技股份有限公司

附表二

期末持有有價證券：

單位：新台幣仟元

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券 發行人之關係	帳 列 科 目	期 末				備註
				股 數	帳面金額	持股比率	市價(註1)	
合晶科技股份 有限公司	股票 Wafer Works Investment Corp.	子公司	長期股權投資	1,976,960	\$621,088	100.00%	\$637,525	註3
合 計	晶材科技股份有限 公司	子公司	長期股權投資	499,994	9,627 (註2)	99.99%	9,627 (註2)	
	合晶科技股份有限 公司	本公司	庫藏股票	5,000,000	\$67,220	3.24%	\$64,000	
					<u>\$630,715</u>		<u>\$647,152</u>	

註1：無公開市價者，依股權淨值填寫。

註2：截至民國九十三年十二月三十一日止，晶材科技股份有限公司持有本公司股票計183,500股，帳面價值1,847仟元，依財務會計準則第三十號公報「庫藏股票會計處理準則」規定視同庫藏股票處理。

註3：於編製合併財務報表業已沖銷，請參閱附註十.(三)。

合晶科技股份有限公司

附表三

累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

單位：新台幣仟元

買、賣 之公司	有價證券 種類及名稱	帳列 科目	交易 對象	關係人	期 初		買 入		賣 出				期 末	
					股數	金額	股數	金額	股數	售價	帳面成本	處分損益	股 數	金 額
-	股票： Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.	長期股 權投資	-	-	16,280,000	\$481,835	3,489,600 (註1)	\$196,942 (註2)	19,769,600	-	\$678,777 (註3)	\$-	-	\$-
	Wafer Works Investment Corp.	長期股 權投資	-	-	-	-	19,769,600	641,534 (註4)	-	-	20,446 (註5)	-	19,769,600	621,088
	合 計					<u>\$481,835</u>		<u>\$838,476</u>			<u>\$699,223</u>	<u>\$-</u>		<u>\$621,088</u>

註1：係現金增資1,080,000元及技術作價投資2,409,600元。

註2：係包括本期增加Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.之投資款36,429仟元、技術作價投資80,307仟元及按權益法認列之投資收益80,206仟元。

註3：係將Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.作價635,373仟元投資Wafer Works Investment Corp.及外幣報表換算調整數減列43,404仟元。

註4：係以Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.作價投資635,373仟元及按外幣報表換算調整數增列6,161仟元。

註5：係本期採權益法認列投資損失20,446仟元。

註6：於編製合併財務報表業已沖銷，請參閱附註十.(三)。

合晶科技股份有限公司

附表四

與關係人進、銷貨交易金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

單位：新台幣仟元

進(銷)貨 之公司	交易 對象	關係	交易情形				交易條件與一般交易 不同之情形		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金額	佔總進(銷) 貨之比率	授信期間	單價	授信期間	餘額	佔總應收(付)票 據、帳款之比率	
合晶科技 股份有 限公司	Helitek Company Ltd.	本公司之曾孫公司	銷貨	\$429,499	27.97%	交貨後60天 以電匯方式 收款	與一般廠商 相當	與一般廠 商相當	\$69,473	23.18%	
合晶科技 股份有 限公司	上海合晶硅材料 有限公司	本公司之曾孫公司	進貨	116,006	13.33%	交貨後60天 以電匯方式 付款	與一般廠商 相當	與一般廠 商相當	25,204	17.56%	

註：於編製合併財務報表業已沖銷，請參閱附註十.(三)。

附表五

對被投資公司具重大影響力或控制能力時，應揭露之被投資公司相關資訊：

單位：新台幣仟元/美金仟元

投資公司 名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		期末持有			被投資公司 本期損益	本期認列之 投資(損)益	備註
				上期	本期	股數	比率%	帳面金額			
合晶科技股份有限 公司	Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.	P.O. Box 258 First Home Tower British American Centre George town Grand Cayman, Cayman Island	對科技事業之投資 及半導體矽晶圓 材料銷售投資控 股	USD 16,280	- (註8)	-	-%	\$-	\$79,979	\$80,206 (註1)	(註10)
"	Wafer Works Investment Corp.	P.O. Box 217 Apia, Samoa		-	USD 19,770 (註8)	19,769,600	100.00%	621,088	(4,009)	(20,446) (註2)	(註10)
"	晶材科技股份有限 公司	台北市忠孝東路4段212 號9樓	電子材料零售貿易 、設計等經營晶 圓製造	\$5,000	\$5,000	499,994	99.99%	9,627	3,957	3,857 (註3)	(註10)
Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.	上海合晶硅材料 有限公司	上海市松江區貴南路		USD 5,691	USD 8,952	-	75.00%	USD 11,274	USD 2,903	USD 2,247 (註4)	(註10)
"	上海晶技電子材料有限 公司	上海市松江區洞涇鎮張涇 路1號	經營晶圓、已滲雜 業務	USD 700	- (註9)	-	-	-	USD 310	USD 310	(註10)
"	Helitek Company Ltd.	31088 San Clemente Street Hayward, CA 94544	半導體矽晶圓材料 之製造及銷售	USD 9,127	- (註9)	-	-	-	USD 73	USD (125) (註5)	(註10)
Wafer Works Investment Corp.	Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.	P.O. Box 258 First Home Tower British American Centre George town Grand Cayman, Cayman Island	對科技事業之投資 及半導體矽晶圓 材料銷售投資控 股	-	USD 19,770	19,769,600	100.00%	USD 20,311	USD 217	USD 217	(註10)
"	Wafermaster Investment Corp.	P.O. Box 217 Apia, Samoa		-	USD 9,000	9,000,000	100.00%	USD 8,663	USD (337)	USD (337)	(註10)
Wafermaster Investment Corp.	上海晶技電子材料有限 公司	上海市松江區洞涇鎮張涇 路1號	經營晶圓、已滲雜 業務	-	USD 1,700 (註9)	-	100.00%	USD 1,931	USD 5	USD 230 (註6)	(註10)
"	Helitek Company Ltd.	31088 San Clemente Street Hayward, CA 94544	半導體矽晶圓材料 之製造及銷售	-	USD 7,300 (註9)	5,400,000 (其中4,000,000 係特別股)	100.00%	USD 6,732	USD 1	USD (568) (註7)	(註10)

註1：係包括本期按權益法認列之投資收益79,979仟元及逆流交易之已實現銷貨毛利227仟元。

註2：係包括本期按權益法認列之投資損失4,009仟元及逆流交易之未實現銷貨毛利16,437仟元。

註3：係包括本期按權益法認列之投資收益3,957仟元及子公司出售母公司股票利益轉列資本公積100仟元。

註4：係包括本期按權益法認列之投資收益USD 2,177仟元及股權淨值攤銷數70仟元。

註5：係包括本期按權益法認列之投資收益USD 73仟元及股權淨值攤銷數USD (198)仟元。

註6：係包括本期按權益法認列之投資收益USD 5仟元及取得股權淨值差異USD 225仟元。

註7：係包括本期按權益法認列之投資收益USD 1仟元及取得股權淨值差異USD (569)仟元。

註8：本公司於九十三年十二月將原直接投資Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.變更為本公司透過投資設立Wafer Works Investment Corp.間接轉投資Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.。

註9：Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.於九十三年十二月將上海晶技電子材料有限公司及Helitek Company Ltd.分別以USD 1,700仟元及7,300仟元售予Wafermaster Investment Corp.。

註10：於編製合併財務報表業已沖銷，請參閱附註十.(三)。

Helitek Company Ltd.

附表六

對他人資金融通者：

單位：新台幣仟元

編號	貸出資金之公司	貸與對象	往來科目	本期最高餘額	期末餘額	利率區間	資金貸與性質	業務往來金額	有短期融通資金必要之原因	提列備抵呆帳金額	擔保品		對個別對象資金貸與限額	資金貸與總限額
											名稱	價值		
1	Helitek Company Ltd.	上海晶技電子材料有限公司	應收關係人款	USD 200 仟元	USD 200 仟元	9.75%	與其有業務往來	銷貨USD 103 仟元	短期營運資金需求	\$-	-	\$-	USD 11,141 仟元	\$309,000

註：於編製合併財務報表業已沖銷，請參閱附註十.(三)。

合晶科技股份有限公司

附表七

期末持有有價證券：

單位：新台幣仟元/美金仟元

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券 發行人之關係	帳 列 科 目	期 末				備註
				股 數	帳面金額	持股比率	市價(註1)	
Wafer Works Investment Corp.	Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.	孫公司	長期股權投資	19,769,600	USD 20,311	100.00%	USD20,311	註2
"	Wafermaster Investment Corp.	孫公司	長期股權投資	9,000,000	USD 8,663	100.00%	USD 8,663	註2
Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.	上海合晶硅材料 有限公司	曾孫公司	長期股權投資	-	USD 11,274	75.00%	USD 11,899	註2
Wafermaster Investment Corp.	上海晶技電子材料有限 公司	曾孫公司	長期股權投資	-	USD 1,931	100.00%	USD 1,931	註2
Wafermaster Investment Corp.	Helitek Company Ltd.	曾孫公司	長期股權投資	5,400,000 (其中4,000,000 係特別股)	USD 6,732	100.00%	USD 4,152	註2
晶材科技股份有限公司	合晶科技股份有限公司	本公司	長期股權投資	183,500	1,847	0.12%	2,349	

註1：無公開市價者，依股權淨值填寫。

註2：於編製合併財務報表業已沖銷，請參閱附註十.(三)。

附表八

累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

單位：美金仟元

買、賣 之公司	有價證券 種類及名稱	帳列 科目	交易 對象	關係人	期 初		買 入		賣 出				期 末	
					股數	金額	股數	金額	股數	售價	帳面成本	處分損益	股 數	金 額
Wafer Works Investment Corp.	Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.	長期股 權投資	合晶科技 股份有限 公司	是	-	\$-	19,769,600	\$20,311 (註1)	-	\$-	\$-	\$-	19,769,600	\$20,311 (註6)
Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.	上海合晶硅材料 有限公司	長期股 權投資	-	-	-	5,691	-	5,583 (註2)	-	-	-	-	-	11,274 (註6)
Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.	Helitek Company Ltd.	長期股 權投資	Wafermaster Investment Corp.	是	5,400,000 (其中4,000,000 係特別股)	7,140	-	73 (註3)	5,400,000 (其中4,000,000 係特別股)	7,300	7,213	87	-	-
Wafer Works Investment Corp.	Wafermaster Investment Corp.	長期股 權投資	-	-	-	-	9,000,000	8,663 (註4)	-	-	-	-	9,000,000	8,663 (註6)
Wafermaster Investment Corp.	Helitek Company Ltd.	長期股 權投資	Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.	是	-	-	5,400,000 (其中4,000,000 係特別股)	6,732 (註5)	-	-	-	-	5,400,000 (其中4,000,000 係特別股)	6,732 (註6)

註1：係以Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.作價投資20,069仟元、本期按權益法認列投資收益217仟元及外幣報表換算調整數增列25仟元。

註2：係包括本期現金增資902仟元、技術作價投資2,410仟元、本期按權益法認列投資收益2,177仟元、股權淨值攤銷數70仟元及外幣報表換算調整數增列24仟元。

註3：係本期按權益法認列之投資收益。

註4：係本期現金9,000仟元購入投資及本期按權益法認列投資損失337仟元。

註5：係本期現金7,300仟元購入投資及本期按權益法認列投資損失568仟元。

註6：於編製合併財務報表業已沖銷，請參閱附註十.(三)。

附表九

與關係人進、銷貨交易金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上者：

單位：美金仟元

進(銷)貨 之公司	交易 對象	關係	交易情形				交易條件與一般交易不 同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金額	佔總進(銷) 貨之比率	授信期間	單價	授信期間	餘額	佔總應收(付)票 據、帳款之比率	
Helitek Company Ltd.	合晶科技 股份有限 公司	本公司之曾孫 公司	進貨	USD 13,424	69.10%	交貨後60天 以電匯方式 付款	與一般廠 商相當	與一般廠商 相當	USD 2,191	79.42%	註
上海合晶 硅材料有 限公司	合晶科技 股份有限 公司	本公司之曾孫 公司	銷貨	USD 3,582	24.49%	交貨後60天 以電匯方式 付款	與一般廠 商相當	與一般廠商 相當	USD 948	15.06%	註

註：於編製合併財務報表業已沖銷，請參閱附註十.(三)。

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對本公司財務狀況之影響：無。

陸、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理

一、財務狀況

財務狀況比較分析表

單位：新台幣仟元

項目	年度	93 年度	92 年度	差 異		說明
				金額	%	
流動資產		\$927,427	\$757,627	\$169,800	22.41	註 1
固定資產		1,401,886	1,340,607	61,279	4.57	
其他資產		107,944	85,083	22,861	26.87	註 2
資產總額		3,067,972	2,670,322	397,650	14.89	
流動負債		524,174	671,902	(147,728)	(21.99)	註 3
長期負債		664,020	332,872	331,148	99.48	註 3
負債總額		1,271,194	1,015,860	255,334	25.13	
股本		1,545,000	1,500,000	45,000	3.00	
資本公積		68,505	231,215	(162,710)	(70.37)	註 4
保留盈餘		246,179	(117,810)	363,989	308.96	註 4
股東權益總額		1,796,778	1,654,462	142,316	8.60	

註 1：係因銷貨收入大幅增加，致應收帳款及存貨相對增加。
 註 2：係因營運狀況良好，迴轉備抵遞延所得稅評價所致。
 註 3：係因本期發行公司債償還短期借款所致。
 註 4：係因本期資本公積彌補虧損所致。

二、經營結果

經營結果比較分析

單位：新台幣仟元

項 目	九十三年度	九十二年度	增(減)金額	變動增(減)比例%	備註
營業收入總額	\$1,543,468	\$1,341,747	\$201,721	15.03	
減：銷貨退回及折讓	(8,006)	(18,019)	(10,013)	(55.57)	註 1
營業收入淨額	1,535,462	1,323,728	211,734	16.00	
已(未)實現銷貨毛利	4,909	(2,600)	7,509	288.81	註 2
營業成本	(1,171,444)	(1,028,533)	142,911	13.89	
營業毛利	368,927	292,595	76,332	26.09	
營業費用	(180,414)	(143,177)	37,237	26.01	註 3
營業淨利	188,513	149,418	39,095	26.16	
營業外收入及利益	91,347	40,133	51,214	127.61	註 4
營業外費用及損失	(23,681)	(33,924)	(243)	(0.72)	
本期稅前淨利	246,179	155,627	90,552	58.19	
所得稅利益	-	75,000	(75,000)	100.00	註 5
本期淨利	\$246,179	\$230,627	\$15,552	6.74	

增減比例變動分析說明：

註 1：因本期良率提升，致使銷貨退回及折讓大幅減少。

註 2：本期因順流交易所產生已實現銷貨毛利較上期增加所致。

註 3：因本期半導體產業景氣復甦，銷售量大幅上升，致使營業費用增加。

註 4：因按權益法認列投資收益大幅提升所致。

註 5：因上期營運狀況轉佳，故迴轉備抵遞延所得稅資產評價所致。

營業毛利變動分析

單位：新台幣仟元

主要產品別	營業毛利 前後期增 (減)變動數	差異原因			
		銷售價格 差異	成本價格 差異	組合差異	數量差異
4"Wafer	\$(13,664)	\$(25,219)	\$9,667	\$(25,570)	\$27,458
5"Wafer	4,908	(39,956)	41,216	(10,247)	13,895
6"Wafer	42,143	(29,224)	45,954	13,403	12,010
小計	33,387	\$(94,399)	\$96,837	\$(22,414)	\$53,363
其他	35,436	不利	有利	不利	有利
聯屬公司間已 實現毛利	7,509				
合計	<u>\$76,332</u>				

原因說明：

4"Wafer

茲因本期半導體產業景氣復甦，銷售量大幅上升，致產生有利數量差異 27,458 仟元，惟本期同業削價競爭及匯率波動影響，致產生不利價格差異 25,219 仟元；受 6"Wafer 訂單量大幅成長至產生不利組合差異 25,570 仟元，另產量上升，單位成本因而下降致產生有利成本價差 9,667 仟元。

5"Wafer

係本公司為拓展市場而提供客戶較優惠價格，致產生有利數量差異 13,895 仟元及不利銷售價格差異 39,956 仟元；因產量提升，致產生有利成本價格差異 41,216 仟元。受 6"Wafer 訂單量成長影響，致產生不利組合差異 10,247 仟元。

6"Wafer

係本公司為拓展市場而提供客戶較優惠價格，致產生有利數量差異 12,010 仟元及不利銷售價格差異 29,224 仟元；另因產量提升，單位成本因而下降，致產生有利成本價差 45,954 仟元。

三、現金流量

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額①	預計全年來自 營業活動淨現 金流量②	預計全年現 金流出量③	預計現金剩 餘(不足)數 額①+②-③	預計現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
\$42,696	\$316,592	\$245,536	\$113,752	\$-	
1.本年度現金流量變動情形分析： (1) 營業活動：主係營收擴大淨利增加所致。 (2) 投資活動：無。 (3) 融資活動：無。 2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無。					

四、最近年度重大資本支出對財務業務影響：無

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃：
本公司最近年度轉投資公司經營尚屬良好。

六、最近年度及截至年報刊印日止風險管理事項評估

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1.最近年度利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

由於央行持續調降利率，故本公司借款利率持續下降，未來公司將視市場資金變化情形，與各銀行磋商持續調降利率。

2.匯率變動對公司營收獲利之影響

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	91 年度	92 年度	93 年度
兌換利益(損失)	(8,355)	263	(8,831)
營業收入	1,045,981	1,323,728	1,535,462
佔營業收入比例(%)	(0.80)	0.02	(0.57)
營業利益(損失)	(12,551)	149,418	188,513
佔營業利益比例(%)	66.57	0.18	4.68

本公司外銷貨交易約佔營業收入 6 成，其主要係以美金計價，且進口原物料亦多以外幣計價，本公司外幣淨部位多為美金資產，故本公司自 91 年度開始以承作遠期外匯預售美元，以規避匯率變動風險。由上表之數據得知最近三年度匯率變動對本公司營收獲利之比例不超過 3%，影響尚稱不大。

3.本公司因應匯率變動之具體措施如下：

本公司匯率變動風險直接由財會處控管。財會處除每日記錄匯率資料外，並向各銀行及各投資機構蒐集各種金融財經資訊，即時掌握匯率動態，作避險之判斷。

外匯管理係採穩健保守之方式，以避險為主要目的。相關匯率決策係由財務人員提出建議，再由財會處長審核，經總經理核准後執行。因應匯率變動之具體措施主要如下：

- (1)進銷貨直接以外幣報價，直接降低匯率變動風險。
- (2)開立外幣存款帳戶，視實際資金需求及匯率走勢，靈活調節所有持有之外幣部位。
- (3)視實際資金需求及判斷匯率走勢，採用預購遠期外匯(Forward)之方式操作，以鎖定進貨匯率成本為目的，以期達到降低匯率之波動對公司造成之影響及其他國際貨幣間之匯率，以提供本公司進行外匯避險作業之判斷，以減少外匯劇烈變動造成之匯兌損失影響正常營運，及時計劃因應措施。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性金額商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

- 1.高風險投資：本公司並無進行高風險投資。
- 2.高槓桿投資：本公司並無進行高槓桿投資。
- 3.資金貸與他人

本公司從事資金貸與他人之事項皆依本公司「資金貸與他人作業程序」處理，93年度並無資金貸與他人之情形。

4.背書保證

本公司從事背書保證之事項皆依本公司「背書保證作業程序」處理，93年度背書保證之情形請詳第79頁。

5.衍生性商品交易

本公司從事衍生性商品交易皆依「取得或處分資產處理程序」之第十條取得或處分衍生性商品處理程序之規定處理。本公司從事衍生性商品交易以避險為目的，交易商品選擇使用規避公司業務經營所產生之風險為主。

(三)未來研發計劃及預計投入之研發經費：詳第20頁。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司最近年度並未受國內外重要政策及法律變動而有影響財務業務之情事。

(五)科技改變公司財務業務之影響及因應措施：無

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司企業形象良好，最近年度並無重大改變造成企業危機管理之情事。

(七)進行併購之預期效益及可能風險：不適用。

- (八)擴充廠房之預期效益及可能風險：第參閱上列第四點。
- (九)進貨或銷貨集中所面臨之可能風險：無。
- (十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響及風險：無。
- (十一)經營權之改變對公司之影響及風險：不適用。
- (十二)本公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者，其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。
- (十三)其他重要風險：無。

七、其他重要事項：無。

柒、公司治理運作情形

公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

項目	運作情形	與上市上櫃公司 治理實務守則差異情形及原因
<p>一、公司股權結構及股東權益</p> <p>(一)公司處理股東建議或糾紛等問題之方式</p> <p>(二)公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形</p> <p>(三)公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式</p>	<p>由本公司發言人及股務單位處理。</p> <p>本公司每月均會確認董、監事等主要股東持股異動情形，以掌握其持股狀況。</p> <p>本公司除以財務與業務獨立之原則，作為業務往來之基礎外，另訂定「關係企業營運管理規範」做為管控依據。</p>	並無差異。
<p>二、董事會之組成及職責</p> <p>(一)公司設置獨立董事之情形</p> <p>(二)定期評估簽證會計師獨立性之情形</p>	<p>本公司尚未設有獨立董事。</p> <p>定期評估會計師之獨立性。</p>	尚在評估合適人選；惟本公司之董事成員皆具有公司治理之經驗，已能獨立行使董事之職權。
<p>三、監察人之組成及職責</p> <p>(一)公司設置獨立監察人之情形</p> <p>(二)監察人與公司之員工及股東溝通之情形</p>	<p>本公司尚未設有獨立監察人。</p> <p>以電話、e-mail、傳真或親自前來公司與負責相關業務員工溝通並列席董事會及股東會。</p>	尚在評估合適人選；惟本公司之監察人皆具有公司治理之經驗，已能獨立行使監察人之職權。
<p>四、建立與利害關係人溝通管道之情形</p>	以電話、e-mail、傳真或親自前來公司方式。	並無差異。
<p>五、資訊公開</p> <p>(一)公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形</p> <p>(二)公司採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）</p>	<p>本公司網址為： http://www.waferworks.com，惟未揭露公司財務、業務及公司治理等相關資訊</p> <p>本公司財務業務資訊已充份揭露於主管機關指定網站。</p>	<p>並無差異。</p> <p>本公司財務業務資訊已充份揭露於主管機關指定網站；另公司治理資訊揭於本公司網站，尚在評估中。</p>
<p>六、公司設置審計委員會等功能委員會之運作情形</p>	目前評估其設置之必要性	評估中

七、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：

本公司目前尚未訂定公司治理實務守則，惟本公司之公司治理精神及目前所依循之各項制度，已涵蓋主要治理原則

八、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如董事及監察人進修之情形、董事出席及監察人列席董事會狀況、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、保護消費者或客戶政策之執行情形、董事對利害關係議案迴避之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形及社會責任等）：

(一)本公司為加強公司治理之推行，隨時告知董事、監察人有關公司治理相關法令及其更新。

(二)本公司董事出席董事會會議均按本公司訂定之「董事會議事規則」辦理及執行，監察人亦會列席並參與意見討論。

(三)關於風險管理政策及風險衡量標準之執行，本公司經營階層除依相關法令規定定期揭露及呈報相關資訊外，並經股東會同意提供董事、監察人及公司重要職員之責任險(USD5百萬)，以確保股東權益；財務面方面，對於匯率及相關衍生性金融商品則均採避險措施，以降低風險，並隨時審視財務結構，避免財務風險過高；在內部控制方面，設置稽核人員，定期及不定期針對公司內控制度進行查核，並提出報告。

(四)保護客戶政策方面，本公司對往來客戶均提供其相關服務與保證。

註一：董事及監察人進修之情形，參考臺灣證券交易所股份有限公司所發布之「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」之規定。

註二：如為證券商、證券投資信託事業、證券投資顧問事業及期貨商者，應敘明風險管理政策、風險衡量標準及保護消費者或客戶政策之執行情形。

(二)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：無。

(三)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊揭露：無。

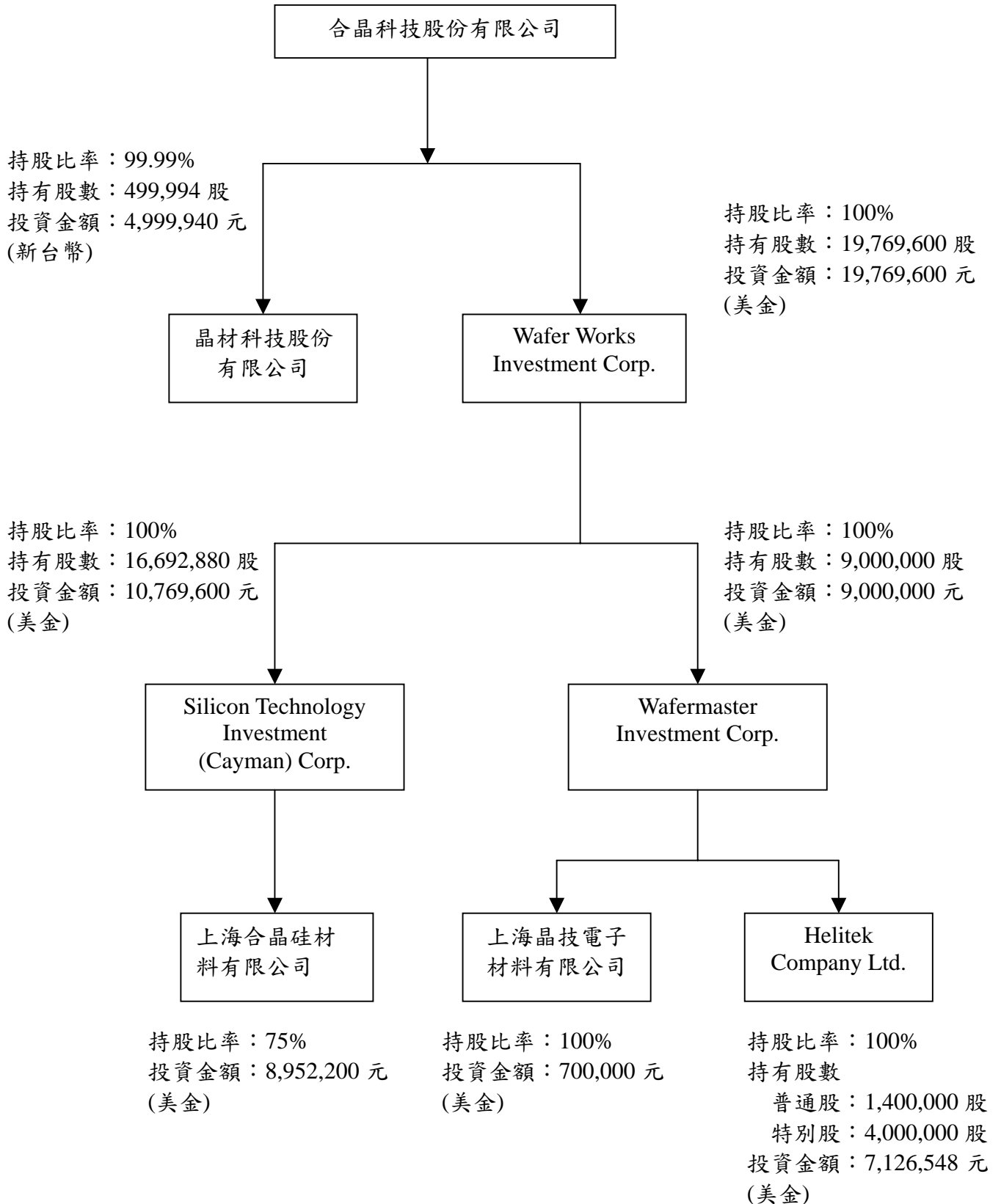
捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一)關係企業合併報告書

1.關係企業組織圖

日期 94 年 4 月 30 日



2.各關係企業基本資料

企業名稱	設立日期	地 址	實 收 資本額	主要營業或生產項目
晶材科技股份有限公司	1998.9	桃園縣楊梅鎮梅獅路二段 445 巷 1 號	新台幣仟元 5,000	電子材料零售業
Wafer Works Investment Corp.	2004.12	P.O. Box 217 Apia, Samoa	美金仟元 19,770	投資控股公司
Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.	1997.9	P.O Box 258 First Home Tower, British American Centre, George Town, Grand Cayman Island	美金仟元 10,770	投資控股公司
Wafermaster Investment Corp.	2004.12	P.O. Box 217 Apia, Samoa	美金仟元 9,000	投資控股公司
上海合晶硅材料有限公司	1994	上海市松江區貴南路 500 號	人民幣仟元 100,000	晶圓材料之製造及銷售
Helitek Company Ltd.	1994.2	31088 San Clemente Street Hayward, CA 94544	美金仟元 4,200	晶圓材料之銷售
上海晶技電子材料有限公司	1998	上海市松江區洞涇鎮張涇路 1 號	人民幣仟元 5,796	晶圓材料之製造及銷售

3.依公司法第三百六十九條之三推定為有控制與從屬關係者：無。

4.各關係企業經營業務所涵蓋之行業：各關係企業所經營業務均為矽晶圓材料之製造及銷售。

5.各關係企業董事、監察人及總經理資料

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	持有股份	
			股 數	持股比率
晶材科技股份有限公司	董事長	焦平海(註一)	499,994	99.99%
Wafer Works Investment Corp.	Director	Ping Hai Chiao(註一)	19,769,600	100.00%
Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.	Director	Ping Hai Chiao(註二)	16,692,880	100.00%
	Director	Yow-Iuan Hsu(註二)	16,692,880	100.00%
Wafermaster Investment Corp.	Director	Ping Hai Chiao(註二)	9,000,000	100.00%
上海合晶硅材料有限公司	董事長	焦平海(註三)	-	75.00%
Helitek Company Ltd.	President	焦平海(註四)	4,200,000	100.00%
上海晶技電子材料有限公司	董事長	焦平海(註四)	-	100.00%
	總經理	莊仁文	-	-

註一：合晶科技股份有限公司代表。

註二：Wafer Works Investment Corp.代表。

註三：Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.代表。

註四：Wafermaster Investment Corp.代表。

6.各關係企業營運概況

單位：新台幣仟元/美金仟元/人民幣仟元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期損益 (稅後)	每股稅後 盈餘(元)
晶材科技股份有限公司	5,000	12,572	1,098	11,474	14,973	4,755	3,956	7.91
Wafer Works Investment Corp.	20,069	28,974	9,000	19,974	-	-	-	-
Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.	19,770	20,433	122	20,311	-	(142)	2,610	1.03
Wafermaster Investment Corp.	9,000	8,663	-	8,663	-	-	337	-
上海合晶硅材料有 限公司	99,990	191,058	59,745	131,313	121,428	28,185	24,030	-
Helitek Company Ltd.	4,200	8,989	4,837	4,152	20,984	672	74	0.014
上海晶技電子材料 有限公司	5,796	33,993	18,013	15,980	49,191	3,853	2,607	-

註：(1)晶材科技股份有限公司係以新台幣仟元為單位。

(2)上海合晶硅材料有限公司及上海晶技電子材料有限公司係以人民幣仟元為單位。

(3)其餘各公司係以美金仟元為單位。

(二) 關係企業合併財務報表

聲 明 書

本公司九十三年度(自九十三年一月一日至十二月三十一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

特此聲明

公司名稱：合晶科技股份有限公司

負 責 人：焦 平 海

中華民國九十四年二月二十五日

(三) 關係報告書：無。

二、內部控制制度執行狀況

(一)內部控制制度聲明書

合晶科技股份有限公司 內部控制聲明書

日期：九十四年三月三十日

本公司就民國九十三年一月一日至九十三年十二月三十一日之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率（含獲利、績效及保障資產安全等）、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。
該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境、2.風險評估、3.控制作業、4.資訊及溝通、及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司上開期間的內部控制制度(含對子公司之監理)，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國九十四年三月三十日董事會通過，出席董事六人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

合晶科技股份有限公司

董事長： 焦 平 海

(二)委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

三、最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者：無。

四、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：無。

五、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：

子公司名稱	實收資本額	資金來源	本公司持股比例	取得或處分日期	取得股數及金額	處分股數及金額	投資損益	截至年報刊印日止持有股數及金額	設定質權情形	本公司為子公司背書保證金額	本公司貸與子公司金額
晶材科技(股)公司	5,000	自有資金	99.99%	93.3.8	—	25,000股 300仟元	50仟元		—	—	—
				93.4.28	—	25,000股 300仟元	50仟元	183,500股 1,847仟元	—	—	—

六、最近年度及截至年報刊印日止股東會及董事會之重要決議：

日期	名稱	議案內容
93.03.23	1.本公司九十二年度決算表冊核議案 2.擬發行九十三年度國內第一次無擔保可轉換公司債 3.更新本公司九十三年度財測核議案 4.本公司九十二年度盈虧撥補案 5.資本公積轉增資案 6.本公司擬代子公司 Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.背書保證美金一百七十五萬元 7.訂定本公司「關係企業營運管理規範」 8.訂定本公司「內部控制制度制訂及評估辦法」 9.建議股東常會修正本公司章程	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過
93.07.29	1.訂定資本公積轉增資案之除權基準日 2.本公司九十三年度國內第一次無擔保可轉換公司債轉換價格調整	照案通過 照案通過
93.08.24	1.本公司九十三年上半年度決算表冊核議案 2.本公司第一次執行買回本公司股份(庫藏股)案 3.購買董監事責任保險	照案通過 經董事討論,決定修正相關條件(六)買回區間價格:每股新台幣十三元至二十元間,惟若本公司股價低於所定買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份,其他條件無異議 照案通過 照案通過
93.11.25	1.本公司轉投資架構調整 2.調整後之孫公司 STIC 引進外部投資人 3.對轉投資事業保證案 4.因致遠會計師事務所內部工作調整,本公司簽證會計師擬由原鄧泗堂、張志銘會計師變更為洪茂益、張志銘會計師	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過
94.01.18	1.本公司九十四年度預算核議案	照案通過

日期	名稱	議案內容
	2.本公司擬透過子公司 Wafer Works Investment Corp.(以下簡稱 WWIC) 參與孫公司 Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.(以下簡稱 STIC)現金增資	照案通過
	3.本公司擬透過孫公司 STIC 參與曾孫公司上海合晶硅材料有限公司現金增資	照案通過
	4. 本公司擬透過孫公司 STIC 轉投資上海晶盟	照案通過
	5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	照案通過
94.03.30	1.本公司民國九十三年度決算表冊核議案	照案通過
	2.本公司民國九十三年度盈餘分派案	照案通過
	3.本公司民國九十三年度盈餘轉增資(股利及員工紅利)案	照案通過
	4.本公司擬將庫藏股轉讓予員工	照案通過

七、最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人依法被處分、公司對其內部人違反內部控制制度規定之處法、主要缺失與改善情形：無。

八、其他必要補充說明事項：無。

九、對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

合晶科技股份有限公司

Wafer Works Corp.

董事長：

合晶科技股份有限公司
桃園縣 326 楊梅鎮梅獅路二段 445 巷 1 號
Wafer Works Corp.
No.1, Lane 445, Mei-Shi RD., Sec. 2,
Yang Mei, Taoyuan 326, Taiwan, R.O.C.
Tel 886-3-4815001
Fax 886-3-4815002
<http://www.waferworks.com>